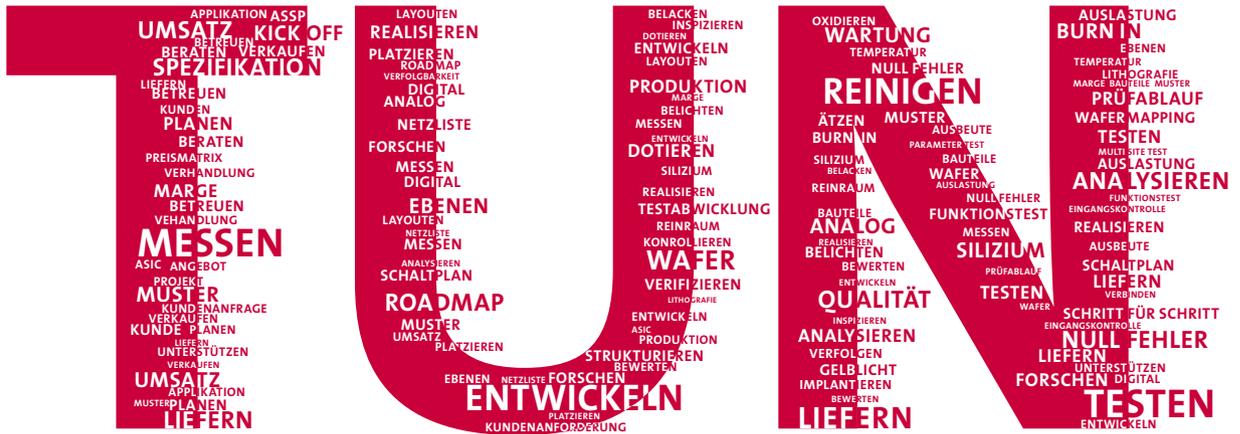
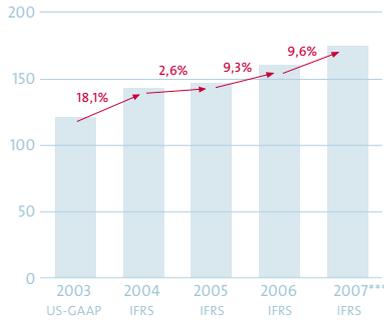


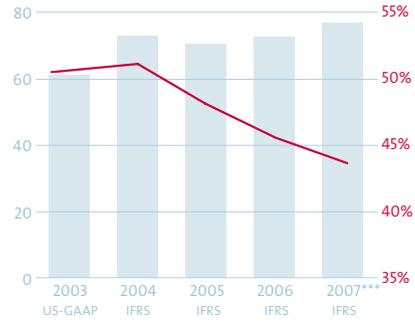
ERFOLG HAT DREI BUCHSTABEN



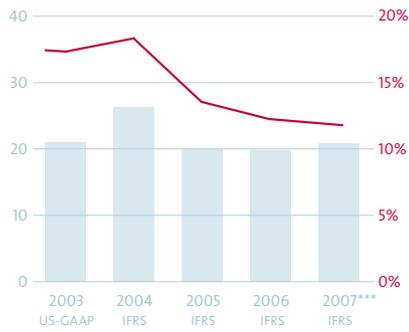
Umsatz in Mio. Euro
und Wachstum



Bruttoergebnis in Mio. Euro
und Marge



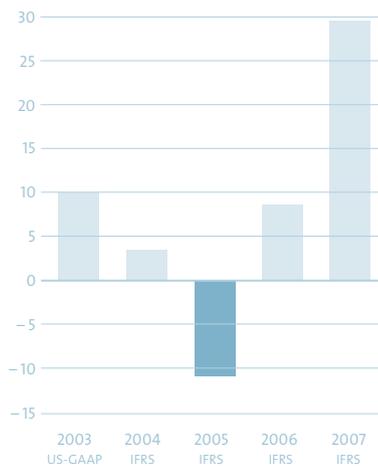
EBIT in Mio. Euro
und Marge



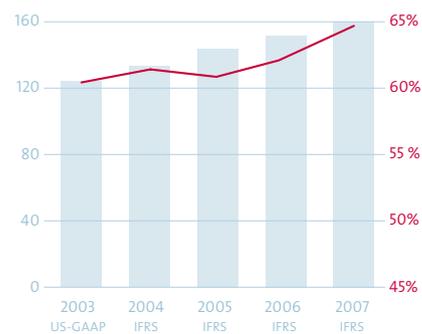
Jahresüberschuss in Mio. Euro
und Nettogewinnmarge



Free Cash Flow*
in Mio. Euro



Eigenkapital und
Eigenkapitalquote



* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

*** Von Einmaleffekten (aus der Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften) bereinigt

Fünfjahresübersicht ELMOS-Konzern

	2003	2004	2005	2006	2007	2007***
in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	US-GAAP	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS
Umsatz	121,4	143,3	147,0	160,7	176,1	176,1
Umsatzwachstum	10,7%	18,1%	2,6%	9,3%	9,6%	9,6%
Bruttoergebnis	61,4	73,2	70,6	73,0	73,1	76,9
Bruttomarge	50,6%	51,1%	48,1%	45,5%	41,5%	43,6%
Forschungs- & Entwicklungskosten	20,4	24,7	28,1	29,6	30,9	30,7
Forschungs- & Entwicklungskosten in % vom Umsatz	16,8%	17,2%	19,1%	18,4%	17,5%	17,5%
EBIT	21,1	26,4	20,0	19,8	15,2	20,9
EBIT in % des Umsatzes	17,4%	18,4%	13,6%	12,3%	8,6%	11,8%
Ergebnis vor Steuern	17,3	22,9	16,4	17,3	12,2	17,9
Ergebnis vor Steuern in % des Umsatzes	14,2%	16,0%	11,2%	10,8%	6,9%	10,2%
Jahresüberschuss	10,0	14,2	10,0	10,7	8,8	12,5
Nettogewinnmarge	8,3%	9,9%	6,8%	6,7%	5,0%	7,1%
Ergebnis je Aktie in Euro	0,52	0,74	0,52	0,55	0,45	0,64
Bilanzsumme	205,3	217,3	237,0	245,3	249,3	
Eigenkapital	124,7	133,8	144,3	152,3	160,0	
Eigenkapitalquote	60,7%	61,6%	60,9%	62,1%	64,2%	
Finanzverbindlichkeiten	60,6	57,6	67,9	65,0	54,0	
Liquide Mittel und Wertpapiere	25,9	18,9	16,8	16,6	42,9	
Nettoverschuldung	34,7	38,7	51,2	48,4	11,1	
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	6,5	34,7	19,7	28,5	30,8	
Investitionen in das Anlagevermögen	- 25,3	- 33,5	- 29,6	- 26,4	- 24,5	
Investitionen in % vom Umsatz	20,9%	23,4%	20,1%	16,4%	13,9%	
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	3,4	- 31,2	- 30,4	- 19,9	- 1,4	
Free Cash Flow*	10,0	3,5	- 10,7	8,6	29,4	
Dividende je Aktie in Euro	0,13	0,21	0,00	0,00	0,00**	
Mitarbeiter im Jahresmittel	874	928	1.028	1.131	1.177	

* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2008

*** Von Einmaleffekten (aus der Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften) bereinigt

Inhalt

INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE

Vorstand	19
Aufsichtsrat	26
Corporate Governance	31
Unsere Verantwortung	38
Unsere Aktie	41

KONZERNLAGEBERICHT

Geschäft und Rahmenbedingungen	45
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	57
Berichterstattung nach §315 Abs. 4 HGB	67
Risiko- und Chancenbericht	69
Nachtragsbericht	73
Prognosebericht	74

KONZERNABSCHLUSS

Jahresabschluss	78
Konzernanhang	88
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	123
Bestätigungsvermerk	124

APPENDIX

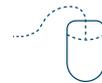
2007 im Rückblick	126
Glossar	130
Impressum	133
Finanzkalender 2008	133



Printdokument
zum Bestellen



Querverweis mit
Seitenangabe



Internetverweis
www.elmos.de

WAS WIR FÜR UNSEREN ERFOLG TUN

Angebot und Zielpreis: Der Vertrieb	2
Von Zellen und Blöcken: Die Entwicklung	6
Schicht für Schicht: Die Wafer-Fertigung	10
Hitze und Kälte: Der Testbereich	14

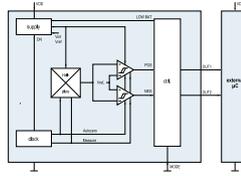
„Erfolg hat drei Buchstaben: TUN“

Johann Wolfgang von Goethe, 1749 - 1832



ANGEBOT UND ZIELPREIS: DER VERTRIEB





Das Blockschaltbild – die erste Idee des Halbleiters

Dienstag 9.37 Uhr. Das Telefon im Büro eines Kundenberaters von ELMOS klingelt und auf dem Display erscheint die Nummer eines langjährigen Kunden. „Guten Tag, ich würde gerne auf Ihr Angebot vom vergangenen Freitag zurückkommen. Wir haben das Schreiben überprüft und würden uns gerne mit Ihnen treffen, um die letzten noch offenen Details zu klären“, meldet sich die Stimme am Telefon. „Gerne. Ich spreche mit unserem Team und melde mich noch heute bei Ihnen mit Terminvorschlägen für die Besprechung“, antwortet der Kundenbetreuer, kurz und freundlich.

Schon vor dem ersten bindenden Angebot prüfte der Kundenbetreuer und auch andere Abteilungen die Machbarkeit, denn dies ist eine der großen Stärken von ELMOS: enge Verbundenheit der einzelnen Bereiche. Die Chip-Designer analysieren technisch die Anforderungen der Kundenanfrage und errechnen den Zeitaufwand und die resultierende Chip-Größe. Mitarbeiter des Testbereiches (Backend) ermitteln den Testaufwand und unser Tochterunternehmen ELMOS Advanced Packaging in den Niederlanden legt das erforderliche Gehäuse fest. Diese Daten bilden die Grundlage der anschließenden Kalkulation.

Vor dem Angebot und dem kurzen Telefonat haben also schon viele beratende Gespräche sowie Treffen stattgefunden und einige Präsentationen wurden gehalten. Der Kundenbetreuer von ELMOS hat seit Monaten intensiv mit dem Kunden diskutiert, die richtigen Leute aus entsprechenden Fachabteilungen an den Tisch geholt und die Weichen für das Projekt gestellt.

Aus dem folgenden Meeting könnte nun der nächste Design Win hervorgehen. Das Projekt wird dann über die nächsten

acht Jahre entwickelt, produziert und in einer Vielzahl von Autos eingesetzt. Kundenspezifische Halbleiter (sogenannte ASICs) sind der größte Wachstumstreiber von ELMOS. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes werden mit ASICs erzielt. Bei diesen individuellen Entwicklungen ist es wichtig, dass die Kundenbetreuer direkt die Sprache des Kunden sprechen und deren Systeme sowie auch die Anforderungen verstehen. Sie müssen sofort erkennen, was der Kunde benötigt und welche Funktionen für diesen Chip sinnvoll sind. Dazu gehören Fragestellungen wie: Was für eine jährliche Stückzahl wird erwartet? In welche Applikation und in welchen Modellen wird der Chip eingesetzt? Wie ist der Zielpreis?

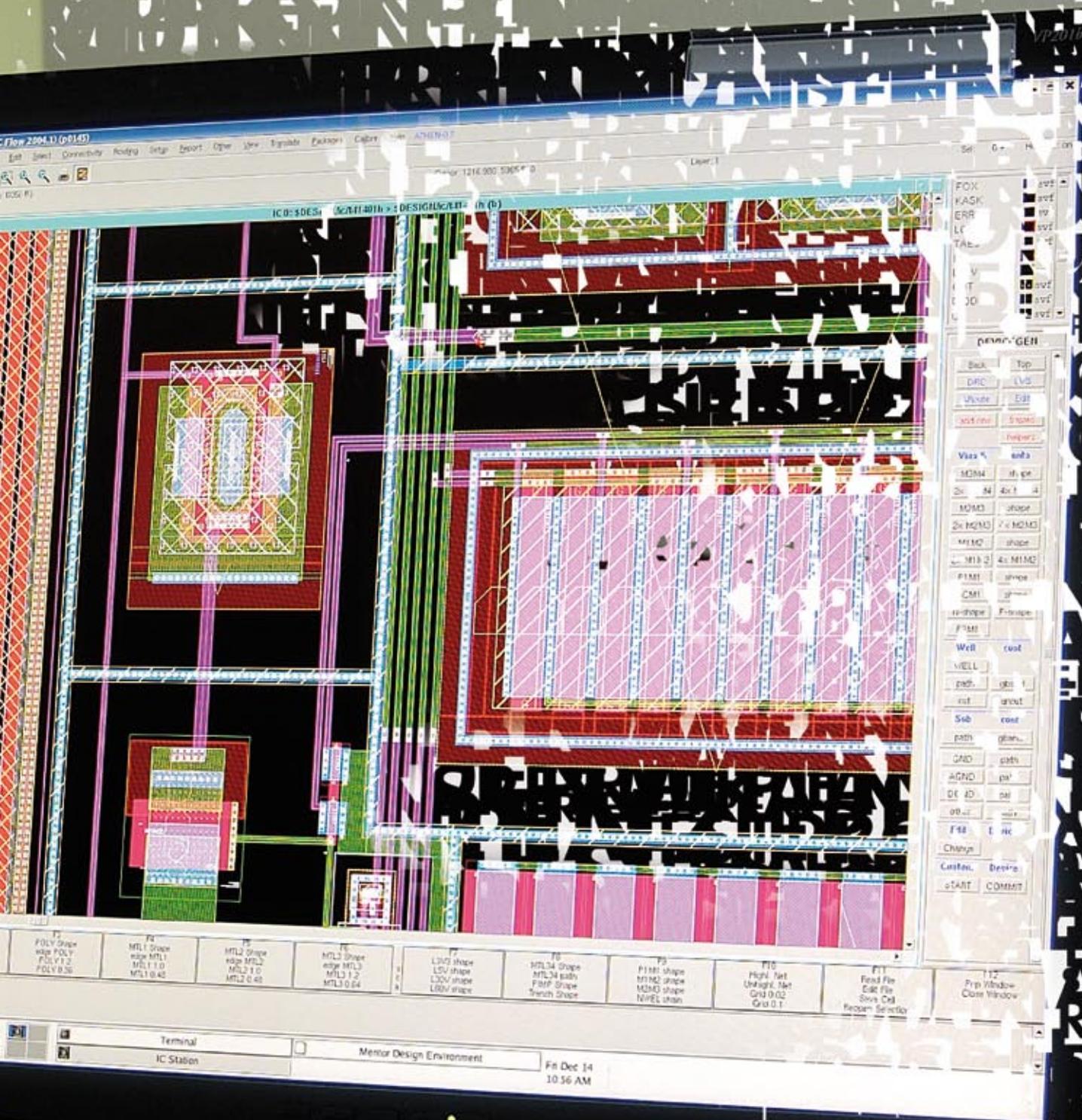
Das Meeting findet am Hauptsitz der ELMOS in Dortmund statt. Es hätte aber auch an einem der anderen zwölf nationalen und internationalen Vertriebsstandorte von München über Stuttgart bis hin zu Paris, Detroit und Tokio stattfinden können. Schließlich ist ELMOS überall dort, wo die Kunden sind, um eine enge Verbindung zwischen den Partnern herzustellen.

Bei dem sogenannten Kick-Off wird das Projekt gestartet. Dazu hat sich das ELMOS-Team, bestehend aus Kundenbetreuer, Projektleiter, Entwickler, Fertigungsspezialist, Qualitätsverantwortlicher und der Kunde an einem runden Tisch zusammengefunden. Sie besprechen jetzt die letzten Feinheiten des Projektes: Dazu zählt z.B. auf welche Parameter besonders geachtet werden muss und wie der Zeitrahmen dieses Projektes in einzelnen Teilschritten aussieht.

Zum Schluss wird per Unterschrift der Vertrag besiegelt – ein weiterer Baustein stützt die langjährige Partnerschaft.



VON ZELLEN UND BLÖCKEN: DIE ENTWICKLUNG



F2	F4	F6	F8	F7	F9	F5	F10	F11	F12
POLY Shape	MTL1 Shape	MTL2 Shape	MTL3 Shape	LSV2 Shape	MTL24 Shape	P11M1 Shape	High 1st	Front File	Prep Window
edge POLY	edge MTL1	edge MTL2	edge MTL3	LSV1 Shape	MTL24 pads	M11M2 Shape	Unlight 1st	File File	Close Window
POLY 1.2	MTL1 1.0	MTL2 1.0	MTL3 1.2	LSQV Shape	F1M1 Shape	M2M3 Shape	Grid 0.02	Save Cell	
POLY 0.36	MTL1 0.45	MTL2 0.45	MTL3 0.64	LSQV Shape	F1M2 Shape	M2M3 Shape	Grid 0.1	Prep Selector	
					Trench Shape	N1VEL Shape			

PROJEKTIEREN
PROGRAMMIEREN
FORSCHEN
LAYOUTEN
ANALYSIEREN
MIXED SIGNAL
ANALOG
DIGITAL
LAYOUTEN
EBENEN
VERBINDEN
KICK OFF
STRUKTURIEREN
MIXED SIGNAL
VERIFIZIEREN
ROADMAP
TESTPROGRAMM
FORSCHEN
ROADMAP
ANALOG
DIGITAL
LAYOUTEN
EBENEN
ANALYSIEREN
SIMULIEREN
MIXED SIGNAL
MUSTER
VERBINDEN
SCHLEIFEN
ADAPTER
SPEZIFIKATION
FORDERUNG
LAYOUTEN
PLATZIEREN UND VERBINDEN
ROADMAP
KICK OFF
ANALYSIEREN
LAYOUTEN
FOLGBARKEIT
STRUKTURIEREN
TESTPROGRAMM
NETZLISTE
MUSTER
MIXED SIGNAL
STRUKTURIEREN
ADAPTER
VERBINDEN
MIXED SIGNAL
VERIFIZIEREN



Das Chiplayout – tägliches Arbeitswerkzeug des Entwicklers

Die Entwickler analysieren das Konzept und zerlegen es in einzelne Funktionseinheiten. In der Regel dienen diese groben Schaltungsblöcke als Grundlage für eine Strukturbeschreibung, die die Anforderungen an die Schaltung veranschaulicht. Die Strukturbeschreibung wird danach systematisch hinsichtlich möglicher Schwachstellen begutachtet und Korrekturen werden eingearbeitet. Nachdem die Strukturbeschreibung fertig gestellt ist, erarbeiten die Entwickler daraus den Designentwurf und das Testkonzept. Akzeptiert der Kunde diese Entwürfe bei einem nächsten „Meilenstein“-Meeting, ist auf dem Weg zum Serienchip ein großer Schritt getan.

Jetzt stehen alle spezifischen Eigenschaften des zukünftigen Bausteins fest: sämtliche spezielle Eckdaten oder Prozessschritte, der geplante Fertigungsablauf, benutzte Technologien, Gehäusebauformen oder der Qualifikations- und Terminplan: All diese Details sind für die Beteiligten verbindlich. Von nun an haben konzeptionelle Änderungen direkte Auswirkungen auf den Zeit- und Kostenplan. Jetzt startet die eigentliche Entwicklungsphase. Die einzelnen Schaltungs- und Funktionsblöcke werden in weitere Untereinheiten zerlegt und übergeordnete Schnittstellen und Versorgungskonzepte definiert. Letztendlich bleiben kleinste Schaltungseinheiten auf Transistorebene übrig, die so genannten Zellen bzw. Schaltungsblöcke.

Dabei handelt es sich um funktionale Schaltungselemente, die auf Basis der EL MOS Halbleitertechnologien entwickelt wurden und größtenteils in Design-Bibliotheken zur Verfügung stehen. Dies können Einzelbauelemente, wie Leistungstreiber, Dioden und Widerstände, oder aber komplexere Schaltungseinheiten, wie Spannungsregler oder Analog-Digital-Konverter, sein.

Obwohl die digitale Signalverarbeitung auch in ASICs im zunehmenden Maße komplexe Funktionen ermöglicht, führen die Einsatzbedingungen, die elektrischen Parameter und auch die gewünschte Funktionsweise des Chips dazu, dass nicht nur digitale Schaltungselemente beim Entwurf zum Einsatz kommen. Oftmals werden Signale aus der Umwelt aufgenommen und müssen zunächst analog aufbereitet werden. Automobi-

le Spannungspegel und notwendige Schutzstrukturen benötigen darüber hinaus eine höhere Spannungsfestigkeit der eingesetzten Elektronik, die nur durch speziell hierfür entwickelte Halbleiterbauelemente erreicht werden kann.

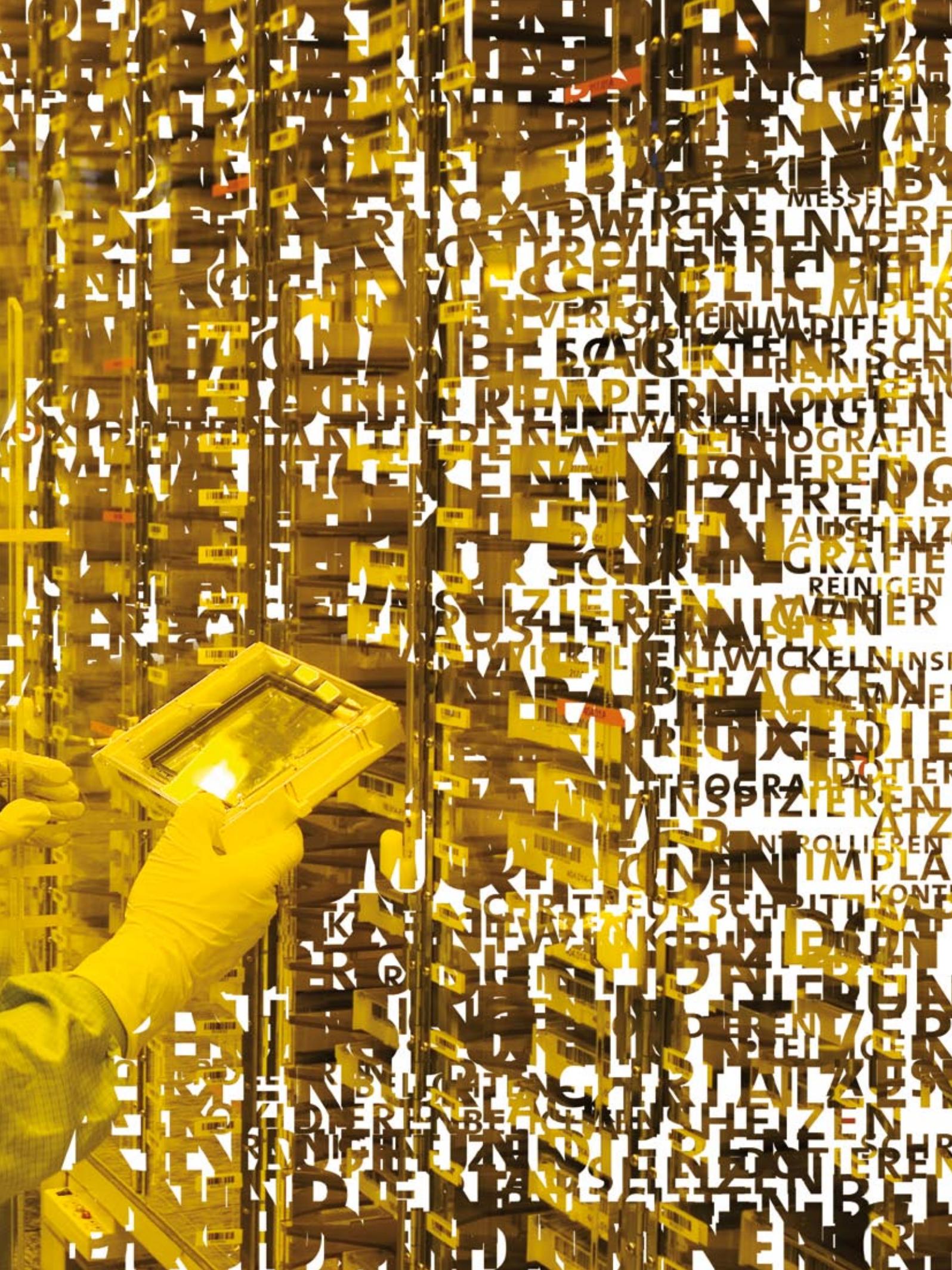
ELMOS bietet mit ihrer Hochvolt-CMOS-Technologiebasis eine passende Lösung für die Anforderungen der Automobilelektronik. So lässt sich eine Spannungsfestigkeit bis zu 120 Volt auf dem Chip bei einer niedrigen Stromaufnahme realisieren. Darüber hinaus wurden viele analoge Schaltungselemente optimiert und bieten in ihrer Kombination mit digitalen Schaltungsblöcken eine umfassende Mixed-Signal Schaltungsbibliothek. Sind alle Funktionen des Chips als Schaltungselemente durch die Zuhilfenahme von Zellen und Blöcken beschrieben, kann die Funktionalität des Halbleiterchips ganz oder in Teilen unter Berücksichtigung der unvermeidlichen prozessbedingten Parameterstreuungen simuliert bzw. mathematisch nachgewiesen werden. Parallel zur Schaltungsentwicklung wird ebenfalls eine Teststrategie für die spätere Serienfertigung entworfen. Ziel dieser Teststrategie ist es, in möglichst kurzer Zeit eine hohe funktionale Testabdeckung des Halbleiterchips zu erzielen.

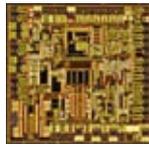
Im Anschluss an die funktionsblockweise durchgeführte Schaltungsentwicklung wird im nächsten Schritt aus der Schaltung eine Netzliste generiert. Sie besteht aus einer alphanumerischen Aufzählung aller Schaltungselemente sowie deren elektrischen Verbindungen. Mit der Netzliste erreicht die erstellte Schaltung einen Status, der die Transformation in eine fertigungsfähige Form ermöglicht. Hierzu werden die Schaltungselemente in eine Layout-Darstellung umgewandelt, die die Besonderheiten der zur Verfügung stehenden Halbleitertechnologie berücksichtigt.

Nach einer abschließenden Verifikation können aus den Layoutdaten die Werkzeuge für die Fertigung erstellt werden. Dazu wird auf Basis der Daten für jede Fertigungsebene eine Lithografiemaske, ein sogenanntes Reticle, erzeugt. Mit Hilfe dieser Masken werden in der Chipproduktion schichtweise die Strukturinformationen in jeweils einer Fotolackschicht belichtet.



SCHICHT FÜR SCHICHT: DIE WAFER-FERTIGUNG





Der Chip auf dem Wafer – sein Weg durch die Fertigung

Der Anfang der Produktionskette ist das so genannte Frontend. Dass es hier sehr sauber zugeht, erkennt man auf den ersten Blick: Alle Personen tragen Reinraumoveralls, die Gesichter sind unter Schutzhauben verdeckt, die Hände stecken in Spezialhandschuhen. Keinesfalls darf der hochreine Arbeitsplatz im Reinraum kontaminiert werden. Dabei kommt es auf die Vermeidung eines jeden Partikels an. Die hochgradig gereinigte Luft im Reinraum ist die Voraussetzung für die Produktqualität.

Als Ausgangsmaterial für die Chip-Produktion dienen 0,6mm dicke Siliziumscheiben. Diese, aus einem Siliziumeinkristall gesägten „Wafer“, sind von genau definierter Beschaffenheit, sind hochrein und erfüllen strengste Anforderungen an ihre elektrischen Eigenschaften. Eingesetzt werden bei uns Wafer mit einem Durchmesser von 150mm oder 200mm.

Die elektrische Funktion der Schaltung wird in dem Halbleitermaterial Silizium durch die gezielte „Verunreinigung“ definierter Gebiete auf der Siliziumscheibe mit kleinen Mengen so genannter Dotierstoffe erreicht. Deshalb müssen nicht nur das Ausgangsmaterial und der Reinraum hochgradig sauber sein, sondern auch alle anderen Hilfsstoffe: Reinstwasser zum Reinigen, Stickstoff und Sauerstoff für thermische Prozesse im Ofen, Fotolacke für die Lithografie – alles wird streng spezifiziert und kontrolliert. Das elektronische Bauelement, der Chip, entsteht in einer nur wenige Mikrometer dicken Schicht auf der Oberfläche der Siliziumscheibe. Alles wird nur noch in Mikrometern gemessen. Deshalb gilt: Reinheit ist das oberste Gebot. Deshalb werden die Wafer auf ihrem Weg durch die Prozesslinie bis zu 20 mal gereinigt und immer wieder kontrolliert. Fremdstoffe würden eine unkontrollierte Dotierung der Siliziumscheiben erzeugen.

Ein Halbleiter selbst besteht aus vielen tausend Bauelementen: Transistoren, Dioden, elektrische Widerstände, Kondensatoren usw. Im Layout eines Chips werden alle einzelnen Bau-

elemente zu einer elektronischen Schaltung zusammengefügt und anschließend können die Fototechnikmasken in Auftrag gegeben werden, die in der Produktion „Schicht für Schicht“ zum Einsatz kommen. Jede Maske definiert Gebiete auf der Siliziumscheibe, die eine besondere Funktion bekommen sollen. Dabei wird auch „übereinander“ gearbeitet, d.h. man kann dabei durchaus von einer Schichtstruktur, von sogenannten „Layern“ reden. Der Fertigungsablauf steuert dann ein Los mit 25 Siliziumwafern zyklisch über die Produktionsabschnitte „Schichterzeugung“ (Siliziumoxid und Nitrid als Isolator, Aluminium als Verdrahtungsschicht), „Fototechnik“ (Aufschleudern des Fotolacks, Belichten mit der Maske, Entwickeln der Lackstruktur), „Schichtstrukturierung“ oder „Dotierung“ und abschließend „Entlacken“. In jedem Produktionszyklus, je nach Komplexität des Chips bis zu 30, werden die Wafer inspiziert, kontrolliert, gemessen und abschließend gereinigt.

Auch ist es notwendig, überall und jederzeit kleinste Prozessabweichungen in der Fertigung zu erkennen bzw. diesen vorzubeugen. Dies wird durch zahlreiche Inspektionen im normalen Fertigungsablauf sichergestellt. So werden regelmäßig die Oberflächen nach Partikeln abgesucht und auffällige Bauteile ausgesondert. Auch kritische Abmessungen sowie wichtige Schichtdicken werden bestimmt und mit den Sollwerten verglichen und ggf. korrigiert.

Es dauert rund sechs Wochen, bis ein Fertigungslos mit 25 Wafern, die alle parallel über jeden Fertigungsschritt bearbeitet werden, die Linie verlässt. Auf jeder Siliziumscheibe befinden sich jetzt bis zu 4.000 fertige Halbleiter. Im letzten Schritt werden noch einmal alle Chips einzeln auf jedem Wafer automatisch optisch inspiziert: eine 100%-ige Kontrolle.

ELMOS beliefert über 100 Kunden und produziert jährlich mehr als 150 Mio. Chips. Dies ist nur durch höchste Automatisierung und erstklassig ausgebildete Mitarbeiter möglich.



HITZE UND KÄLTE: DER TESTBEREICH

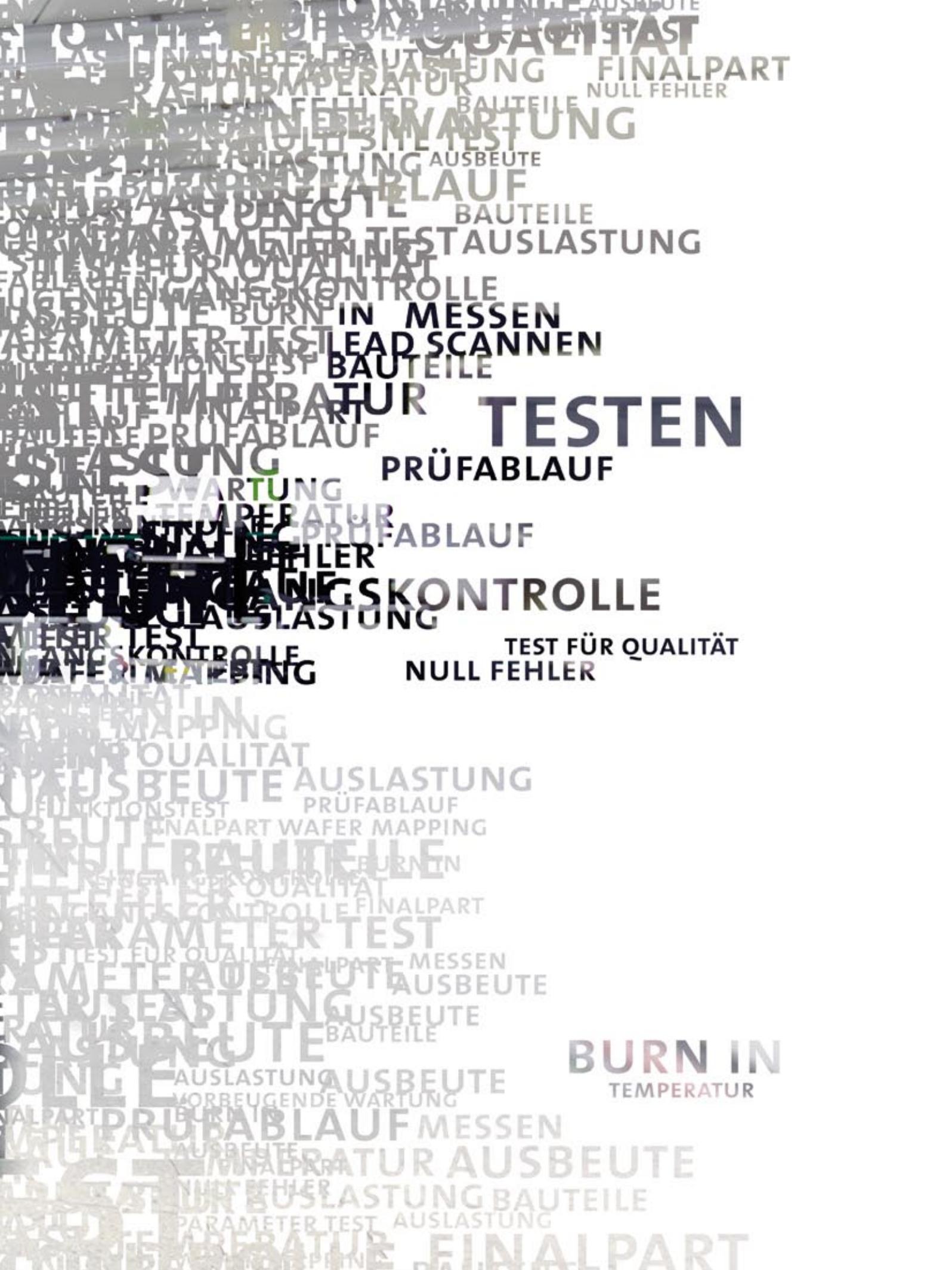


Testplatz 43
Tester
SZ. 113
Piranha
EL

Testplatz 42
Tester
SZ. 114
Piranha
EL

Testplatz 41
Tester
SZ. 117
Piranha
EL

OK-Isolierte
nach Test
EL



TESTEN

PRÜFABLAUF

KONTROLLE

TEST FÜR QUALITÄT

NULL FEHLER

BURN IN

TEMPERATUR

MESSEN

AUSBEUTE

BAUTEILE

FINALPART

PARAMETER TEST

AUSBEUTE

BAUTEILE

AUSLASTUNG

MESSEN

SCANNEN

LEAD

TEST

WARTUNG

QUALITÄT

NULL FEHLER

FINALPART

BAUTEILE

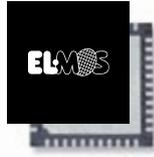
MAPPING

WAFFER

PARAMETER

TEST FÜR QUALITÄT

MAPPING



Der fertige Chip – getestet in 100%-iger Qualität

Die bisherige Fertigungssequenz hat zu einem prozessierten Wafer geführt, auf dem viele kleine rechteckige Bereiche auf der Oberfläche zu erkennen sind. Diese stellen die einzelnen Chips dar, nun kann der Test-Marathon beginnen. Hierzu verlassen die Wafer den Produktionsbereich Frontend und werden im Testbereich (Backend) systematisch untersucht. Als erster Schritt steht der Parametertest an. Für diesen Test wurden in den Zwischenräumen zwischen den Chips die in Abhängigkeit der verwendeten Halbleitertechnologie einzelnen Standardbauelemente mit gefertigt. Nach dem Parametertest können weitere Untersuchungen an den Schaltkreisen durchgeführt werden. Die immer noch im Waferverbund vorliegenden Chips gelangen nun in den Teil des Testbereichs, in dem auf dem Wafer eine elektrische Funktionsüberprüfung der Halbleiterchips stattfindet. Hierzu werden die Wafer in einen Wafer-Prober eingebracht, der jeden Wafer einzeln auf einen Probenstisch ablegt und jeden Chip mit Messnadeln kontaktiert.

Auf diese Weise kann jedes einzelne IC mit elektrischen Signalen stimuliert und die „Antwort“ detektiert werden. Hierzu werden die notwendigen elektrischen Signale in einem Prüfmuster-Generator generiert und mit einem Mehrkanal-Messsystem ausgewertet. Dies geschieht in einer Halbleitertestmaschine. Die dabei benutzte Software stellt das Testprogramm dar, welches im Rahmen der Entwicklung eines Chips durch den verantwortlichen Testingenieur in enger Zusammenarbeit mit den Designern programmiert wird. Danach werden die Ergebnisse in einer sogenannten Wafermap als „ok“ oder „nicht ok“ markiert und in der Datenbank rückverfolgbar abgespeichert.

Nach dem „on-wafer test“ gelangen die Wafer zum Assembler, entweder zu einem unserer Vertragspartner in Fernost oder zu unserer Tochtergesellschaft ELMOS Advanced Packaging in den Niederlanden. Dort werden die Waferscheiben mittels Rückseiten-Schleifprozess abgedünnt und auf Metallgitter, sogenannte Leadframes geklebt, so dass sie nach weiterer Bearbeitung, wie dem Herstellen der Verbindungen zwischen IC und Gehäuseanschlusspin mittels haarfeinen Golddrähten, mit einer schwarzen Moldmasse umgossen werden können. Diese dient dem

Schutz des Chips vor den Umwelteinflüssen und muss daher hermetisch dicht sein. Nach dem Magazinieren der gehäuteten Bauelemente in Transportstangen wird die Ware wieder nach Dortmund zum Endtest, auch Final Part Test genannt, geschickt. Denn die ICs sehen zwar schon aus wie „anständige“ Chips, jedoch vermag noch niemand vorher zu sagen, ob sie 100% gemäß der Kundenspezifikation funktionieren. Dies wird in weiteren Tests sichergestellt, die erneut im Backend, in diesem Fall dem Final Part Testbereich, durchgeführt werden. Je nach Anforderungen der Kunden finden an jedem einzelnen Halbleiterbaustein mehrere Funktionsprüfungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen statt. Typischerweise werden hierzu die Chips auf eine Testtemperatur erwärmt, die +85°C, +125°C oder auch schon mal +150°C betragen kann. Im umgekehrten Fall werden die Chips zum Test auf –40°C abgekühlt und natürlich bei Raumtemperatur getestet.

Halbleiter-Bauelemente werden zudem je nach Kundenwunsch einer künstlichen Voralterung (Burn-in) unterzogen, um sicherheitsrelevante Bauelemente zu testen oder eine noch höhere Absicherung der Qualität zu erzielen. Hintergrund ist das Verhalten potenzieller Ausfallmechanismen im Halbleiter, die bei erhöhten Temperaturen beschleunigt stattfinden können. Naheliegend ist daher, die Chips bei einer höheren Temperatur von beispielsweise +130°C für einige Stunden dynamisch zu betreiben, d.h. mit einer Spannung zu versorgen und dabei Teilfunktionen der Bauteile zu aktivieren. Im Anschluss an die zahlreichen projektspezifischen Tests, auf Wafer-Ebene, bei bis zu zwei Extremtemperaturen, den umfangreichen Final Part Tests und dem Burn-in, können die guten Teile auf Gurt-Rollen verpackt und an den Kunden geschickt werden.

Jede Woche verlassen rund drei Millionen Chips aus verschiedenen Projekten die Produktion und werden auf den Weg zu den Kunden gesandt, die um den Globus verteilt sind. Dort werden die Gurt-Rollen in Bestückungsautomaten eingesetzt, die die empfindlichen Bauteile Stück für Stück auf die Leiterplatten platzieren, wo sie abschließend verlötet werden – und über die gesamte Lebensdauer eines Autos fehlerfrei funktionieren.

INFORMATIONEN FÜR UNSERE AKTIONÄRE

Vorstand	19
Brief des Vorstandsvorsitzenden	19
Vorstandsmitglieder	24
Aufsichtsrat	26
Bericht des Aufsichtsrats	26
Organe des Aufsichtsrats	30
Corporate Governance	31
Corporate Governance Bericht	31
Entsprechenserklärung	37
Unsere Verantwortung	38
Verantwortung für unsere Mitarbeiter	38
Verantwortung für unsere Umwelt	39
Verantwortung für die Gesellschaft	40
Unsere Aktie	41
Allgemeine Entwicklungen an den Börsen	41
Basisinformationen zur Aktie	42
Aktionärsstruktur	42
Investor Relations	43
Hauptversammlung	43

Vorstand

Brief des Vorstandsvorsitzenden

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die ELMOS kann auf ein insgesamt positives Jahr 2007 zurückblicken. Wir haben wesentliche wirtschaftliche Ziele erreicht, neue Kunden gewonnen und bestehende Kundenbeziehungen gestärkt. Unsere strategische Ausrichtung haben wir durch wichtige Entscheidungen und operative Ergebnisse in der Umsetzung nach vorn gebracht. Erfreulich war besonders, dass wir unser Wachstumsziel von rund 10% erreicht haben.

Im vergangenen Jahr haben wir unseren Umsatz um 9,6% auf 176,1 Mio. Euro steigern können. Das ist umso bemerkenswerter, als das Berichtsjahr zum einen durch die Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften beginnend im ersten Quartal, zum anderen durch die schwierigen Marktbedingungen insbesondere im Inland und in den USA gekennzeichnet war. Wie berichtet, führte die Restrukturierung bei unserer Tochter SMI in Kalifornien und der Niederlassung in den Niederlanden zu Sonderaufwendungen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. Euro. Auf Seiten des Marktes war zu vermerken, dass der Automobilsektor in Westeuropa, vor allem in Deutschland, und in den USA schwach war. Die Gründe dafür sind vielfältig: so hat der Ölpreis in 2007 neue Rekordmarken erreicht und die in den USA ausgelöste Kreditkrise das Konsumverhalten beeinflusst. Des Weiteren hat der schwache Dollarkurs die Umsatzerlöse im US-Dollar-Raum gemindert. Dennoch konnten einige deutsche Automobilhersteller signifikante Erfolge im Export erzielen.

Viele in unserem Segment tätige Marktteilnehmer mussten ihre Umsatz- und Ergebniserwartungen aufgrund der Marktbedingungen zum Ende des Jahres teilweise erheblich korrigieren. Dagegen konnte ELMOS das Umsatzziel, sowie die nach Sondermaßnahmen Anfang des Jahres angepasste Ergebnis-Prognose erreichen. Dies ist ein Zeichen für das große Vertrauen der Kunden in unsere Produkte und eine Bestätigung für unseren Produktmix, der auch in schwierigen Zeiten solides Wachstum sicherstellt.

Ohne Sondereffekte aus Restrukturierung belief sich das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) auf 20,9 Mio. Euro oder 11,8% vom Umsatz. Dies entspricht einem Anstieg von 5,3%. Der Jahresüberschuss steigerte sich um 16,4% auf 12,5 Mio. Euro. In Prozent vom Umsatz haben wir ein Niveau von 7,1 erreicht. Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte haben wir also unsere Ziele weitestgehend erreicht, besonders gestützt durch eine starke Leistung im Kerngeschäft, dem Halbleiter-Bereich.

Unter Berücksichtigung der Sondereffekte erreichte das EBIT 15,2 Mio. Euro oder 8,6% vom Umsatz. Der Jahresüberschuss betrug 8,8 Mio. Euro oder 5,0% vom Umsatz.

Erfreulich ist auch, dass wir den Free Cash Flow deutlich auf 29,4 Mio. Euro steigern konnten. Dies ist das Ergebnis des auf 30,8 Mio. Euro gestiegenen operativen Cash Flows, signifikanter Barmittelzuflüsse aus Veräußerungen und maßvoller Investitionen, trotz des weiteren Ausbaus der Fertigungskapazitäten. Erwähnt sein soll an dieser Stelle auch, dass wir in 2007 den Großteil der kurzfristigen Darlehen langfristig umfinanziert haben, und zwar bevor die ersten Anzeichen der Kreditkrise in den USA diskutiert wurden. Wir haben also die Finanzlage der Gesellschaft strukturell deutlich gestärkt.

Trotz der positiven Entwicklung beim Cash Flow veranlassen uns die aufgrund der Sonderbelastungen aus Restrukturierungen reduzierten Ergebnisse auch in diesem Jahr, der Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen. Wir bleiben bei unserer Feststellung der letzten Jahre, dass die Gesellschaft nur dann eine Dividende zahlen sollte, wenn Ergebnisentwicklung und Cash Flow nachhaltig positiv sind.

Mit der Entwicklung unseres Aktienkurses im Berichtsjahr können wir nicht zufrieden sein. Auch wenn wir besser als der Halbleiterindex SOX und die Wettbewerber abgeschnitten haben, hat die ELMOS-Aktie in 2007 immer noch 3% an Wert verloren und das Jahr mit 7,35 Euro beendet.

Wie in den Vorjahren haben wir auch 2007 bedeutende Themen strategischer und operativer Natur erfolgreich weitergeführt, wichtige Meilensteine erreicht bzw. eingeleitete Programme positiv abgeschlossen. Besonders hervorheben möchte ich:

- ▶ Der Ausbau unserer starken Position im automobilen ASIC-Markt ist unverändert die intakte Wachstumssäule unseres Geschäfts. So haben wir ASIC-Folgeaufträge gewonnen, ohne dabei den branchenüblichen Vergabeprozess durchlaufen zu müssen. Wir haben unsere Kunden mit unseren kosteneffizienten Lösungen, der ausgezeichneten Qualität und ebensolcher Liefertreue sowie unserer Entwicklungskompetenz überzeugt, so dass die Entscheidung für ELMOS aus ihrer Sicht außer Frage stand. Damit hat sich auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden verbessert.
- ▶ Wir haben es als erstes Unternehmen weltweit geschafft, einen FlexRay™-Sternkoppler zu entwickeln und zur Serienreife zu bringen. Damit belegen wir in diesem zukunftsweisenden Markt der Bussysteme weltweit eine führende Rolle. Dieser Halbleiter hat in 2007 die Freigabe von BMW erhalten. Dies ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit und Lösungskompetenz unserer Entwicklung. FlexRay™-Bussysteme werden mittelfristig in vielen Anwendungen CAN-Bussysteme ablösen. Das Bussystem CAN ist das derzeit Stückzahl-stärkste Netzwerk im Auto. ELMOS ist bisher in CAN-Systemen unterrepräsentiert, so dass wir uns mit den FlexRay™-Aktivitäten ein großes zukünftiges Wachstumsfeld erschließen.

- ▶ Die Verlagerung des Standardgehäuse-Assemblies nach Fernost ist seit Mitte des vergangenen Jahres abgeschlossen. Das hat mehrere Vorteile: unsere Assembly-Produktion in den Niederlanden kann sich nun vollkommen auf die Entwicklung und Fertigung von Spezialgehäusen konzentrieren. Wir reduzieren mit diesem Schritt mittel- und langfristig unsere Investitionen und steigern den Zukauf aus dem US-Dollar-Raum. Die Struktur unseres Standortes in den Niederlanden haben wir entsprechend angepasst.
- ▶ Wir haben unsere Distributoren-Basis in Europa und Asien deutlich erweitert. Insgesamt hat die ELMOS-Gruppe mit zehn neuen Distributoren Verträge unterzeichnet. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen in den Bereichen Automobil-, Industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der Medizintechnik.
- ▶ Die applikationsspezifischen Standardprodukte (ASSPs) sind im vergangenen Jahr zu einer festen Größe im Konzern herangewachsen. Ein Beispiel dafür ist das umfangreiche Portfolio an Produkten, welche unsere Kernkompetenzen in den Bereichen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“ herausstellt. Wir setzen bei unseren ASSPs auf unser Know-how und überzeugen die Kunden durch eigene, patentierte Lösungen. Unsere Entwicklung arbeitet an wesentlichen Neuerungen: Im Bereich „Sense“ bieten wir in nächster Zeit neue Sensorelemente, Sensorauswerte-Chips und Mikrosysteme für verschiedene physikalische Messgrößen an. Unsere Investition in das ELMOS-eigene VirtuHall® Prinzip zur effizienten Ansteuerung von EC-Motoren schlägt sich in einer IC-Familie für den Bereich „Drive“ mit Derivaten nieder. Für die Produktgruppe „Connect“ stehen neben den schon erwähnten FlexRay™-Transceivern bald weitere standardisierte Bus-ICs zur Verfügung, die sowohl im Auto als auch in der Industrie vermehrt eingesetzt werden. Für die Applikationsgruppe „Supply“ werden aktuell Schaltungskonzepte mit hocheffizienten DC/DC-Wandlern in die Tat umgesetzt, die z.B. für LED-Beleuchtungen in Fahrzeugen oder in Gebäuden, den Kühlaufwand bei unseren Kunden je nach Applikation bis auf die Hälfte reduzieren werden.
- ▶ Am Standort Milpitas, Kalifornien, USA, arbeiten wir bei unserem dortigen Tochterunternehmen Silicon Microstructures Inc. (SMI) seit Anfang 2007 mit einer neuen Geschäftsführung zusammen. Neben der Umsatzsteigerung und Ergebnisverbesserung mit den vorhandenen Produkten wird die Entwicklung neuer Sensorprodukte und Mikrosysteme massiv vorangetrieben. Schwerpunkt ist dabei der Ausbau der Kernkompetenzen im Bereich der „Drucksensoren“. Die Entwicklung für Mikrosysteme erfolgt standortübergreifend zwischen unseren Tochtergesellschaften in Milpitas, und Nijmegen sowie unserem Hauptsitz Dortmund.

- ▶ Unser neuer Fertigungsstandort für 8-Zoll-Wafer in Duisburg hat 2007 die Kapazitäten kontinuierlich erhöht. Nach einem planmäßigen Verlauf über drei Quartale mussten wir in der zweiten Hälfte des letzten Quartals die weitere Steigerung der Wafereinstellung aussetzen. Im Sinne von Qualität und Stabilität von Produkten und Prozessen haben wir uns für diese Maßnahme entschieden. Die dadurch verursachte Verzögerung im Kapazitätsaufbau in Duisburg wird zu keiner Verschiebung der geplanten, teilweisen Umrüstung von 6- auf 8-Zoll-Wafern in Dortmund führen. Dies wird durch entsprechende Sondermaßnahmen sichergestellt.
- ▶ Anfang 2008 konnten wir mit einem Partner in Asien einen Kooperationsvertrag zur Auftragsfertigung unterzeichnen. Wir werden zusammen mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip auch eine neue Technologie-Generation entwickeln und in der Folge fertigprozessierte Wafer auch für automobile Produkte von MagnaChip beziehen. Die dafür notwendigen hohen automobilen Qualitätsstandards wird MagnaChip zuverlässig erfüllen. Wir können dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf sowie unsere Entwicklungsaufwendungen für zukünftige Technologiegenerationen deutlich reduzieren und flexibler auf schwankende Stückzahlen reagieren. Zudem wird dies mittelfristig unsere US-Dollarabhängigkeit reduzieren und den Kapazitätsbedarf für unser Wachstum absichern.
- ▶ In 2007 konnten wir generell gute Erfolge auf dem asiatischen Markt erzielen. Wir haben zum Beispiel den Auftrag eines großen japanischen Elektronikonzerns gewonnen. Die damit realisierbaren berührungslosen Schalter nach dem HALIOS®-Prinzip werden 2008 in erste Applikationen aus dem Konsumgüterbereich verbaut. Unsere Chips dafür werden wir von einer Foundry (Auftragsfertigung) in Taiwan beziehen. Auch in Südkorea haben wir enge Beziehungen zu den dortigen Automobilzulieferern und den Fahrzeugherstellern geknüpft, die kurzfristig zu konkreten Aufträgen führen werden.

Anhand der Beispiele erkennen Sie, dass, nachdem Strategie und Richtung festgelegt waren, in 2007 viele Themen angepackt und umgesetzt wurden. Wir haben nach sorgfältiger Planung und Konzeption das „Tun“ vorangestellt. Das Ziel bleibt: Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit von ELMOS stärken, um ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Dabei stellen wir insbesondere auch die Verbesserung der Ergebnisqualität in den Vordergrund.

Außerdem wollen wir unsere Führung unter den spezialisierten Halbleiterherstellern ausbauen und zwar in jeder Hinsicht: beim Produktportfolio, in der Qualität und bei der Lösungskompetenz. Dies wollen wir sowohl aus eigener Kraft wie auch – bei entsprechender Gelegenheit – durch Zukauf erreichen.

Dass wir im Kernfeld Automobil erfolgreich unterwegs sind, zeigt sich u.a. an der Statistik des Marktforschungsinstitutes Gartner Dataquest. Hier haben wir in der letzten Erhebung den Sprung vom dritten auf den zweiten Platz der weltweit größten automobilen ASIC-Hersteller geschafft. Mit unserer Unternehmensgröße und unserem Applikations-Know-how sind wir der ideale Partner für die Schlüsseltechnologie Mikroelektronik im Automobilssektor und der Industriebranche sowie generell für mittelständische Unternehmen.

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei allen unseren Partnern bedanken, beginnend bei unseren Kunden. Das entgegengebrachte Vertrauen der Kunden wissen wir sehr zu schätzen. Wir werden jeden Tag mit vollem Engagement daran arbeiten, dieses Vertrauen zu rechtfertigen, die Erwartungen zu übertreffen und ihnen die beste Lösung bei höchster Qualität anzubieten.

Die erreichten Resultate verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ganzen ELMOS-Gruppe. Der Einsatz, das Know-how, der Wille zum Erfolg und die Identifikation mit dem Unternehmen waren herausragend.

Des Weiteren gilt unseren Aktionärinnen und Aktionären mein Dank, die uns trotz wenig erfreulicher Kursentwicklung die Treue halten. Ich bin überzeugt, dass unsere konsequente Ausrichtung auf profitables Wachstum bei deutlich reduzierten Investitionen den Unternehmenswert dauerhaft steigern wird.

Für 2008 wollen wir eine Verbesserung auf breiter Front erzielen. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem Wachstum über dem Marktdurchschnitt. Der Umsatz soll zwischen 7% und 9% gesteigert werden. Die EBIT-Marge wird zwischen 12% und 14% erwartet. Die Investitionen sollen geringer als im Vorjahr ausfallen. Darüber hinaus ist wieder ein positiver Free Cash Flow geplant.

Wir haben uns ambitionierte aber erreichbare Ziele gesetzt. Dazu werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und selbstverständlich der gesamte Vorstand ihr Bestes geben, denn: Erfolg hat drei Buchstaben: TUN.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Anton Mindl

Vorsitzender des Vorstands

Dr. rer. nat. Anton Mindl

Diplom-Physiker | Lüdenscheid | Geboren 1957

Vorstandsvorsitzender



- ▶ Vorstandsmitglied seit 2005 | bestellt bis 2010
- ▶ **Wesentliche Verantwortungsbereiche**
 Strategie | Forschung und Entwicklung | Technologie | Qualität
 Personalentwicklung | Sensorik und Mikromechanik
- ▶ Mitglied in der IHK-Vollversammlung zu Dortmund

Dr.-Ing. Frank Rottmann

Diplom-Ingenieur | Dortmund | Geboren 1958

Vorstand für Vertrieb und Entwicklung



- ▶ Vorstandsmitglied seit 2005 | bestellt bis 2010
- ▶ **Wesentliche Verantwortungsbereiche**
 Produktentwicklung und Design | Vertrieb | Marketing
 Distribution | Mikrosysteme | Optoelektronik
- ▶ Keine weiteren Mandate

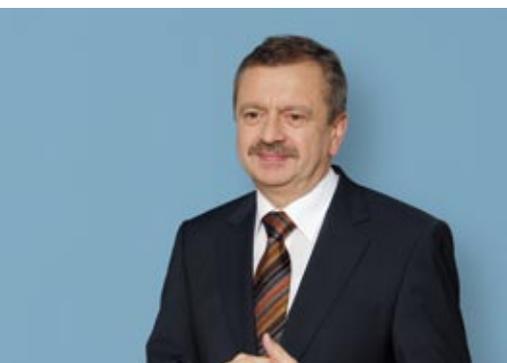


Nicolaus Graf von Luckner

Diplom-Volkswirt | Oberursel | Geboren 1949

Vorstand für Finanzen

- ▶ Vorstandsmitglied seit 2006 | bestellt bis 2011
- ▶ **Wesentliche Verantwortungsbereiche**
Finanzen | Controlling | Investor Relations | Administration
Einkauf | Informationstechnologie
- ▶ Keine weiteren Mandate



Reinhard Senf

Diplom-Ingenieur | Iserlohn | Geboren 1951

Vorstand für Produktion

- ▶ Vorstandsmitglied seit 2001 | bestellt bis 2011
- ▶ **Wesentliche Verantwortungsbereiche**
Produktionsplanung | Produktion Frontend und Backend
Prozess- und Produkt-Engineering | Logistik | Assembly | Facility Management
- ▶ Keine weiteren Mandate

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer

Diplom-Physiker | Duisburg

Aufsichtsratsvorsitzender



Bericht des Aufsichtsrats

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

der Aufsichtsrat hat auch im Geschäftsjahr 2007 die Aufgaben, die ihm nach Gesetz und Satzung obliegen, sorgfältig wahrgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns intensiv mit der Lage des Unternehmens beschäftigt. Wir haben den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand hat uns in umfassenden, sowohl schriftlichen als auch mündlichen Berichten regelmäßig und frühzeitig informiert. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung waren wir unmittelbar eingebunden. Der Vorstand hat die strategische Ausrichtung der Gesellschaft mit uns abgestimmt.

Abweichungen des Geschäftsverlaufs wurden uns im Einzelnen erläutert und von uns aufgrund der vorgelegten Berichte überprüft. Im Aufsichtsrat haben wir die Berichte des Vorstands zu sämtlichen für das Unternehmen bedeutenden Geschäftsvorgängen ausführlich erörtert. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats vom Vorstand über die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Neben dem Vorsitzenden standen weitere Mitglieder des Aufsichtsrats auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigem Kontakt mit dem Vorstand. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats hat mit dem Vorsitzenden des Vorstands umfassend über die Strategie und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens beraten.

Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat bzw. der Hauptversammlung gegenüber offen zu legen sind, traten nicht auf.

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf Sitzungen am 10. Mai 2007, am 26. Juli 2007, am 25. Oktober 2007, am 14. Dezember 2007 und am 12. März 2008 aufgrund schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands eingehend über die Entwicklung des am 31. Dezember 2007 abgelaufenen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und aktuelle geschäftspolitische Entscheidungen

gen unterrichten lassen. Der Aufsichtsrat hat diese mit dem Vorstand beraten und den Vorstand überwacht. Auf Basis ausführlicher Informationen fasste der Aufsichtsrat in den Sitzungen die erforderlichen Beschlüsse. Bei allen ordentlichen Sitzungen war der Aufsichtsrat vollständig anwesend. Der Aufsichtsrat hat sich auch mit der Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats befasst und diese bewertet.

Im Rahmen der Gespräche im Aufsichtsrat standen regelmäßig die aktuelle Absatz-, Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung des ELMOS-Konzerns im Vordergrund. In den einzelnen Sitzungen wurde detailliert über die Lage der Konzerngesellschaften und die Vertriebsaktivitäten beraten. Weitere wesentliche Punkte waren die Restrukturierungsmaßnahmen bei den Tochtergesellschaften Silicon Microstructures Inc. und ELMOS Advanced Packaging B.V. sowie die Investitions- und Jahresplanung 2008 und die strategische Ausrichtung der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat sich zudem mit den Planungen für eine Umstellung der Fabrik in Dortmund von 150mm- auf 200mm-Scheiben beschäftigt. Darüber hinaus wurden das Risikomanagementsystem und die Entsprechung zu den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex durch die Gesellschaft behandelt. Der Vorstand hat ebenfalls sein Compliance-Programm vorgestellt und erläutert. Der Aufsichtsrat konnte sich davon überzeugen, dass dieses Programm den rechtlichen Anforderungen und der Risikolage der Gesellschaft entspricht. Gegenstand ausführlicher Beratungen waren außerdem die Bestellung des Abschlussprüfers und die Überwachung seiner Unabhängigkeit. Ein weiteres Thema war die Vorbereitung der Hauptversammlung 2008.

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats hat sich in der Sitzung am 28. Februar 2008 intensiv mit dem vorläufigen Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG und des Konzerns beschäftigt. An dieser Beratung hat auch der Abschlussprüfer teilgenommen. Darüber hinaus wurden die im Risikomanagement erfassten, wesentlichen Risiken für das Unternehmen dargelegt und die vom Vorstand beschlossenen Maßnahmen beraten. Der Prüfungsausschuss hat im Berichtsjahr einmal getagt.

Der Personalausschuss hat jeweils im Anschluss an die ordentlichen Sitzungen des Aufsichtsrats getagt und über das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands beraten. Thema der Beratungen waren auch die in 2007 erstmals an Vorstand und Mitarbeiter ausgegebenen Stock Awards. Der Personalausschuss hat im Berichtsjahr dreimal getagt.

Der im Oktober 2007 neu gebildete Nominierungsausschuss, der bei anstehenden Neuwahlen dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für die Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vorschlagen wird, hat im Berichtsjahr nicht getagt.

Die Ausschussvorsitzenden haben in den Aufsichtsratssitzungen über ihre Arbeit berichtet.

PRÜFUNG DES JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSES

In seiner Sitzung am 12. März 2008 hat sich der Aufsichtsrat unter Hinzuziehung der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007 befasst. Der nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007 und der Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 und der anschließenden Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) aufgestellt sowie um die nach §315a Abs. 1 HGB vorgesehenen Angaben ergänzt. Auch der Konzernabschluss nach IFRS und der Konzernlagebericht haben den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers erhalten.

Die Jahresabschlussunterlagen, der Geschäftsbericht sowie die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers sind allen Mitgliedern des Aufsichtsrats rechtzeitig zugeleitet worden. Der Vorstand hat die Unterlagen in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 12. März 2008 zusätzlich auch mündlich erläutert. Die Wirtschaftsprüfer, die die Prüfungsberichte unterzeichnet haben, berichteten in dieser Sitzung über die Ergebnisse der Prüfung. Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses des Konzernlageberichts und des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und in der Sitzung am 12. März 2008 den Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor zu beschließen, den Bilanzgewinn in Höhe von 39,6 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen.

CORPORATE GOVERNANCE

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und sind der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswertes verpflichtet. Am 14. Dezember 2007 wurde von der Gesellschaft eine aktualisierte Erklärung gemäß §161 AktG bezüglich der Erfüllung der Empfehlungen des Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 abgegeben und den Aktionären auf der Website dauerhaft zugänglich gemacht. Sie ist außerdem auf Seite 37 dieses Geschäftsberichtes abgedruckt.



BESETZUNG VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Herr Dr. Klaus Weyer wurde am 10. Mai 2007 von der Hauptversammlung als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund war Herr Dr. Klaus Weyer bereits mit Wirkung vom 1. Januar 2007 Mitglied des Aufsichtsrats. Abgesehen davon gab es im Geschäftsjahr 2007 keine personellen Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat.

Eine Übersicht über die Mitglieder des Aufsichtsrats befindet sich auf Seite 30 dieses Geschäftsberichts.



BERICHT GEMÄSS §§ 312 | 313 AKTG

Des Weiteren hat der Aufsichtsrat den Bericht des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §§ 312 | 313 AktG geprüft. Der Aufsichtsrat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen. Zudem hat der Abschlussprüfer den Bericht des Vorstands der ELMOS Semiconductor AG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß §§ 312 | 313 AktG geprüft und mit folgendem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„Nach unserer pflichtmäßigen Prüfung und Beurteilung bestätigen wir, dass 1. die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig sind, 2. bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch war, oder Nachteile ausgeglichen worden sind, und 3. bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand sprechen.“

Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Aufsichtsrats sind keine Einwendungen gegen die Erklärung des Vorstands am Ende des Berichts über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen zu erheben.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit, den hohen Einsatz und den erreichten Erfolg.

Dortmund, 12. März 2008

A handwritten signature in black ink that reads 'G. Zimmer'.

Für den Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer

Vorsitzender des Aufsichtsrats

Organe des Aufsichtsrats

AUFSICHTSRAT

Prof. Dr. Günter Zimmer <i>Vorsitzender</i> Diplom-Physiker Duisburg	Mandate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Siltronic AG ▶ Mitglied im Board of Directors der Dolphin Intégration S.A.
Dr. Burkhard Dreher <i>Stellvertretender Vorsitzender</i> Diplom-Volkswirt Dortmund	Mandate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der EKO Stahl GmbH ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der GfV AG ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Vattenfall Europe Mining AG
Jörns Haberstroh Diplom-Ökonom Kerken	Mandate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Ehlebracht AG ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der 3M-Quante AG
Dr. rer. nat. Peter Thoma Diplom-Physiker Unterschleißheim	Mandate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mitglied im Technischen Beirat von Behr GmbH & Co. KG <i>(bis 01.07.2007)</i> ▶ Mitglied im Beirat von Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG
Jutta Weber Diplom-Pädagogin Tarrytown, New York, USA		
Dr. Klaus Weyer Diplom-Physiker Schwerte	Mandate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Mitglied im Aufsichtsrat der Paragon AG ▶ Mitglied im MST Projektbeirat Dortmund

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS

Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss befasst sich vornehmlich mit Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers.

- Vorsitzender** ▶ Dr. Burkhard Dreher
- Mitglieder** ▶ Prof. Dr. Günter Zimmer
▶ Dr. Klaus Weyer *(ab 25.10.2007)*

Personalausschuss

Der Personalausschuss befasst sich im Bedarfsfall mit der Suche und Anstellung neuer Vorstände sowie mit dem Vergütungssystem für den Vorstand.

- Vorsitzender** ▶ Prof. Dr. Günter Zimmer
- Mitglieder** ▶ Dr. Burkhard Dreher
▶ Dr. Klaus Weyer *(ab 25.10.2007)*

Nominierungsausschuss *(ab 25.10.2007)*

Der Nominierungsausschuss berät über geeignete Kandidaten für den Aufsichtsrat im Falle von Neuwahlen.

- Mitglieder** ▶ Prof. Dr. Günter Zimmer
▶ Dr. Peter Thoma
▶ Dr. Klaus Weyer

Corporate Governance

Corporate Governance Bericht

Wir zählen eine verantwortungsvolle und transparente Unternehmensleitung zu den wichtigsten Aspekten unserer Unternehmenskultur. Dies ist für alle Bereiche im gesamten Konzern gültig. Vorstand und Aufsichtsrat berichten gemeinsam über die Corporate Governance bei ELMOS.

Im Dezember 2007 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Entsprechenserklärung nach §161 AktG abgegeben. Hierin legt ELMOS offen, dass die Gesellschaft in vier Punkten von den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 14. Juni 2007 abweicht. Dies betrifft den Selbstbehalt der Organmitglieder für die D&O Versicherung (Ziffer 3.8), die individualisierte Offenlegung der Gehälter von Vorstand und Aufsichtsrat (Ziffern 4.2.4 und 5.4.7) sowie die Vergütung der Mitglieder in den Aufsichtsratsausschüssen (Ziffer 5.4.7). Die Entsprechenserklärung ist auf Seite 37 abgedruckt und außerdem auf unserer Website zugänglich. Dort sind auch die Entsprechenserklärungen der vergangenen Jahre zu finden.

Abweichung in
vier Punkten



ENGE ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Der Vorstand ist das ausführende Organ der ELMOS Semiconductor AG. Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand hinsichtlich der Leitung des Unternehmens. Er ist an allen Entscheidungen mit grundlegender Bedeutung für den Konzern beteiligt und ernennt oder entlässt die Mitglieder des Vorstands. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, umfassend und zeitnah über alle Entwicklungen und Ereignisse, die für die Geschäftsentwicklung und die Lage des ELMOS-Konzerns von Bedeutung sind. Auch im abgelaufenen Berichtsjahr haben Vorstand und Aufsichtsrat wieder eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet. Die Geschäftsordnungen beider Organe regeln unter anderem diese Zusammenarbeit.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen. Herr Dr. Klaus Weyer wurde im Januar 2007 vom Amtsgericht Dortmund zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt. Die Hauptversammlung hat im Mai 2007 Herrn Dr. Weyer bis zum Jahr 2010 als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Dies entspricht der verbleibenden Amtszeit seines Vorgängers im Aufsichtsrat, Herrn Herbert Sporea. Die laut Satzung jeweils für fünf Jahre gewählten Aufsichtsratsmitglieder spiegeln mit ihren verschiedenen beruflichen Werdegängen die Vielfalt der Aktivitäten der ELMOS wider.

TRANSPARENZ FÜR UNSERE AKTIONÄRE

ELMOS ist stets bestrebt, eine größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Unsere Aktionäre werden regelmäßig über die aktuellsten Entwicklungen des Unternehmens bezüglich der Finanzlage und der strategischen Ausrichtung informiert.



Wichtige Termine für die Aktionäre werden jährlich in einem Finanzkalender veröffentlicht. Alle Quartals- und Geschäftsberichte und Informationen zur Hauptversammlung werden auf der Internetseite publiziert sowie über weitere Distributionskanäle öffentlich gemacht. Wir führen regelmäßige Treffen mit Analysten und institutionellen Anlegern durch. Das Informationsangebot unserer Internetseite wird ständig erweitert, um unsere Aktionäre noch umfassender zu informieren.

§15a des Wertpapierhandelsgesetzes sieht vor, dass Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats oder ihnen nahe stehende Personen den Erwerb und die Veräußerung von ELMOS-Aktien offen legen. Meldepflichtige Wertpapiergeschäfte veröffentlichen wir auf unserer Homepage und im Corporate Governance Bericht. Diese Daten werden europaweit verbreitet und ins Unternehmensregister eingestellt.

Nächste Hauptversammlung
findet am 08. Mai 2008 statt

Die Hauptversammlung ist für unsere Aktionäre die wichtigste Plattform zur Ausübung ihrer formalen Rechte. Die Aktionäre erhalten im Vorfeld unseren Geschäftsbericht und die Tagesordnung. Die Hauptversammlung wird vollständig per Webcast auf unserer Internetseite übertragen, um auch denen die Verfolgung der Veranstaltung zu ermöglichen, die aus Zeitgründen nicht an der Hauptversammlung teilnehmen können. Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte auf von ELMOS ernannte Stimmrechtsvertreter zu übertragen. Sämtliche Dokumente zur aktuellen wie auch zu vergangenen Hauptversammlungen sowie weitere Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmabgabe sind auf unserer Internetseite verfügbar oder können bei der Gesellschaft angefordert werden. Die nächste Hauptversammlung findet am 08. Mai 2008 in Dortmund statt.



COMPLIANCE

Der Vorstand der ELMOS Semiconductor AG hat Maßnahmen ergriffen, damit alle Gesetze und Richtlinien im Konzern eingehalten werden. Die Mitarbeiter wissen, dass sie sich an die im Unternehmen geltenden Regeln zu halten haben und kennen die aus Verstößen gegen diese Regeln resultierenden Sanktionen. Der Aufsichtsrat lässt sich einmal jährlich vom Vorstand über die Fortschritte des Compliance-Programms berichten.

VORAUSSCHAUENDES RISIKOMANAGEMENT

Bewusstes unternehmerisches Risikomanagement ist ebenfalls ein Teil guter Corporate Governance. Ein solches Risikomanagement trägt dazu bei, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten. Alle Bereiche des Unternehmens geben regelmäßig eine Einschätzung der mit ihrem Gebiet verbundenen Risiken ab. Die Risiken werden bewertet und Gegenmaßnahmen eingeleitet. Parameter für die Einschätzung eines Risikos sind Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Schadenshöhe. Diese Risikoeinschätzung wird vierteljährlich, im Bedarfsfall auch kurzfristiger aktualisiert. Über die aktuellen Unternehmensrisiken berichten wir im Lagebericht ab Seite 69.



ABSCHLUSSPRÜFUNG DURCH ERNST & YOUNG

Bevor der Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers unterbreitet wurde, holte der Aufsichtsrat vom Prüfer eine Erklärung ein, inwieweit Beziehungen des Prüfers, seiner Organe und Prüfungsleiter zu der Gesellschaft oder deren Organmitgliedern bestehen. Zweifel an deren Unabhängigkeit bestanden nicht. Der Aufsichtsrat hat entsprechend Ziffer 7.2.3 des Corporate Governance Kodex mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass ihm dieser über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse unverzüglich berichtet, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Ebenso legte er fest, dass der Prüfer den Aufsichtsrat informiert bzw. im Prüfungsbericht vermerkt, wenn er Abweichungen von der vom Vorstand und Aufsichtsrat abgegebenen Erklärung zum Kodex ermittelt. Solche Unrichtigkeiten wurden nicht festgestellt.

VERGÜTUNGSBERICHT

Gesamtbezüge des Vorstands

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert sich an der wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Konzerns. Der Personalausschuss des Aufsichtsrats berät über eine angemessene Vergütung und die verschiedenen Vergütungsbestandteile. Die Gesamtvergütung umfasst einerseits erfolgsunabhängige Komponenten, wie ein fixes Monatsgehalt, Nebenleistungen, wie Übernachtungskosten und Dienstwagenutzung, Pensionszusagen sowie andererseits erfolgsabhängige Komponenten, wie die Tantieme und die Gewährung von Aktien der ELMOS Semiconductor AG aus einem Incentiveplan (Stock Awards) als Komponente mit langfristiger Anreizwirkung. Die Tantieme leitet sich prozentual aus dem Ergebnis des Konzerns vor Steuern ab.

Auf eine individualisierte Veröffentlichung der Vergütung wird in Anbetracht der Wahrung der Privatsphäre verzichtet. Eine solche Offenlegung trägt nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu einer erweiterten Transparenz in Form von zusätzlichen kapitalmarktrelevanten Informationen bei. Aus diesem Grund hat die Hauptversammlung am 19. Mai 2006 beschlossen, die Gesellschaft für einen Zeitraum von fünf Jahren von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungs-Gesetz vom 3. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zur individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütung zu befreien.

Im Geschäftsjahr 2007 beliefen sich die fixen Bezüge der Mitglieder des Vorstands auf 1.655 Tsd. Euro und die variablen Bezüge auf 185 Tsd. Euro. Im Jahr 2007 wurden erstmalig Aktien der EL MOS Semiconductor AG gemäß einem Incentiveplan an die Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Der Gesamtwert der Aktien betrug zum Gewährungszeitpunkt 65 Tsd. Euro.

EL MOS hat für Pensionszusagen (unmittelbare Zusagen) gegenüber Mitgliedern des Vorstands Pensionsrückstellungen in Höhe von 611 Tsd. Euro gebildet. Des Weiteren bestehen für Mitglieder des Vorstands der EL MOS Semiconductor AG mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2007 beliefen sich die Beiträge für diese Pensionspläne auf 432 Tsd. Euro. Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihre Hinterbliebenen lagen im Geschäftsjahr 2007 bei 79 Tsd. Euro. Ferner wurden für diese Versicherungsprämien in Höhe von 200 Tsd. Euro entrichtet. Die Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2007 betrug 2.536 Tsd. Euro.

Abgesehen von Pensionen sind für den Fall der Beendigung der Tätigkeit keinem Vorstandsmitglied weitere Leistungen zugesagt worden. Ebenso hat kein Mitglied des Vorstands im abgelaufenen Geschäftsjahr Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied erhalten.

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in §9 der Satzung festgelegt. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben der Erstattung ihrer Auslagen eine feste und eine erfolgsorientierte Vergütung. Die erfolgsorientierte Vergütung ist an die Dividende gebunden und damit auf den langfristigen Unternehmenserfolg ausgerichtet. Dem Aufsichtsrat werden keine Aktien der EL MOS Semiconductor AG zugeteilt.

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex hinsichtlich der Berücksichtigung des Vorsitzes und stellvertretenden Vorsitzes bei der Vergütung erhält der Vorsitzende das Doppelte und sein Stellvertreter das Eineinhalbfache der festen Vergütung. Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird summiert, jedoch nicht individualisiert ausgewiesen. Dies gilt auch für an Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlte Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen.

Die feste Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug im Geschäftsjahr 2007 in der Summe 92 Tsd. Euro. Spesen und Auslagen sind darin enthalten. Da in 2007 keine Dividende an die Aktionäre ausgezahlt wurde, wurde an die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2007 keine variable Vergütung gezahlt. Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen und Erfindervergütungen, vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 377 Tsd. Euro.

WERTPAPIERGESCHÄFTE

Aufgeführt sind Transaktionen im Jahr 2007 bezogen auf Aktien der ELMOS Semiconductor AG (ISIN DE0005677108).



Datum / Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs/ Basispreis in Euro	Gesamt- volumen in Euro
28.09.2007 Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorsitzender des Vorstands	Kauf von ELMOS- Aktien	1.000	7,55	7.550
07.11.2007 Xetra	Dr. Anton Mindl	Vorsitzender des Vorstands	Kauf von ELMOS- Aktien	1.000	7,52	7.519
08.11.2007 außerbörslich	Dr. Anton Mindl	Vorsitzender des Vorstands	Übertragung von ELMOS-Aktien	2.975	7,25	21.569
08.11.2007 außerbörslich	Nicolaus Graf von Luckner	Finanzvorstand	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319
08.11.2007 außerbörslich	Dr. Frank Rottmann	Vorstand für Entwicklung und Vertrieb	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319
08.11.2007 außerbörslich	Reinhard Senf	Vorstand für Produktion	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319

AKTIENBESITZ

Am 31. Dezember 2007 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien und Aktienoptionen von ELMOS:

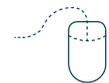
Vorstand	Aktien	Optionen
Dr. Anton Mindl	12.225	0
Reinhard Senf	3.923	40.000
Dr. Frank Rottmann	1.975	6.200
Nicolaus Graf von Luckner	2.975	0
Aufsichtsrat	Aktien	Optionen
Prof. Dr. Günter Zimmer	0	0
Dr. Burkhard Dreher	1.900	0
Jörns Haberstroh	3.956	0
Dr. Klaus Weyer	10.000	25.000
Dr. Peter Thoma	9.200	40.000
Jutta Weber	200	0

Mitglieder des Aufsichtsrats hielten zusammen indirekt 33% der Aktien der Gesellschaft.

Entsprechenserklärung

Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG erklären gemäß §161 AktG: Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (kurz: DCGK) in der Fassung vom 14. Juni 2007 mit folgenden Ausnahmen:

- ▶ Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCGK Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- ▶ Die Vergütung der Vorstandsmitglieder wird sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen Komponenten, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktioptionen) ausgewiesen. Jedoch erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK Nr. 4.2.4). Von der durch das Vorstandsvergütungsoffenlegungs-Gesetz vom 03. August 2005 eingeführten Rechtspflicht zu einer individualisierten Offenlegung der Vorstandsvergütungen ist die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Mai 2006 für einen Zeitraum von fünf Jahren befreit.
- ▶ Auch die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Corporate Governance Bericht angegeben (DCGK Nr. 5.4.7).
- ▶ Der Vorsitz und die Mitgliedschaft in Aufsichtsratsausschüssen werden nicht gesondert vergütet (DCGK Nr. 5.4.7).



Dortmund, im Dezember 2007

Der Aufsichtsrat

Der Vorstand

Unsere Verantwortung



Verantwortung für unsere Mitarbeiter

Prinzip der
„offenen Türen“

Unsere Mitarbeiter sind unsere wertvollste Ressource und eine große Stärke zur Erreichung unserer unternehmerischen Ziele. Aus diesem Grund sind wir uns unserer sozialen Verantwortung, die wir für unsere Mitarbeiter als Arbeitgeber tragen, bewusst und erfüllen diese mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit. Die Fluktuation ist seit Jahren sehr gering und spiegelt die Kontinuität und das Zusammengehörigkeitsgefühl in unserem Unternehmen wider. Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg unseres Unternehmens. Der offene und kooperative Stil der Unternehmenskultur findet sich in allen Bereichen unseres Unternehmens wieder. Das Prinzip der „offenen Türen“ ist daher ein wichtiger Grundsatz in unserem Konzern. Ein Schwerpunkt der nachhaltigen Strategie ist die Schaffung von beruflichen Perspektiven für unsere Mitarbeiter. Daher fördern wir aktiv die Kreativität und geben den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihr persönliches Potenzial zu erweitern und herausragende Leistungen zu erbringen.



Verantwortung für unsere Umwelt

Unser Ziel ist es, Ökologie und Ökonomie in Einklang zu bringen. Im Idealfall verringern wir mit einer Maßnahme die Umweltauswirkungen, verbessern die Arbeitssicherheit und erzielen ökonomische Einspareffekte. Wir wollen, dass Mitarbeiter und Anwohner in einer gesunden Umwelt leben.

Seit mehr als zehn Jahren betreibt ELMOS aktiv Maßnahmen, die über den gesetzlichen Umwelt- und Gesundheitsschutz hinausgehen. Um dies auch nach außen zu dokumentieren, wurde ein integriertes Umwelt- und Gesundheitsschutz-Managementsystem eingeführt und im Jahr 2003 erstmals nach ISO 14001:2004 zertifiziert.

Umweltschutz, Gesundheitsschutz und Qualität sind bei ELMOS gleichberechtigte Inhalte des Managementsystems. Die tragenden Säulen unseres Umweltmanagementsystems sind einerseits die enge Zusammenarbeit von Umweltmanagementbeauftragtem, Bereichs- und Abteilungsleitern und andererseits das Engagement unserer Umweltauditoren und Mitarbeiter. Zusätzlich gefördert wird unser System durch den kontinuierlichen Einsatz unserer Schulungsteams in Umwelt- und Sicherheitsfragen sowie durch Aktionen zur langfristigen Förderung des Gesundheitsschutzes.

Tragende Säulen des
Umweltmanagementsystems

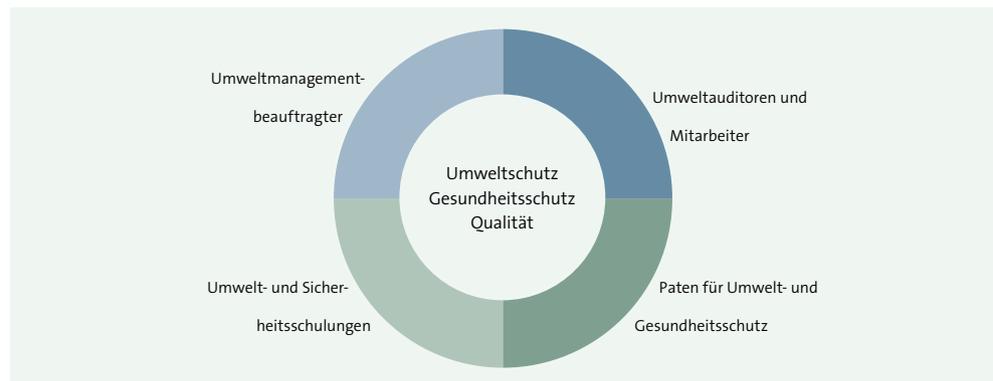
In jedem Jahr werden zahlreiche Vorschläge unserer Mitarbeiter zu Verbesserungen im Umwelt- und Gesundheitsschutz in den Bereichen geprüft und nach Prioritäten geordnet umgesetzt. Eine weitere Stärkung unserer Aktivitäten im Umwelt- und Gesundheitsschutz erwarten wir durch die Berufung von Paten in der Produktion, deren besonderes Augenmerk dem Umwelt- und Gesundheitsschutz in den jeweiligen Bereichen gilt. Sie sollen als Ansprechpartner vor Ort Umweltthemen aufgreifen und an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Ein Beispiel für das hohe Engagement unserer Mitarbeiter ist ein Projekt zur Wassereinsparung. Für die Halbleiterherstellung ist Wasser eine wertvolle Ressource, die in zahlreichen Arbeitsschritten benötigt wird. Große Mengen von deionisiertem und reinstem Wasser (DI-Wasser) werden für Spül- und Reinigungsvorgänge in der Produktion benötigt. Dadurch bedingt wird mit steigender Produktion mehr Frischwasser für die Erzeugung von DI-Wasser eingesetzt. Das Ziel war es, den Wasserverbrauch trotz weiter steigender Produktion erheblich zu senken. Dazu haben Mitarbeiter des Facility Managements ein neues Konzept für die innerbetrieblichen Wasserkreisläufe entwickelt. Die Idee dahinter: Das eingesetzte Weichwasser durch das bisher nicht genutzte Konzentrat- und Recyclingwasser zu ersetzen. Mit geringem Aufwand konnten die erforderlichen Leitungen verlegt werden und dann begann der Versuch: Von Monat zu Monat wurde ein steigender Anteil des Weichwassers gegen das Konzentrat- und Recyclingwasser ausgetauscht. Nach einem Jahr des kontinuierlichen Anstiegs des Anteils an Konzentrat- und Recyclingwasser ist das Ergebnis, dass das Weichwasser problemlos ersetzt werden kann. Durch diese Idee konnte ELMOS den Verbrauchsanstieg beim Frischwasser auf 4% begrenzen und hat insgesamt mehr als 30.000m³ Frischwasser weniger als vorher benötigt.

30.000m³ Frischwasser
eingespart



Alle Daten und Fakten zu unserer Verantwortung für die Umwelt publizieren wir jährlich in einem Umweltbericht, der umfassend über den Umweltschutz, die Arbeitssicherheit und die Umweltauswirkungen am Standort Dortmund informiert. Dieser Umweltbericht steht auf unserer Homepage zum Herunterladen zur Verfügung oder kann kostenlos angefordert werden.



Verantwortung für die Gesellschaft

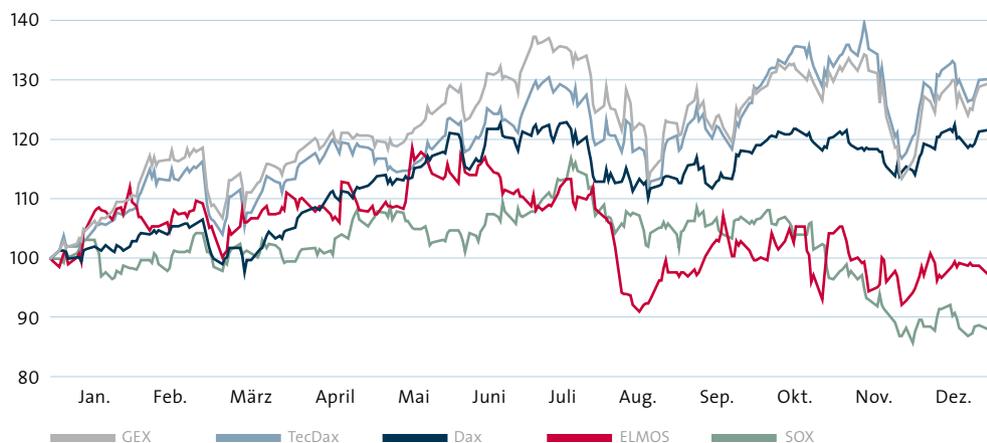
Es ist uns als Unternehmen ein wichtiges Anliegen, auch Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. Die Jugend- und Ausbildungsförderung gehört für uns zur Verantwortung, ebenso wie die Unterstützung von wohltätigen Einrichtungen. Wir beabsichtigen, im Sinne der Nachhaltigkeit, auch jenseits unserer Geschäftsinteressen einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und soziale Verantwortung zu übernehmen. In den vergangenen Jahren haben wir durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Spendenaktionen Beiträge zur Minderung akuter Probleme im In- und Ausland geleistet. Durch unsere Spenden unterstützen wir natürlich auch regionale Einrichtungen. So haben wir unter anderem für die Dortmunder Tafel e.V. gespendet und die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund sowie Universitäten unterstützt. Wir sehen es aber zudem als unsere gesellschaftliche Verpflichtung an, jungen Menschen die Möglichkeit einer qualifizierten Ausbildung zu geben. Die heutigen Auszubildenden sind unsere Fachleute von morgen. Knapp die Hälfte der jeweils neuen Auszubildenden erlernt typischerweise den Beruf des Mikrotechnologen, der auf die Arbeit in der Reinraum-Produktion ausgerichtet ist. Neben Mikrotechnologen bieten wir eine Vielzahl von Ausbildungsgängen an, die den Interessen und Talenten der künftigen Mitarbeiter entgegenkommen.

Spezielle Ausbildung für die Arbeit im Reinraum

Unsere Aktie

Allgemeine Entwicklung an den Börsen

Relative Kursentwicklung 2007



Die allgemeinen Marktindizes konnten in 2007 zum Teil recht kräftig zulegen, trotz einiger Turbulenzen an den Aktienmärkten bedingt durch den stark gestiegenen Ölpreis und die durch den amerikanischen Markt ausgelöste Kreditkrise. Halbleiteraktien profitierten jedoch nicht von dieser allgemein positiven Entwicklung in 2007. Während der DAX 22% gewann, verlor der Philadelphia Semiconductor Index 12%. Mit einem Verlust von 3% hat sich die ELMOS-Aktie im Halbleiterumfeld somit gut behauptet. Sie erreichte ihr Jahreshoch von 8,99 Euro am 17. Mai 2007. Durch die Auswirkungen der Kreditkrise brachen die Märkte generell ein. Obwohl ELMOS von der Krise in keiner Weise tangiert ist, fiel die Aktie und erreichte am 13. August 2007 ihr Jahrestief von 6,90 Euro und pendelte sich in den darauffolgenden Monaten zwischen sieben und acht Euro ein. Am Jahresende notierte die Aktie bei 7,35 Euro.

Jahresschlusskurs von
7,35 Euro

ENTWICKLUNG DER ELMOS-AKTIE

Zeitraum bis 31. Dezember 2007	Seit 1.1.2006	Seit 1.1.2007
ELMOS (Xetra)	- 18,3%	- 3,0%
Branchenindizes		
TecDax	63,3%	30,2%
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	- 14,5%	- 12,4%
Prime Technology	12,5%	- 14,7%
Prime Automobile	73,3%	37,9%
Allgemeine Marktindizes		
Dax	49,2%	22,3%
GEX	66,7%	30,3%

Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der ELMOS-Aktie (Xetra und Frankfurt am Main) betrug rund 26 Tausend Aktien und lag damit unter dem Vorjahreswert (rund 37 Tausend Aktien täglich). Rund 90% der Aktien wurden auf Xetra gehandelt.

ELMOS-AKTIEKENNZAHLEN

Stammdaten

ISIN	DE0005677108
WKN	567710
Börsenkürzel	ELG
Reuters	ELGG.DE
Bloombergkürzel	ELGG.GR
Prime Branche	Technologie
Industry Group	Semiconductors

	2006	2007
Ausstehende Aktien in Stück	19.413.805	19.414.205
Höchstkurs (Xetra)	10,60 Euro 9.2.	8,99 Euro 17.5.
Tiefstkurs (Xetra)	6,67 Euro 18.7.	6,90 Euro 13.8.
Jahresendkurs (Xetra)	7,58 Euro	7,35 Euro
Jahresperformance (ohne Dividende)	- 15,8%	- 3,0%
Marktkapitalisierung am Jahresultimo	147,2 Mio. Euro	142,7 Mio. Euro
Marktwert zu Buchwert* am Jahresultimo	1,0	0,9
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag	37,2 Tsd.	25,6 Tsd.
Ergebnis je Aktie	0,55 Euro	0,45 Euro
Dividende je Aktie	0,00 Euro	0,00 Euro**

* Bilanzielles Eigenkapital | ** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2008

Die Marktkapitalisierung von ELMOS betrug zum Jahresende 142,7 Mio. Euro basierend auf 19,4 Millionen ausstehenden Aktien. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich 2007 durch Ausübung von Aktienoptionen nur unwesentlich verändert.

Im Rahmen eines Stock Award Programms hat ELMOS im August 2007 29.000 Aktien zurückgekauft, die im Laufe des Jahres an Mitarbeiter und Vorstände übertragen wurden. ELMOS plant, auch künftig solche Stock Award Programme durchzuführen.

Basisinformationen zur Aktie

Die ELMOS-Aktie ist eine Inhaberaktie ohne Nennwert (Stückaktie). Sie wird an allen deutschen Wertpapierbörsen sowie im Xetra-System gehandelt. Als Emittent im Prime Standard erfüllt ELMOS höchste Transparenzanforderungen, die über das Maß des General Standards und somit auch über die EU-regulierten Transparenzregeln hinausgehen.

Aktionärsstruktur

Das Grundkapital der ELMOS Semiconductor AG ist eingeteilt in 19.414.205 nennwertlose Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden, anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro. Von diesen Aktien werden 52,9% (rund 10,3 Millionen Aktien) von der ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) gehalten.

47,1% der Aktien (rund 9,1 Mio. Aktien) befinden sich im Streubesitz. Abgesehen von der EFH hält zum Ende des Berichtsjahres die Credit Suisse mehr als 3% des Grundkapitals von ELMOS.

Angaben zum Wertpapier

Art der Aktien (Gattung)	Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Transparenzlevel	Prime Standard
Marktsegment	Regulierter Markt
Börsengang	11. Oktober 1999
Designated Sponsors	HSBC Trinkaus & Burkhardt, WestLB
Indexzugehörigkeit	CDax, GEX, Prime All Share, Tech All Share

Investor Relations

Im Jahr 2007 haben das ELMOS Management und das Investor Relations Team Einzelgespräche mit Investoren im Rahmen von Roadshows und Konferenzen, auf denen sich ELMOS präsentiert hat, und bei Unternehmensbesuchen am Standort Dortmund und Duisburg, geführt. Darüber hinaus informierten wir Analysten und Investoren in Form von Telefonkonferenzen im Anschluss an die Veröffentlichung von Ergebnissen und auf Wunsch auch einzelne Aktionäre. Hiermit ermöglichen wir unseren Aktionären und anderen interessierten Kapitalmarktteilnehmern, unsere Geschäftslage angemessen zu bewerten und insbesondere unsere Perspektiven einzuschätzen. Unser Ziel ist es, frühzeitig und umfassend zu informieren und jederzeit erreichbar zu sein – für private und institutionelle Investoren, für Analysten und interessierte Anleger. Per Ende 2007 empfiehlt die Mehrheit der ELMOS beurteilenden Analysten die Aktie positiv.

Im Bestreben nach umfassender und zeitnaher gleicher Information für alle Zielgruppen haben wir auf unserer Website zahlreiche Unternehmensinformationen bereitgestellt. Interessierte Anleger können sich im Internet unter www.elmos.de ausführlich über das Unternehmen, seine Produkte und Technologien informieren. In der Sektion Investor Relations werden neben Informationen zur Corporate Governance auch Finanzberichte (Geschäfts- und Quartalsberichte), ein Finanzkalender zu allen wesentlichen Terminen und Veröffentlichungen, die Satzung der Gesellschaft, Informationen zur Hauptversammlung, Pressemitteilungen und meldepflichtige Wertpapiergeschäfte präsentiert. Im Jahr 2007 wurde die komplette Internetseite neu gestaltet, so dass diese noch benutzerfreundlicher zu bedienen ist. Das Investor Relations Team verschickt zudem Informationen, wie Geschäftsbericht oder Quartalsberichte, auch gern per Post.

Hauptversammlung

An der achten Ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2007 nahmen, wie in den vergangenen Jahren, rund 300 private und institutionelle Investoren teil. Die Veranstaltung fand wiederum im Casinosaal Hohensyburg in Dortmund statt. Es waren 12.560.317,00 Euro oder 64,7% des Grundkapitals präsent. Die Vorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten nahm die Hauptversammlung mit deutlicher Mehrheit an. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stand die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, eine Ergänzungswahl zum Aufsichtsrat, die Beschlussfassung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen verbunden mit der Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechender Satzungsänderungen sowie eine Satzungsänderung hinsichtlich Bekanntmachungen auf der Agenda.

Bei der Hauptversammlung 2007 ist von der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, erneut rege Gebrauch gemacht worden. Aktionäre, die nicht persönlich vor Ort waren, konnten auch im vergangenen Jahr die Hauptversammlung wieder live oder nachfolgend als Aufzeichnung im Internet verfolgen. Auch bei der Hauptversammlung am 08. Mai 2008 haben Aktionäre und interessierte Anleger wieder die Möglichkeit, die Internetübertragung zu nutzen. Zudem können Aktionäre ihr Stimmrecht selbst ausüben oder entweder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

Research-Coverage

Cheuvreux
 Credit Suisse
 Dawnay, Day Lockhart
 DZ Bank
 Exane BNP Paribas
 Fairesearch
 HSBC Trinkaus & Burkhardt
 Natixis Securities
 SES Research
 Viscardi Securities
 WestLB



KONTAKT

ELMOS SEMICONDUCTOR AG
 Investor Relations
 Heinrich-Hertz-Straße 1
 44227 Dortmund
 Deutschland
 Telefon +49 (0) 231-75 49-287
 Telefax +49 (0) 231-75 49-548
invest@elmos.de
www.elmos.de



KONZERNLAGEBERICHT

Geschäft und Rahmenbedingungen	45
Geschäftstätigkeit	45
Strategie	47
Organisationsstruktur	49
Rahmenbedingungen	51
Produktion	53
Forschung und Entwicklung	54
Mitarbeiter	55
Qualität, Sicherheit und Umweltschutz	56
Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	57
Abschluss nach IFRS	57
Umsatzentwicklung	58
Ertragslage	60
Finanzlage	63
Vermögenslage	65
Berichterstattung nach §315 Abs. 4 HGB	67
Risiko- und Chancenbericht	69
Risiko- und Chancenmanagementsystem	69
Risiken	69
Chancen	72
Nachtragsbericht	73
Prognosebericht	74

Geschäft und Rahmenbedingungen

Geschäftstätigkeit

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte, zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2007 entfielen rund 90% vom Umsatz auf dieses Marktsegment. Seit ihrer Gründung hat sich ELMOS eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. Basierend auf einer Studie des Marktforschungsinstituts Gartner Dataquest aus dem März 2007 wird ELMOS als die weltweite Nummer zwei (Vorjahr Nummer drei) im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt nach STMicroelectronics aufgeführt. Die direkten Wettbewerber AMI Semiconductor und Melexis folgen auf den Plätzen vier und fünf.

ELMOS ist weltweit die Nummer 2 bei ASICs für Fahrzeuge

ELMOS-Chips werden von nahezu allen europäischen sowie zahlreichen amerikanischen und asiatischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und die Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs sowie an Sicherheit und Komfort führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Automobile Neuprojekte benötigen in der Regel zwei bis drei Jahre Entwicklungszeit, bevor sie für etwa fünf bis acht Jahre in Serie produziert werden. Teilweise verlängert sich diese Produktionszeit erheblich, wenn Autohersteller eine ähnliche technische Plattform in einer Familie von neuen Modellen einsetzen. Zum Zeitpunkt des Gewinns eines Neuprojekts werden in der Regel die Preise in Abhängigkeit von den geplanten Mengen für die gesamte Projektlaufzeit kalkuliert.

Neben dem automobilen Markt ist ELMOS zudem im Industrie- und Konsumgüterbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise z.B. für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Dieser nicht-automobile Bereich hat im vergangenen Jahr, wie in den Vorjahren, rund 10% des Umsatzes ausgemacht.

Industrie- und Konsumgüterbereich rückt stärker in den Fokus

Seit mehr als 20 Jahren bedient ELMOS Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch die kundenspezifische Produktentwicklung und zum anderen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen ausgerichtete Fertigungstechnologie zu überzeugen. So entwickelt ELMOS derzeit noch überwiegend Produkte im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für den jeweiligen Kunden.

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die mehr als 90% der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren. ELMOS produziert ASICs und ASSPs bislang fast ausschließlich in den eigenen Produktionsstätten (Wafer-Fabs) in Dortmund und Duisburg. Sowohl



durch die automobilgerechte Hochvolt-CMOS-Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip-Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

Mikromechanische Bauelemente (MEMS) entwickeln, produzieren und vertreiben wir bei unserer Tochtergesellschaft Silicon Microstructures (SMI), welche zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium zählt. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (ELMOS AP) mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, das Technologie- und Produktportfolio. ELMOS AP entwickelt und fertigt Spezialgehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS AP wurde im Geschäftsjahr 2007 komplett auf kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse ausgerichtet, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden. Neben der konzerninternen Assemblierung fertigt ELMOS AP auch Spezialgehäuse für Drittkunden.

Mikrosysteme bestehen aus
Halbleiter und Sensor
in einem Spezialgehäuse

Die Entwicklung und Vermarktung von anwendungsspezifischen, mikro-mechatronischen Modulen, realisiert durch ELMOS Microsystems, runden die Produktpalette ab. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann der Kunde kostengünstige Systemlösungen realisieren.

Strategie

Die Strategie von ELMOs umfasst als Kernelemente den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft, den verstärkten Vertrieb von ASSPs zur Ergänzung des existierenden Produkt- und Kundenportfolios, die Vereinbarung von Kooperationen zur Reduzierung der Investitionen und Ergänzung des existierenden Technologie- und Produktportfolios, die Etablierung des Mikrosystem-Geschäfts als Wachstumssäule des Unternehmens sowie die stärkere Bedienung der Konsumgüter- und Industriemärkte. Regional haben wir die Zielsetzung, stärker am Wachstum in Asien zu partizipieren. Im Berichtsjahr konnten wir bei der Umsetzung der Strategie erhebliche Fortschritte erzielen.

AUTOMOBILES ASIC-GESCHÄFT

Der Gewinn von wichtigen Folgeaufträgen für kundenspezifische Halbleiter im Automobil im Jahr 2007 unterstreicht den Ausbau der starken Position im automobilen ASIC-Geschäft. Die Kernkompetenzen im Bereich der effizienten Motoransteuerung für Klimaanlage sowie verschiedene Airbag-ICs standen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber sind u.a. langjährige Kunden aus der Automobilindustrie. Diese Folgeaufträge bestätigen das Vertrauen der Kunden in eigens entwickelte Halbleiterlösungen. Das Volumen der Aufträge stellt das mittelfristige Wachstum der Gesellschaft auf eine solide Basis.

Großes Vertrauen
der Kunden

Die Pflege enger Kundenbeziehungen und deren Intensivierung sind für uns nach wie vor von hoher Bedeutung. So haben wir im Berichtsjahr bereits zum wiederholten Mal eine In-house Kundenveranstaltung durchgeführt, bei der zahlreiche Vertreter der Automobilindustrie aktuelle Trends der Fahrzeug-Elektronik präsentierten. Unter dem Motto „Mega-Trends und Nischen: Standardisierung, Modularisierung und Differenzierung durch Elektronik“ haben renommierte Referenten von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai-Kia, Opel, VW und Tyco Electronics AMP vorgetragen.

ASSPS

Im Jahr 2007 haben wir die Entwicklung und den Vertrieb von Applikations-Standards (ASSPs) stark vorangetrieben. Hierbei fließen insbesondere patentrechtlich geschützte Verfahren wie HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System) und VirtuHall® ein, die für ELMOs und unsere Kunden Wettbewerbsvorteile bringen. Eine derartige Familie von Applikations-Standards erlaubt dem Anwender die schnelle und einfache Realisierung von intelligenten Lösungen, z.B. für Sensor- bzw. Antriebsanwendungen.

Bei der Entwicklung der ASSPs fokussieren wir uns auf unsere Kernkompetenzen in den Bereichen „Sense“, „Drive“, „Connect“ und „Supply“. Im Bereich „Sense“ entwickeln wir neue Sensorelemente, Sensorauswerte-ICs und Mikrosysteme für verschiedene physikalische Messgrößen. Das ELMOs-eigene VirtuHall® Prinzip zur effizienten Ansteuerung von EC-Motoren schlägt sich in einer ganzen IC-Familie für den Bereich „Drive“ mit verschiedenen Derivaten nieder. Für die Produktgruppe „Connect“ stehen zahlreiche standardisierte Bus-ICs zur Verfügung, die sowohl im Auto als auch in der Industrie vermehrt eingesetzt werden. Für die Applikationsgruppe „Supply“ werden neue Schaltungskonzepte in die Tat umgesetzt, um unseren Kunden hoch effizien-

Kernkompetenzen „Sense“,
„Drive“, „Connect“ und „Supply“

te DC/DC-Wandler – beispielsweise für LED-Beleuchtungen in Fahrzeugen oder in Gebäuden – anzubieten. Die Produkte sind für einen Einsatz sowohl in Automobil- wie auch in Industrie- und Konsumgüterapplikationen geeignet.

Weitere im Jahr 2007 durchgeführte Maßnahmen, die den gestiegenen Stellenwert der ASSPs für ELMOS unterstreichen, sind die Verbreiterung der Distributorenbasis, die Neugestaltung der Webseite, die im Produktbereich nun eine Suche nach ASICs oder ASSPs ermöglicht, sowie der neu aufgelegte, mit 64 Produkten auf über 130 Seiten deutlich erweiterte Standard-Produktkatalog.

KOOPERATIONEN

Um langfristig ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio anzubieten und gleichzeitig dauerhaft einen positiven Free Cash Flow zu generieren, ist es die Strategie von ELMOS, mit Partnern zu kooperieren und dadurch die eigenen Fähigkeiten sinnvoll zu ergänzen. Dies ermöglicht gleichzeitig eine Reduktion der Investitionen bzw. Entwicklungsaufwendungen für ELMOS.

ELMOS verfolgt sowohl den Ansatz sogenannter Zwei-Chip-Lösungen, bei denen Chips von zwei unterschiedlichen Herstellern in einem Package assembliert werden können, als auch den der Fremdfertigung, bei der i.d.R. große Halbleiterfoundries in von ELMOS nicht angebotenen Technologien nach unseren Konstruktionsplänen produzieren. Beispielsweise haben wir in 2007 mit einer taiwanesischen Foundry funktionsfähige Chips für ein Konsumgüterprodukt realisiert. Darüber hinaus haben wir Anfang 2008 mit einem Partner einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dabei werden wir zusammen mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip einerseits eine neue Technologie entwickeln und andererseits dort fertig prozessierte Wafer beziehen. Wir können dadurch mittelfristig unseren Investitionsbedarf reduzieren und flexibler auf stark schwankende Stückzahlen reagieren.

Verlagerung der
Standard-Chip-Verpackungen
abgeschlossen

Darüber hinaus haben wir in 2007 unsere seit vielen Jahren bewährten Partnerschaften mit unseren Packaging-Dienstleistern in Südostasien weiter intensiviert. So wurde Mitte 2007 die Verlagerung der Standard-Chip-Verpackungen von ELMOS Advanced Packaging nach Asien abgeschlossen.

MIKROSYSTEME

ELMOS ist eines der wenigen Unternehmen, welches komplette Mikrosysteme, bestehend aus ASICs und MEMS in einem kundenspezifischen Package, vollständig entwickeln und produzieren kann. Mit dieser Fähigkeit hebt sich ELMOS klar von seinen Wettbewerbern ab und offeriert einen einzigartigen Vorteil.

In 2007 hat der Vorstand bei SMI eine neue Geschäftsführung eingesetzt, um zukünftig die Marktchancen für Mikrosysteme besser und zuverlässiger zu nutzen. Zudem wurde ein Restrukturierungs- und Ergebniskorrekturbedarf für 2007 festgestellt. Dies hatte auch Auswirkungen

auf den Standort in den Niederlanden. Aufgrund von verspäteten SMI-Produktanläufen musste in den Niederlanden die Struktur angepasst werden.

NEUE MÄRKTE

Nach der Gründung von ELMOS Industries Ende 2006 wurden in 2007 die Grundlagen dafür geschaffen, dass die nicht-automobilen Märkte, d.h. Industrie- und Konsumgütermärkte, mittelfristig einen Anteil von 20% bis 30% des Gesamtumsatzes ausmachen können.

So sind im Berichtsjahr bereits einige ASIC-Projekte aus dem Bereich der Heizungssteuerung, Industrie-Bus-Applikation, Industriesteuerung, etc. entstanden, die teilweise bereits in Serie produziert und an die Kunden ausgeliefert werden. Weitere ASIC- und ASSP-Projekte werden derzeit mit mehreren Kunden verhandelt, so dass eine deutliche Steigerung des Umsatzes in diesem Segment in den nächsten Jahren erwartet wird.

Mit dem Gewinn eines Auftrags von einem großen japanischen Elektronikkonzern konnte im Berichtsjahr ein signifikanter Erfolg auf dem asiatischen nicht-automobilen Markt verzeichnet werden. Das Produkt ist ein neuer Chip basierend auf unserem patentierten HALIOS®-Prinzip, welches u.a. die kontaktlose dreidimensionale Erfassung von Gegenständen oder Bewegungen ermöglicht. Die damit realisierbaren berührungslosen Schalter sollen 2008 in erste Applikationen aus dem Konsumgüterbereich, beispielsweise in Fernbedienungen, MP3-Playern, Telefonen und Computer-Peripheriegeräten, verbaut werden.

Auftrag eines großen japanischen Elektronikkonzerns gewonnen

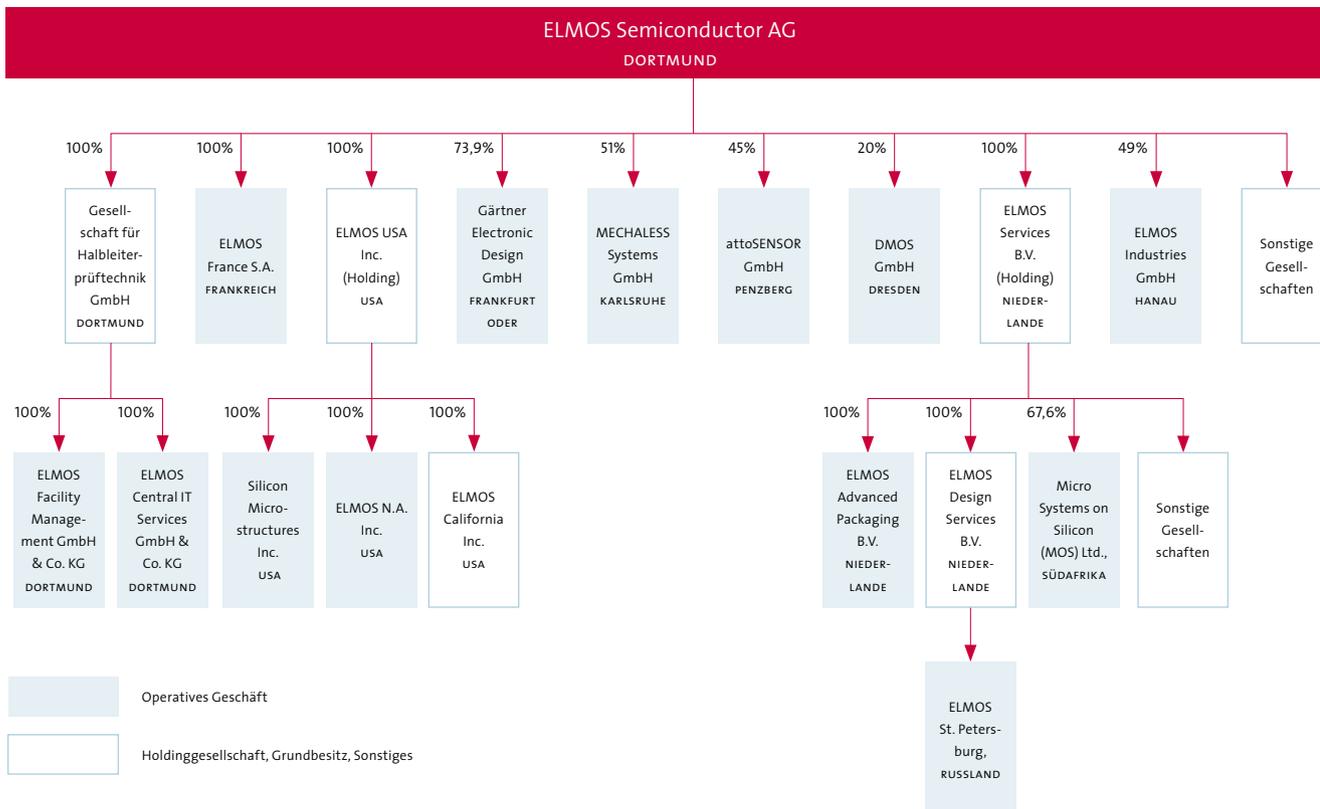
Organisationsstruktur

Die ELMOS-Struktur orientiert sich an den Anforderungen der Kunden, insbesondere der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der Struktur der ELMOS-Gruppe wider.

Enge Kunden-Lieferantenbeziehung

Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort. Neben den produzierenden Standorten in Dortmund, Duisburg, Nijmegen/Niederlande und Milpitas/Kalifornien/USA umfasst dies unter anderem die Niederlassungen in München und Stuttgart und die Tochtergesellschaften ELMOS France, ELMOS North America, MECHALESS, DMOS, GED und attoSensor. ELMOS France betreut Frankreich und Südeuropa und bietet Applikationsunterstützung und Customer Service vor Ort. Der französische Markt ist für ELMOS neben Deutschland die wichtigste Region. ELMOS North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei Detroit/USA aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie. In Asien ist ELMOS mit Repräsentanten in Japan und Korea vertreten.

Im Zuge des vermehrten Absatzes von ASSPs und nicht-automobilen Produkten vertreibt ELMOS ihre Produkte zusätzlich über verschiedene Distributoren. So wurde im Jahr 2007 die Vermark-



tung mit der Auswahl von zusätzlichen Distributoren auf neue Beine gestellt. Die ELMOS-Gruppe arbeitet nun mit zahlreichen Partnern in Europa und Asien zusammen. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen aus der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der Medizintechnik. Die Distributoren zeichnen sich durch ein breites Kundenspektrum, großes Applikationsverständnis und hohe Zuverlässigkeit aus.

In der Segmentberichterstattung unterscheidet ELMOS zwischen den Bereichen Halbleiter und Mikromechanik. Das Segment Mikromechanik reflektiert die Geschäftstätigkeit von SMI. Die weiteren Gesellschaften und Aktivitäten werden im Segment Halbleiter geführt.

BEZIEHUNGEN ZU VERBUNDENEN UNTERNEHMEN

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 52,9% größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG.

Rahmenbedingungen des automobilen Halbleitermarkts

Der für EL MOS wichtigste Markt ist der der Halbleiterchips für die Automobilindustrie. Dieser Markt stellt einen Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Er umfasst weltweit einen Anteil von rund 7% des gesamten Halbleitermarkts. Bedingt durch den Einfluss der relativ konstanten Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobilen Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch lange Produktlebensdauer und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren. Zudem unterscheidet sich der Markt durch langfristige Kunden-Lieferanten-Beziehungen und die sehr hohen Qualitätsanforderungen sowie robuste Halbleitertechnologien.

In 2007 war die Basis unseres Kerngeschäfts – der Automobilssektor – in Westeuropa, insbesondere in Deutschland, und in den USA schwach. Dies ist u.a. auf den Ölpreis, die in den USA ausgelöste Kreditkrise und deren Einfluss auf das Konsumverhalten sowie den schwachen Dollarkurs zurückzuführen. Dennoch konnten einige deutsche Automobilhersteller signifikante Erfolge im Export erzielen.

Basierend auf einer Studie des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) wird in dem Zeitraum von 2006 bis 2011 insgesamt mit einer jährlichen Zunahme der Automobilproduktion um 4% gerechnet. Dabei schneiden Nordamerika und Deutschland mit mittleren jährlichen Produktionszunahmen zwischen 1% und 2% am schwächsten ab. Für Osteuropa und Asien werden signifikante Produktionszuwächse, zum Teil im zweistelligen Bereich, erwartet.

Während im Jahr 1985 bei einem PKW der Mittelklasse der Anteil elektronischer Systeme an den gesamten Produktionskosten nur 3% ausmachte, liegt heute dieser Wertanteil bereits bei etwa 22% des Produktionswertes. Gleichzeitig beträgt der Wert der Halbleiter etwa 12%. Aufgrund von zunehmender Integration elektronischer Systeme und wegen neuen Technologien wird erwartet, dass der Halbleiteranteil überproportional steigen wird. So soll der Wertanteil aller elektronischen Steuerungen im Fahrzeug bis Mitte der 2020er Jahre auf etwa 30% und der der Halbleiterbauelemente auf über 20% der Produktionskosten wachsen. Für die nächsten Jahre werden von verschiedenen Marktforschungsinstituten Wachstumsraten von 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt erwartet.

Wertanteil der Elektronik
am Auto: rund 22%

Treibende Elemente dieses Wachstums sind neben der stark weiter wachsenden Zahl von Dieselfahrzeugen mit aufwendiger Steuerung auch die neuen Benzinmotoren mit Hochdruck-Direkteinspritzung. Dazu kommen immer strenger werdende gesetzliche Abgasvorschriften, welche den Bedarf an aufwendigeren elektronischen Systemen verursachen. Großes Wachstum zeigen auch Systeme, die dem Personenschutz dienen, wie beispielsweise Fahrzeugstabilisierungssysteme.

Treibende Faktoren:
Umweltschutz und Sicherheit

ASICs sind auf einen festen
Kunden zugeschnitten

Der von ELMOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter (ASICs), und der applikationsspezifischen Halbleiter (ASSPs). Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche eine hohe Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten benötigen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die unter anderem aus dem Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. ASSPs unterscheiden sich insofern von ASICs, als dass diese von mehreren Kunden eingesetzt werden können, jedoch genau wie ASICs auf eine bestimmte Applikation zugeschnitten sind. Wettbewerber von ELMOS bei typischen ASIC- und ASSP-Projekten mit mittleren Stückzahlen sind Firmen ähnlicher Größe wie AMI Semiconductor, Melexis, austria micro systems und Micronas. Bei sehr großen Stückzahlen steht ELMOS auch in Konkurrenz zu Großproduzenten wie Infineon, STMicroelectronics und Freescale.

Im Jahr 2007 hat sich der Trend der Vorjahre fortgesetzt. Die Konsolidierung im Automobilmarkt hält unvermindert an, die Anzahl der Zulieferer sinkt. Die durchschnittlichen Volumina der Projekte steigen an und damit auch der Preisdruck. Dieser wird von den Automobilherstellern in Form von Kostensenkungsprogrammen an die so genannten „Tier 1“ Hersteller, die Zulieferer der ersten Reihe, weitergegeben. Diese reichen den Preisdruck bei der Verhandlung von Neuprojekten an ihre Zulieferer weiter.

Produktion



In 2007 wurden insgesamt rund 150 Millionen Chips produziert. Dabei hat sich der Trend der Vorjahre, steigende Anforderungen an die Produkte und damit deren Komplexität, gemessen an der Anzahl der zu strukturierenden Ebenen (Layer), weiter fortgesetzt.

150 Millionen Chips
produziert

Die 2007 an Kunden ausgelieferten ASICs und ASSPs wurden nach wie vor überwiegend am Hauptstandort Dortmund auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) produziert. Die 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) am Produktionsstandort Duisburg wurde hochgefahren. Die Fertigung wurde am Jahresende 2007 noch nicht in der vollen Kapazität genutzt. Um Qualität und Stabilität von Produkten und Prozessen zu gewährleisten, haben wir in der zweiten Hälfte des letzten Quartals 2007 die Wafereinstellung nicht weiter gesteigert. Die zweite Halbleiterproduktionsstätte ist sowohl zur Absicherung der Versorgung als auch für die Nutzung der Kostensenkungspotenziale aufgrund des größeren Waferdurchmessers bedeutend.

Erfreulich ist, dass im Laufe des Jahres 2007 ausreichend Kundenfreigaben zur Füllung der vorhandenen Kapazität am Standort Duisburg gewonnen werden konnten. Die in Duisburg gefertigten Produkte haben im Berichtsjahr einen wichtigen Beitrag zur Kundenversorgung geleistet. In 2008 wird der Ausbau in Duisburg fortgesetzt. Insbesondere werden Einzelinvestments zur Beseitigung von Maschinenengpässen und Schaffung von Redundanzen zur Volumenstabilisierung vorgenommen.

Ausbau des Standortes Duisburg
wird fortgesetzt

Der Fertigungsanteil von 8-Zoll-Wafern aus Duisburg soll weiter hochgefahren werden, so dass die nötige Kapazität für die Erweiterung und Umstellung der Fertigung am Hauptsitz in Dortmund planmäßig zur Verfügung stehen wird. Mitte 2008 soll dann mit der schrittweisen Umstellung der Produktionslinie in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll-Wafer begonnen werden. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein zur Erweiterung der Fertigungskapazitäten und zur Steigerung der Produktivität. Fertigungsflächen für die schrittweise Umstellung eines Teils der Dortmunder Waferfertigung auf 200mm-Waferdurchmesser sind vorhanden.

Im Jahresdurchschnitt 2007 lag die Maschinenkapazität insgesamt bei rund 580 Waferstarts pro Tag (6-Zoll-waferäquivalent). Dies entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahresende 2006 (31. Dezember 2006: 480 Waferstarts pro Tag), welcher durch den Ausbau der Ferti-

gungslinie Duisburg begründet ist. Die durchschnittliche Ausnutzung mit rund 550 Waferstarts pro Tag ist ebenfalls stark gestiegen (2006: rund 430 Waferstarts pro Tag).

Waferstarts pro Tag stark gestiegen Neben den eigenen Fertigungsstätten soll zukünftig die erforderliche Kapazität auch durch Auftragsfertigungen (Foundries) bereitgestellt werden. Hierzu wurde nach Ende des Berichtsjahres bekannt gegeben, dass wir mit dem koreanischen Unternehmen MagnaChip kooperieren werden. Diese Kooperation ermöglicht es ELMOS, flexibel auch auf stärker schwankende Nachfrage reagieren zu können. Im Berichtsjahr wurde bereits mit einer taiwanesischen Foundry ein Konsumgüterprojekt gestartet und Prototypen produziert. Die Möglichkeit der Produktion bei einem Foundry-Partner soll insbesondere für ASSPs und für Produkte im Industrie- und Konsumgüterbereich wahrgenommen werden.

Das Standard-Assembly Geschäft wurde planmäßig Mitte 2007 komplett zu langjährigen Partnern nach Südostasien ausgelagert. Somit konzentriert sich die niederländische Tochtergesellschaft ELMOS Advanced Packaging nun schwerpunktmäßig auf die Tätigkeitsfelder Gehäuseentwicklung und Fertigung von Sondergehäusen für mikromechanische Systeme (MEMS), Waferbearbeitung und Verpackung (Tape & Reel).

Forschung und Entwicklung

Höchstmögliches Qualitätsniveau Die immer intensivere Nutzung von elektronischen Komponenten im Automobil führt zu kontinuierlich steigenden Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit bei Halbleitern in der Automobilelektronik. Um diesem Trend gerecht zu werden, nutzt ELMOS die Erfahrungen aus den Industrie- und Konsumgütermärkten für neue innovative Technologien als Innovationstreiber. ELMOS profitiert von diesem Sachverhalt z.B. indem in Konsumgütermärkten gereifte Innovationen später im Automobil eingeführt werden und durch eigene – über die Standards hinausgehende – Qualifikationsverfahren abgesichert werden. Dies führt u.a. zu einem höchstmöglichen Qualitätsniveau auch bei neuen Produkten für das Automobil.

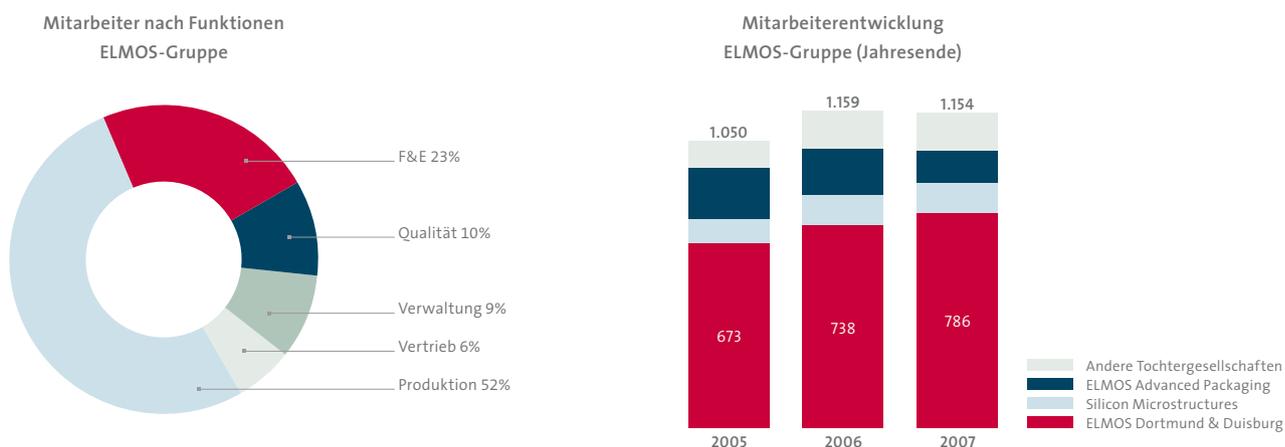
Im Berichtsjahr war ein klarer Schwerpunkt der Aktivitäten in Forschung und Entwicklung die Entwicklung des 0,35µm Prozesses und das Starten der Prototyping-Phase dieses Prozesses. Die Fein-Optimierung und die Prozessintegration der am Standort Duisburg in Serie gefertigten Produkte wurden in 2007 ebenfalls intensiv vorangetrieben. Die Fertigung auf 200mm-Wafern bietet ELMOS die Möglichkeit, innovative und kostengünstige Lösungen mit Hilfe eigener Prozess-technologien anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Inzwischen ist es Marktpraxis, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten vorfinanziert wird und sich über die Serienfertigung amortisieren muss. Dies trifft natürlich in besonderem Maße für die Entwicklung von ASSP-Familien zu, die zukünftig einen größeren Umsatzanteil von ELMOS als in der Vergangenheit ausmachen werden. In Folge davon stiegen die Aufwen-

dungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Mio. Euro auf 30,9 Mio. Euro an, entsprechend einer Quote von 17,5% vom Umsatz.

Mitarbeiter

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. An den Standorten Dortmund und Duisburg in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit diesen und genießt als einziger Halbleiterhersteller der Region eine Ausnahmestellung.



An ihren Standorten in Nordrhein-Westfalen hat ELMOS auch 2007 wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Zum Jahresende 2007 wurden in Dortmund und Duisburg 786 Mitarbeiter (31. Dezember 2006: 738) beschäftigt. Im Mittel stieg die Anzahl der Beschäftigten auch im Konzern in 2007 auf 1.177 (Jahresmittel 2006: 1.131). Zum Bilanzstichtag blieb die Zahl der im ELMOS-Konzern beschäftigten Mitarbeiter mit 1.154 in etwa auf Vorjahresniveau (31. Dezember 2006: 1.159). Zuwächse gab es vor allem im Bereich Qualität; demgegenüber stand der durch die Restrukturierung bedingte Personalabbau am Standort Nijmegen. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter lag 2007 bei 37 Jahren (2006: 36 Jahre), die Fluktuation bei rund 2%.

ELMOS bildet in zahlreichen kaufmännischen und technischen Berufen aus, mit Schwerpunkt auf dem Beruf des Mikrotechnologen. Ende 2007 befanden sich 56 (2006: 70) der Dortmunder Mitarbeiter in der Ausbildung. Viele der in 2004 anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums zusätzlich eingestellten Auszubildenden haben ihre Ausbildung in 2007 erfolgreich abgeschlossen.

Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Mitarbeitern erfolgt in Dortmund vertrauensvoll und mittels einer Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung. In zahlreichen Ausschüssen werden die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zum Vorstand besprochen und geregelt. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

MITARBEITERBETEILIGUNG

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Das Stock Award Programm 2007 umfasste 29.000 Aktien, die zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurückerworben wurden. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahren ein ähnliches Stock Award Programm.

Qualität, Sicherheit und Umweltschutz



Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS AP, SMI, ELMOS North America, GED, DMOS und die Fertigung in Duisburg wurden in 2007 gemäß dieser Norm auditiert und zertifiziert.

Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund in 2003 durch den TÜV Rheinland zertifiziert und in den nachfolgenden Jahren durch Überwachungsaudits ohne Abweichungen bestätigt. Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

Nähere Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz finden Sie unter „Unsere Verantwortung“ ab Seite 38.



Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Abschluss nach IFRS

Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG für das Geschäftsjahr 2007 wurde gemäß International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

Im Berichtsjahr hat ELMOS die Grundlage für eine verbesserte Nutzung der Marktchancen für Mikrosysteme gelegt. In diesem Zuge wurden bei zwei Tochtergesellschaften Restrukturierungen durchgeführt. Dies führte zu Sondereffekten in Höhe von 5,7 Mio. Euro. Um einen möglichst transparenten Überblick über die Ertragslage zu geben, werden die einzelnen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung jeweils mit und ohne Berücksichtigung der einmaligen Restrukturierungsaufwendungen aufgeführt.

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro oder %, soweit nicht anders angegeben	Mit Berücksichtigung der Einmaleffekte aus Restrukturierung			Von Restrukturierungsaufwendungen bereinigtes Ergebnis*		
	2006	2007	Veränderung	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse	160,7	176,1	9,6%	160,7	176,1	9,6%
Bruttoergebnis	73,0	73,1	0,1%	73,0	76,9	5,2%
in %	45,5%	41,5%		45,5%	43,6%	
Forschungs- und Entwicklungskosten	29,6	30,9	4,4%	29,6	30,7	3,9%
in %	18,4%	17,5%		18,4%	17,5%	
Vertriebskosten	9,7	11,6	20,0%	9,7	11,6	20,0%
in %	6,0%	6,6%		6,0%	6,6%	
Verwaltungsaufwendungen	14,2	16,1	13,5%	14,2	15,2	7,0%
in %	8,8%	9,2%		8,8%	8,6%	
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen	19,6	14,5	-26,0%	19,6	19,3	-1,3%
in %	12,2%	8,2%		12,2%	11,0%	
EBIT	19,8	15,2	-23,3%	19,8	20,9	5,3%
in %	12,3%	8,6%		12,3%	11,8%	
Ergebnis vor Steuern	17,3	12,2	-29,3%	17,3	17,9	3,3%
in %	10,8%	6,9%		10,8%	10,2%	
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen	10,7	8,8	-17,7%	10,7	12,5	16,4%
in %	6,7%	5,0%		6,7%	7,1%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in Euro	0,55	0,45	-17,7%	0,55	0,64	16,4%
Dividende je Aktie in Euro	0,00	0,00*		0,00	0,00**	

* aus der Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften

** Vorschlag für die Hauptversammlung im Mai 2008

Umsatzentwicklung

Das Jahr 2007 war durch ein schwieriges Marktumfeld gekennzeichnet. So spielten die Verunsicherung durch die in den USA ausgelöste Kreditkrise, der schwache US-Dollar und der hohe Ölpreis eine Rolle. Trotz dieser schwierigen Randbedingungen und der bei zwei Tochtergesellschaften durchgeführten Restrukturierung hat ELMOS mit einem Umsatzwachstum von 9,6% auf 176,1 Mio. Euro eine gute Leistung zeigen können. Die Ziele wurden im Wesentlichen erreicht.

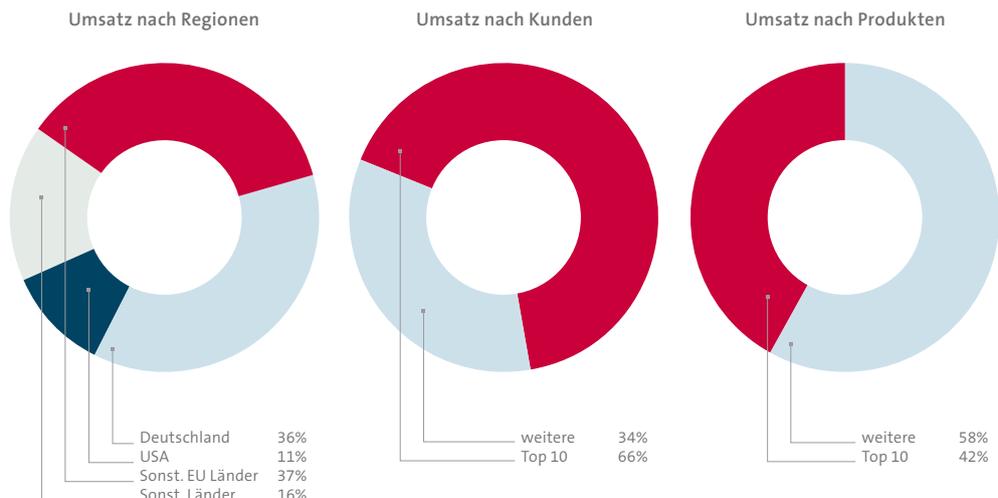
UMSATZ NACH REGIONEN

Regionale Umsatzverteilung im Wesentlichen unverändert

Die regionale Aufteilung des Umsatzes ist im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr. Der Deutschland-Anteil betrug 36,1% (2006: 37,4%), sonstige EU-Länder beliefen sich mit 36,7% (2006: 37,3%) auf ähnlichem Niveau. Während der Umsatz in den USA sowohl relativ als auch absolut leicht zurückgegangen ist und 10,9% (2006: 13,4%) ausmacht, gewannen die sonstigen Länder hinzu und trugen 16,3% (2006: 11,9%) zum Konzernumsatz bei. Länder mit Umsatzzuwachs sind vor allem Kanada, China, Mexiko, Schweiz und Taiwan. Die Veränderungen sind hauptsächlich auf den Wechsel einzelner Lieferadressen der Kunden bzw. den gesteigerten Umsatz mit bisherigen Kunden zurückzuführen und nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung der Kundenstruktur.

UMSATZ NACH KUNDEN

ELMOS beliefert mehr als 100 Kunden. Dies sind überwiegend Automobilzulieferer und zu einem kleineren Anteil Industriekunden und KonsumproduktHersteller. In 2007 waren, wie in früheren Jahren, der französische Automobilzulieferer Valeo, die schwedische Autoliv und die Schweizer Saia-Gruppe unsere größten Kunden, die jeweils mehr als 10% des Umsatzes ausgemacht haben. Der mit unseren größten Kunden getätigte Umsatz verteilt sich in der Regel auf zahlreiche unterschiedliche Produkte, die sich in verschiedenen Stadien ihres Lebenszyklusses befinden. Die zehn größten Kunden machten in 2007 fast unverändert rund 66% (2006: 68%) oder zwei Drittel unseres Umsatzes aus.



AUFTRAGSBESTAND

Für die Berechnung des Book-to-bill-Verhältnisses wird der Auftragsbestand der kommenden Monate mit dem Umsatz der vergangenen Monate in Relation gesetzt. Zu Ende Dezember 2007 lag dieser für den Halbleiterbereich über eins.

Der Auftragsbestand wird üblicherweise bei Erhalt der Kundenbestellung erfasst. Der in die Berechnung des Book-to-bill eingehende Auftragsbestand umfasst die zu liefernden Produkte der kommenden drei Monate im Verhältnis zu den Umsatzerlösen der vergangenen drei Monate. Der Auftragsbestand wird durch verschiedene Faktoren wie Nachfrage, Bestellverhalten, Vorlaufzeiten der Fertigung, etc. beeinflusst. Der Auftragsbestand kann zwischen dem Zeitpunkt der Auftragserteilung und der Lieferung variieren. Dies ist bedingt durch Veränderungen im Bedarf der Kunden oder Marktbedingungen. Sobald die Produktion gestartet ist, ist eine Bestellung üblicherweise nicht mehr rückgängig zu machen. Hinzu kommt, dass die Kunden typischerweise auch ihrerseits viel Zeit und Aufwand in die Entwicklung eines Produkts gesteckt haben, so dass sie normalerweise ihre Bestellungen durchführen. Dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass sich der Auftragsbestand in Umsatz verwandelt.

NEUPROJEKTE (DESIGN WINS)

Auch in 2007 gab es starken Wettbewerb um ASIC-Aufträge. Der Ausbau unserer starken Position im automobilen ASIC-Markt ist unverändert die intakte Wachstumssäule unseres Geschäfts. So haben wir neben zahlreichen neuen Design Wins in 2007 beispielsweise ASIC-Folgeaufträge gewonnen, ohne dabei den branchenüblichen Vergabeprozess durchlaufen zu müssen. Die Kernkompetenzen im Bereich der effizienten Motoransteuerungen für Klimaanlage sowie verschiedene Airbag-ICs standen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber sind u.a. langjährige Kunden aus der Automobilindustrie. Wir haben unsere Kunden mit kosteneffizienten Lösungen, der ausgezeichneten Qualität und Liefertreue überzeugt, so dass die Entscheidung für ELMOS aus ihrer Sicht außer Frage stand. Damit hat sich auch die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden verbessert.

ASIC-Folgeaufträge
gewonnen

Auch bei der Weiterentwicklung unseres ASSP-Geschäfts konnten wir in 2007 Fortschritte machen. Ein herausragender Erfolg ist der Vierfach-Sternkoppler für das FlexRay™-Netzwerk, welchen ELMOS als weltweit erstes Unternehmen für BMW entwickelt hat. Der neu entwickelte Baustein ersetzt vier konventionelle Einfach-Transceiver und ermöglicht so die Realisierung von platz- und kostenoptimierten Steuergeräten. In den kommenden Jahren wird BMW das Hochgeschwindigkeits-Netzwerk FlexRay™ als neuen Standard für zeitkritische Applikationen einsetzen. FlexRay™-Bussysteme werden mittelfristig in vielen Anwendungen CAN-Bussysteme ablösen. Das Bussystem CAN ist das derzeit Stückzahl-stärkste Netzwerk im Auto. Ein weiteres Beispiel für unsere Fortschritte im Bereich ASSPs ist der Gewinn des Auftrags eines großen japanischen Elektronikonzerns. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Chip basierend auf unserem patentierten HALIOS®-Prinzip.

ELMOS-FlexRay™ Baustein bei
BMW gelistet

Ertragslage

Die Ergebnisse des Berichtsjahres sind – wie im April 2007 angekündigt – geprägt durch die Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 5,7 Mio. Euro.

BRUTTOERGEBNIS

Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte durch Restrukturierungen stieg das Bruttoergebnis unterproportional zum Umsatz um 5,2% auf 76,9 Mio. Euro (2006: 73,0 Mio. Euro). Dies entsprach einer Bruttomarge von 43,6% vom Umsatz (2006: 45,5%). Sie wurde vor allem durch erhöhte Aufwendungen beim Aufbau des neuen Fertigungsstandortes in Duisburg beeinträchtigt, was zu einem Anstieg der Herstellungskosten von 87,6 Mio. Euro in 2006 um 13,3% auf 99,3 Mio. Euro in 2007 führte.

Unter Berücksichtigung der Sondereffekte belief sich das Bruttoergebnis auf 73,1 Mio. Euro und die Bruttomarge betrug dementsprechend 41,5%. Daran zeigt sich, dass der Großteil der Restrukturierungsaufwendungen (3,8 Mio. Euro) in den Herstellungskosten erfasst ist.

BETRIEBSERGEBNIS VOR SONSTIGEN BETRIEBLICHEN AUFWENDUNGEN/(ERTRÄGEN) UND EBIT (ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN)

ASSP-Entwicklung
intensiviert

Unser Engagement in der Entwicklung von Standardprodukten (ASSPs), insbesondere zum Ende des Geschäftsjahres, haben wir weiter intensiviert. Zudem haben wir die Entwicklung der nächsten Technologiegeneration beschleunigt. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen stiegen auch deswegen auf 30,7 Mio. Euro, blieben mit einem Anstieg von 3,9% jedoch deutlich unter dem Umsatzwachstum. Sie unterstreichen mit ihrem Anteil von 17,5% vom Umsatz (2006: 18,4%) jedoch nach wie vor die hohe Bedeutung der Produktentwicklung und -innovation für ELMOS als Technologieunternehmen. Die Marketing- und Vertriebsaufwendungen kletterten überproportional zum Umsatz auf 11,6 Mio. Euro. Dies ist auf die erhöhten Anstrengungen bei ASSPs im Allgemeinen, der verstärkten Akquisition im Industrie- und Konsumgüterbereich und den erfolgreichen Markteintritt in Asien zurückzuführen. Die Aufwendungen für Allgemeine Verwaltung wuchsen in etwa umsatzproportional auf 15,2 Mio. Euro (alle Zahlen ohne Sondereffekte).

Ohne Sondereffekte blieb das Betriebsergebnis bei 19,3 Mio. Euro in etwa auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr (2006: 19,6 Mio. Euro). Im Vergleich zu 2006 war die Bruttomarge wie oben erläutert um knapp zwei Prozentpunkte niedriger. Die in Prozent vom Umsatz etwas geringeren funktionalen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 32,7% vom Umsatz (2006: 33,3%) führten dazu, dass die Betriebsergebnis-Marge mit 11,0% vom Umsatz (2006: 12,2%) sich nicht so stark reduzierte wie die Bruttomarge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden im Wesentlichen beeinflusst (4,8 Mio. Euro) durch die Umstrukturierung eines bestehenden Leasingvertrags aufgrund des Ablaufs der ersten Zinsbindungsfrist. Dieser bisher als Finanzierungsleasing erfasste Vertrag wurde per Ende 2007 in eine operative Leasingstruktur überführt. Der daraus resultierende Effekt war vom Grundsatz und der ungefähren Höhe nach in der Planung für das Geschäftsjahr 2007 bereits enthalten.

Das EBIT unterscheidet sich vom Betriebsergebnis durch die zusätzliche Berücksichtigung von Wechselkursverlusten/(-gewinnen), Aufwendungen/(Erträgen) aus assoziierten Unternehmen und Sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen). Das EBIT stieg auf 20,9 Mio. Euro (2006: 19,8 Mio. Euro) bzw. betrug 11,8% vom Umsatz (2006: 12,3%).

Die Sondereffekte hatten bei den funktionalen Aufwendungen Einfluss auf Forschung und Entwicklung (0,2 Mio. Euro) und Allgemeine Verwaltung (0,9 Mio. Euro). Die Position Sonstiger Aufwand wurde zusätzlich um 0,8 Mio. Euro belastet.

Die Restrukturierungsaufwendungen belasteten die Kennzahlen, wie prognostiziert, um rund drei Prozentpunkte. Das Betriebsergebnis unter Berücksichtigung der Sondereffekte betrug 14,5 Mio. Euro oder 8,2% vom Umsatz und das EBIT 15,2 Mio. Euro oder 8,6% vom Umsatz.

Belastungen durch
Einmaleffekte

ERGEBNIS VOR STEUERN, KONZERNÜBERSCHUSS UND ERGEBNIS PRO AKTIE

Die Finanzierungserträge/-aufwendungen stiegen in 2007 auf 3,0 Mio. Euro (2006: 2,5 Mio. Euro). Der Anstieg ist im Wesentlichen begründet durch ein in 2007 höheres Zinsniveau als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Steuern stieg um 3,3% auf 17,9 Mio. Euro oder 10,2% vom Umsatz (2006: 17,3 Mio. Euro bzw. 10,8%). Unter Berücksichtigung der Sondereffekte betrug das Ergebnis vor Steuern 12,2 Mio. Euro bzw. 6,9% vom Umsatz.

Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte beliefen sich die Steueraufwendungen auf 5,6 Mio. Euro und waren damit 15,6% geringer als im Vorjahr (2006: 6,6 Mio. Euro). Die Steuerquote hätte demnach 31,3% betragen. Aufgrund der Restrukturierungsaufwendungen ist die Steuerlast um 45,8% niedriger als im Vorjahr ausgefallen und betrug 3,6 Mio. Euro, resultierend in einer Steuerquote von 29,4%. In beiden Fällen ist die Steuerquote unterhalb der vom Vorjahr (2006: 38,4%). 2006 war beeinflusst durch eine Änderung des niederländischen Steuerrechts, wodurch latente Steuern erfolgswirksam wurden. In 2007 ist ein positiver Effekt aus der Absenkung der Steuersätze in Deutschland im Rahmen der Unternehmensteuerreform in Höhe von 1,2 Mio. Euro enthalten.

Ohne Sondereffekte betrug der Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen 12,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 16,4% im Vergleich zum Vorjahr (2006: 10,7 Mio. Euro) entspricht. Die Nettogewinnmarge liegt somit mit 7,1% oberhalb des Wertes aus 2006 (6,7%). Folglich konnte das Ergebnis je Aktie auf 0,64 Euro deutlich gesteigert werden (2006: 0,55 Euro).

Unter Berücksichtigung der Restrukturierungsaufwendungen sank der Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen auf 8,8 Mio. Euro bzw. der Gewinn pro Aktie betrug 0,45 Euro.

VORSCHLAG ZUR GEWINNVERWENDUNG

Der Jahresfehlbetrag der ELMOS Semiconductor AG* gemäß HGB betrug 5,3 Mio. Euro in 2007. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2006 beläuft sich auf 44,9 Mio. Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, am 8. Mai 2008 zu beschließen, den Bilanzgewinn in



* Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen. Er wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Unternehmensregister hinterlegt und kann als Sonderdruck angefordert werden.

Höhe von 39,6 Mio. Euro vollständig auf neue Rechnung vorzutragen. Trotz der Verbesserung der Liquiditätslage gegenüber dem Vorjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor dem Hintergrund der durch die Sondereffekte aus der Restrukturierung belasteten Ergebnisse vor, keine Dividende auszuschütten. Die Gesellschaft hält daran fest, eine Dividende zu zahlen, wenn Ergebnisentwicklung und Cash Flow nachhaltig positiv sind.

Die nachfolgenden Finanzzahlen werden nur unter Berücksichtigung der einmaligen Restrukturierungsaufwendungen dargestellt:

UMSATZ- UND ERTRAGSLAGE IN DEN SEGMENTEN

	Segment	2006	2007	Veränderung
Umsatzerlöse in Mio. Euro				
	Halbleiter	150,0	163,6	9,1%
	Mikromechanik	10,7	12,5	17,4%
Bruttoergebnis in Mio. Euro				
	Halbleiter	70,4	73,2	3,9%
	Mikromechanik	2,7	0,0	Na
Bruttomarge in %				
	Halbleiter	46,9%	44,7%	
	Mikromechanik	25,0%	- 0,4%	
Betriebsergebnis in Mio. Euro				
	Halbleiter	20,3	19,1	- 5,9%
	Mikromechanik	- 0,8	- 4,7	Na
Betriebsergebnis in %				
	Halbleiter	13,6%	11,7%	
	Mikromechanik	- 7,1%	- 37,2%	

HALBLEITER

Halbleiter-Bereich
hat größte Bedeutung

Das Halbleiter-Kerngeschäft des ELMOS-Konzerns wird über die verschiedenen Gesellschaften in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und den USA betrieben. Der Drittumsatz des Segments Halbleiter stieg um 9,1% auf 163,6 Mio. Euro an. Damit hat der Halbleiter-Bereich nach wie vor die größte Bedeutung für ELMOS und macht, ähnlich wie im Vorjahr, wieder mehr als 90% des Umsatzes der ELMOS-Gruppe aus. Das Bruttoergebnis erhöhte sich um 3,9% auf 73,2 Mio. Euro (2006: 70,4 Mio. Euro), die Bruttomarge hingegen reduzierte sich auf 44,7% (2006: 46,9%). Die Betriebsergebnismarge ist ebenfalls um rund zwei Prozentpunkte von 13,6% in 2006 auf 11,7% im Berichtsjahr gefallen. Diese Entwicklung ist zum einen auf erhöhte Aufwendungen beim Aufbau des neuen Standortes Duisburg und zum anderen auf die einmaligen Restrukturierungsaufwendungen bei einer Tochtergesellschaft in den Niederlanden zurückzuführen.

MIKROMECHANIK

Der Bereich Mikromechanik umfasst die Tätigkeiten der Tochtergesellschaft SMI. Der SMI-Umsatz mit Dritten wird fast ausschließlich in US-Dollar erzielt. Trotz eines schwachen US-Dollars im Berichtsjahr stieg der Umsatz des Bereichs Mikromechanik um 17,4% auf 12,5 Mio. Euro. Die Ergebnisse und Margen des Bereichs sind in 2007 stark beeinflusst von den Restrukturierungsaufwendungen und fallen negativ aus.

Finanzlage

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	2006	2007	Veränderung
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen	10,7	8,8	- 17,7%
Abschreibungen zuzüglich Zuschreibungen	16,3	19,6	20,3%
Veränderung Nettoumlaufvermögen	0,0	- 1,3	Na
Übrige Posten	1,5	3,7	Na
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	28,5	30,8	7,9%
Investitionen in das Anlagevermögen	- 26,4	- 24,5	- 7,1%
in % vom Umsatz	16,4%	13,9%	
Sonstige Posten	6,4	23,1	Na
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	- 19,9	- 1,4	- 93,0%
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 4,1	- 3,9	- 4,4%
Veränderung der liquiden Mittel	4,5	25,5	Na
Free Cash Flow*	8,6	29,4	Na

* Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

CASH FLOW AUS DER LAUFENDEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Nach einem bereits signifikant verbesserten Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in 2006 in Höhe von 28,5 Mio. Euro, konnte dieser in 2007 erneut um 2,3 Mio. Euro oder 7,9% auf 30,8 Mio. Euro gesteigert werden. Dieses war trotz des niedrigeren Jahresüberschusses möglich, der durch die Restrukturierungen beeinflusst war. Die wesentlichen Gründe dafür sind, dass die Restrukturierungsaufwendungen nicht vollständig cash-wirksam waren, nicht so hohe Steuern bezahlt wurden wie im Vorjahr, sonstige Forderungen zurückgegangen sind sowie ein gewährtes Darlehen zurückgezahlt worden ist. Diese positiven Auswirkungen konnten sogar den stark gegenläufigen Effekt der nicht liquiditätswirksamen Aufwendungen/Erträge (Unterschied von 9,6 Mio. Euro) mehr als ausgleichen. Während diese Position in 2006 positiv zum operativen Cash Flow (5,5 Mio. Euro) beigetragen hat, war im Berichtsjahr per Saldo ein Ertrag in Höhe von 4,1 Mio. Euro nicht cash-wirksam und wurde entsprechend rückgerechnet. Dieser nicht liquiditätswirksame Ertrag ist im Wesentlichen auf die Umstrukturierung eines Leasingvertrags für ein Wirtschaftsgut zurückzuführen, welches vom Finanzierungsleasing in eine operative Leasingstruktur überführt wurde.

Cash Flow aus laufender
Geschäftstätigkeit erhöht

CASH FLOW AUS DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Investitionen reduziert Nach dem Rückgang der Investitionen in 2006 wurden diese in 2007 nochmals reduziert und betrugen 24,5 Mio. Euro – trotz des weiteren Ausbaus der Fertigungskapazitäten. In Prozent vom Umsatz sanken diese von 16,4% in 2006 auf 13,9% im Berichtsjahr. Die Investitionen entfielen vor allem auf die Ausstattung des Reinraums am Standort Duisburg sowie auf Maschinen und Betriebsvorrichtungen für das Dortmunder Frontend und Backend. Das Halbleiter-Segment war mit 23,8 Mio. Euro für den größten Teil der Investitionen verantwortlich, auf die Mikromechanik entfielen 0,7 Mio. Euro.

Die zur Weiterveräußerung gehaltenen Vermögenswerte wurden in 2007 planmäßig im Rahmen von Sale-and-Lease-back-Transaktionen verkauft. Darüber hinaus wurde ein Leasingvertrag, der bislang als Finanzierungsleasing dargestellt wurde auf eine operative Leasingstruktur umgestellt. Diese Effekte haben dazu geführt, dass der Cash Flow aus der Investitionstätigkeit mit 23,1 Mio. Euro positiv beeinflusst wurde. Insgesamt entstand ein Cash Bedarf aus der Investitionstätigkeit von 1,4 Mio. Euro.

Free Cash Flow deutlich gesteigert Als Resultat des gestiegenen operativen Cash Flows und des geringeren Bedarfs an Cash aus der Investitionstätigkeit konnte der Free Cash Flow in 2007 deutlich auf 29,4 Mio. Euro gesteigert werden (2006: 8,6 Mio. Euro). Auch bei Nicht-Berücksichtigung des Barmittelzuflusses aus den Veräußerungen der Vermögensgegenstände und sonstiger Einflussfaktoren auf den Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit konnte noch immer ein beachtlicher Betrag an freiem Cash in Höhe von 6,3 Mio. Euro (2006: 2,2 Mio. Euro) generiert werden.

CASH FLOW AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Durch die Umstellung des Leasingvertrags von Finanzierungsleasing auf eine operative Leasingstruktur wurden die entsprechenden überwiegend langfristigen Finanzverbindlichkeiten (16,3 Mio. Euro) ausgebucht. Darüber hinaus führte die Umfinanzierung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten im Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit dazu, dass sich insgesamt eine Nettoabnahme von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 3,9 Mio. Euro ergab. Die Umfinanzierung stärkt die Unabhängigkeit der Gesellschaft in Bezug auf schwankende Zinssätze.

Im Wesentlichen als Folge des hohen Free Cash Flows konnten die Zahlungsmittel und -äquivalente von 16,6 Mio. Euro Ende 2006 auf 42,9 Mio. Euro am 31. Dezember 2007 gesteigert werden. Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermögen kletterte damit auf 17,2% (31. Dezember 2006: 6,8%).

Vermögenslage

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE NACH IFRS

in Mio. Euro, soweit nicht anders angegeben	31.12.2006	31.12.2007	Veränderung
Immaterielle Vermögenswerte	39,8	42,1	5,9%
Sachanlagen	96,3	87,0	-9,7%
Sonstige langfristige Vermögenswerte	8,3	8,2	-1,2%
Vorratsvermögen	31,1	33,6	7,9%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27,8	28,4	2,3%
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	42,1	50,0	18,8%
Aktiva, gesamt	245,3	249,3	1,6%
Eigenkapital	152,3	160,0	5,1%
Langfristige Schulden	33,8	59,8	77,0%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,7	14,6	14,6%
Sonstige kurzfristige Schulden	46,5	14,9	-67,9%
Passiva, gesamt	245,3	249,3	1,6%

Die Darstellung der latenten Steuern wurde erstmalig in 2007 (und rückwirkend für 2006) auf die Bruttomethode umgestellt, was zu einer Bilanzverlängerung führte. Die Bilanzsumme der ELMOS-Gruppe stieg von 245,3 Mio. Euro im Jahr 2006 um 1,6% auf 249,3 Mio. Euro in 2007.

Bilanzsumme erhöht

Die wesentlichen Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz sind neben dem signifikanten Anstieg der Cash-Position der Rückgang der Position Gebäude und Einbauten (Abgang eines bisher als Finanzierungsleasing erfassten Wirtschaftsgutes), die Verminderung der Position von zur Veräußerung gehaltenen Wirtschaftsgütern (Erweiterung des Produktionsgebäudes in Dortmund) und die Abnahme sonstiger Vermögenswerte. Auf der Passivseite sind als Vorgänge von besonderer Bedeutung lediglich die oben erwähnte Umfinanzierung von kurzfristigen in langfristige Verbindlichkeiten, die Umstellung eines Vertrages von Finanzierungsleasing auf eine operative Leasingstruktur sowie die Veränderung bei den passiven latenten Steuern zu nennen.

NETTOUMLAUFVERMÖGEN

Die Vorräte stiegen unterproportional zum Umsatz um 7,9% auf 33,6 Mio. Euro am 31. Dezember 2007. Damit stieg der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen im Vergleich zu 2006 leicht von 12,7% auf 13,5%. Durch kontinuierlich verbessertes Forderungsmanagement wuchsen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 2,3% weniger als der Umsatz auf 28,4 Mio. Euro (31. Dezember 2006: 27,8 Mio. Euro). Damit konnte auch die Umschlagshäufigkeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von 5,8x auf 6,2x des Umsatzes verbessert werden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 14,6% auf 14,6 Mio. Euro am Ende des Berichtsjahres. Die Verbesserung der wesentlichen Kennzahlen zeigt sich in dem nur leichten Anstieg des Nettoumlaufvermögens auf 47,4 Mio. Euro (31. Dezember 2006: 46,2 Mio. Euro).

Forderungsmanagement
weiter verbessert

PASSIVA

Nettoverschuldung
gesunken

Die Nettoverschuldung sank zum Bilanzstichtag 2007 auf 11,1 Mio. Euro, ein Rückgang um 77,0%. Die Finanzverbindlichkeiten sind im Jahresvergleich geringer geworden (54,0 Mio. Euro am 31. Dezember 2007 gegenüber 65,0 Mio. Euro am 31. Dezember 2006); vor allem aber sind die liquiden Mittel signifikant auf 42,9 Mio. Euro gestiegen. Ins Leasing gegebene sowie veräußerte Vermögenswerte haben einerseits zu einer Verbesserung der Cash-Position beigetragen, haben jedoch andererseits zu einem Anstieg der sonstigen finanziellen Verpflichtungen geführt.

Das Eigenkapital stieg von 152,3 Mio. Euro auf 160,0 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote wuchs ebenfalls auf 64,2% (31. Dezember 2006: 62,1%).

KENNZAHLEN DER ELMOS-GRUPPE

	Berechnung	Einheit	2006	2007
Nettoumlaufvermögen	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte	Mio.		
	– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Euro	46,2	47,4
	vom Umsatz	%	28,7%	26,9%
Umschlagshäufigkeit der Vorräte	Herstellungskosten/Vorräte	x	2,8x	3,1x
Umschlagshäufigkeit der Forderungen	Umsatz/Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	x	5,8x	6,2x
Umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten	Herstellungskosten/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	x	6,9x	7,1x
Cash Cycle	Inventartage + Forderungstage – Verbindlichkeitentage	Tage	140	126
Nettoverschuldung	Finanzverbindlichkeiten (kurzfristig und langfristig)	Mio.		
	– Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente – Wertpapiere	Euro	48,4	11,1
Gearing	Nettoverschuldung/Eigenkapital	%	31,8%	6,9%
Eigenkapitalquote	Eigenkapital/Gesamtvermögen	%	62,1%	64,2%

Berichterstattung nach §315 Abs. 4 HGB

i.d.F. des Übernahmerichtlinie-Umsetzungsgesetzes

ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2007 aus 19.414.205 auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.414.205,00 Euro ist voll eingezahlt. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN

Stimmrechts- und Übertragungsbeschränkungen bestehen nicht.

DIREKTE ODER INDIREKTE BETEILIGUNGEN AM KAPITAL

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich bis zum 31. Dezember 2007 wie folgt dar:

	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789	7,7
Markos GmbH	3.236.584	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833	11,9
Streubesitz	9.148.415	47,1
	19.414.205	100,0

INHABER VON AKTIEN MIT SONDERRECHTEN

Aktien mit Sonderrechten wurden nicht ausgegeben.

ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE IM FALLE VON ARBEITNEHMERBETEILIGUNGEN

Dieser Punkt trifft auf die Gesellschaft nicht zu.

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND SATZUNGSBESTIMMUNGEN ÜBER DIE ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND ÜBER SATZUNGSÄNDERUNGEN

Wir verweisen auf die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften für die Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des Vorstands (§§84, 85 AktG) sowie für die Änderung der Satzung (§§133, 179 AktG). Ergänzende Bestimmungen aus der Satzung ergeben sich nicht.

BEFUGNISSE DES VORSTANDS ZUR AUSGABE UND ZUM RÜCKKAUF VON AKTIEN

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 9.650.000,00 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen und gem. §204 AktG mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Ausgabe zu entscheiden (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 885.795,00 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter ver-

bundener Unternehmen. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsprogrammes der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22. September 1999 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Optionscheiden oder Wandlungsrechten aus bis zum 09. Mai 2012 durch die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder mittelbare inländische oder ausländische 100%-ige Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft gemäß der Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 10. Mai 2007 begebenen Options- oder Wandelschuldverschreibungen Gebrauch machen oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber der von der Gesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren inländischen oder ausländischen 100%-igen Beteiligungsgesellschaften bis zum 09. Mai 2012 auszubehenden Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

Das Grundkapital ist um 930.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen („Aktienoptionsplan 2004“). Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der Gesellschaft nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 27. April 2004 Optionsrechte ausgegeben werden und die Inhaber dieser Optionsrechte diese wirksam ausüben. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Optionsrechten entstehen, am Gewinn teil.

Die Gesellschaft wird ermächtigt, bis zum 09. November 2008 eigene Aktien zu erwerben. Die Ermächtigung ist auf den Erwerb von Aktien, auf die ein Anteil am Grundkapital in Höhe von bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals entfällt, beschränkt. Die Ermächtigung kann ganz oder in mehreren Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke im Rahmen der vorgenannten Beschränkung ausgeübt werden.

WESENTLICHE VEREINBARUNGEN, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS IN FOLGE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots existieren nicht.

ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN

Auch Entschädigungsvereinbarungen bestehen nicht.

Vergütungsbericht

Die Gesamtvergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder besteht aus einer Reihe von Vergütungsbestandteilen. Nähere Einzelheiten enthält der Vergütungsbericht, der im Corporate Governance Bericht in diesem Geschäftsbericht zu finden ist. Dieser vom Wirtschaftsprüfer geprüfte Vergütungsbericht ist Teil des Lageberichts.



Risiko- und Chancenbericht

Risiko- und Chancenmanagementsystem

ELMOS betreibt ein ganzheitliches Risiko- und Chancenmanagementsystem zur konsequenten Nutzung ihrer Chancen, ohne die damit verbundenen Risiken außer Acht zu lassen. Risiken und Chancen werden regelmäßig analysiert. Die ELMOS Semiconductor AG fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem zusammen. Das System entspricht den gesetzlichen Anforderungen an ein Risikofrüherkennungssystem und steht im Einklang mit den Deutschen Corporate Governance Grundsätzen. Nähere Informationen zum Risikomanagement finden Sie unter der Anhangsangabe 30.



Risiken

ABHÄNGIGKEIT VON DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90% des Umsatzes wird mit Halbleitern für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs und ASSPs in der Regel auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Trend zu mehr Elektronik
in Fahrzeugen

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Systemherstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur deutet auf eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern hin. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass ein Kunde in der Regel mehrere Produkte mit verschiedenen Lebenszyklen bezieht. Aufgrund der Tatsache, dass ASICs kundenspezifische Produkte sind, ergibt sich eine besondere gegenseitige Abhängigkeit zwischen Lieferant und Kunde. Abweichend davon kann es bei großen Stückzahlen der Fall sein, dass ein Kunde bei zwei Lieferanten einen ASIC entwickeln lässt. Durch die verstärkte Hinwendung von ELMOS zu anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSP) wird diese Kundenabhängigkeit verringert, da solche Produkte an mehrere Kunden verkauft werden können.

WETTBEWERB

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich oftmals jedoch auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumige Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren. Wenn Kunden allerdings Parallelentwicklungen durchführen, so besteht für ELMOS das Risiko, dass diese auf einen Wettbewerber zurückgreifen.

ABHÄNGIGKEIT VON EINZELNEN MITARBEITERN

Sehr spezielles
Ingenieur-Know-how

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS, wie für jedes Technologieunternehmen, eine erhöhte Abhängigkeit von bestimmten Mitarbeitern.

ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang von den Kunden bezahlt werden. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. Gerade bei den hochvolumigen Aufträgen, um die sich eine größere Anzahl von Wettbewerbern bemüht, ist der Kunde in der Regel nicht bereit, die Entwicklungskosten zu übernehmen, sondern erwartet, dass diese vom Lieferanten vorfinanziert werden. Dies gilt insbesondere für von ELMOS selbst initiierte Produktentwicklungen, beispielsweise für ASSPs, da hierfür unter Umständen noch kein fester Kundenauftrag vorliegt.

Ständige Weiterentwicklung
und Verbesserung der Produkte

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, Produkte für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in zahlreichen elektronischen Komponenten eines PKWs vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Auto-

mobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein solcher Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig verbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

BESCHAFFUNG

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. ELMOS hat das Risiko gestreut, indem mit mehreren Partnern zusammengearbeitet wird.

Risikostreuung
bei ELMOS

PRODUKTHAFTUNG

Die von ELMOS produzierten Produkte werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten Halbleiter oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion in der Produktion im Regelfall mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können sich Produktfehler möglicherweise erst beim Verbau oder dem Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Konsequente
Null-Fehler-Strategie

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Beeinträchtigungen in den Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. Dennoch können diese Risiken negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

BETEILIGUNGSBEREICH

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen bzw. zu minimieren. Hierfür wird das installierte Überwachungs- und Risikomanagementsystem laufend erweitert und verbessert.

BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige wesentliche betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Unabhängige
Fertigungslinien

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass seit 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) am Standort Duisburg betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs, sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

Chancen

Kernkompetenz und Motor unseres aktuellen Wachstums sind kundenspezifische Halbleiter. Zudem arbeiten wir mit hohem Engagement am Eintritt in neue Märkte, sowohl aus technischer als auch aus geographischer Sicht. Aus technischer Sicht ist vor allem die Zusammenführung von Sensoren und Auswerteelektronik in einem applikationsspezifischen Gehäuse – sogenannte Mikrosysteme – interessant. Des Weiteren ist geplant, dass zukünftig Produkte für Konsumgüter und Industrieanwendungen einen höheren Anteil als bisher am Umsatz erzielen. In 2007 haben unsere Bemühungen in Asien signifikante Fortschritte gemacht. Wir stehen in regem Kontakt mit Geschäftspartnern und werden unser Engagement in Asien weiter verstärken. Im Hinblick auf applikationsspezifische Bauteile (ASSPs) werden in Zukunft die Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten mit starkem Fokus weitergeführt.

Nachtragsbericht

Bis zum 25. Februar 2008 hat ELMOS 50.000 eigene Aktien (entsprechend 0,26% des Grundkapitals) zurückgekauft.

Anfang 2008 haben ELMOS und MagnaChip Semiconductor Ltd. einen Kooperationsvertrag für die Entwicklung von automobilen Halbleitertechnologien unterzeichnet. In einem zweiten Schritt wird ELMOS die Fertigungsdienstleistungen (Foundry Services) von MagnaChip in Anspruch nehmen. Diese Kooperation ermöglicht ELMOS ein schnelles Reagieren auf schwankende Produktvolumina durch einen flexiblen und verlässlichen Dienstleister. Die prozessierten Wafer von MagnaChip werden unter dem Management von ELMOS getestet und assembliert. Die Partnerschaft soll unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit im Markt steigern und stellt einen weiteren Meilenstein in unserem Netzwerk von Kooperationen dar.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

Prognosebericht

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Mittelfristig erwarten Marktforschungsinstitute Wachstumsraten von rund 7% bis 8% pro Jahr für den automobilen Halbleitermarkt. Dabei spielt nach wie vor der anhaltende Wachstumstrend der Elektronik im Automobil eine größere Rolle als eine Veränderung der Produktionszahlen in der Automobilindustrie. So soll der Elektronikanteil im Automobil stetig steigen.

Im Jahr 2008 spielen die Unsicherheiten über den weiteren Fortgang der Ereignisse am Immobilienmarkt in den USA und an den internationalen Finanzmärkten eine Rolle und überschatten den wirtschaftlichen Ausblick. Darüber hinaus hat die Entwicklung des Ölpreises einen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Wir erwarten, dass das Marktumfeld nach wie vor schwierig bleiben wird.

AUSBLICK DER ELMOS-GRUPPE

ELMOS will in 2008 ihre Position als führendes Unternehmen der automobilen Halbleiterbranche ausbauen, gleichzeitig aber auch stärker in neue Märkte vordringen. ELMOS profitiert von der in 2007 gelegten Basis und wird sich in 2008 insbesondere auf die folgenden Themen konzentrieren:

- ▶ Optimierung des Standorts Duisburg
- ▶ Start der teilweisen Umstellung der Fertigung in Dortmund von 6-Zoll auf 8-Zoll
- ▶ Verbesserte Nutzung der Marktchancen für Mikrosysteme
- ▶ Vermehrter Vertrieb von ASSPs
- ▶ Verstärkte Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Optimierung des Produktportfolios und Reduktion der Investitionen
- ▶ Steigerung der Aktivitäten in Neuen Märkten (Industrie- und Konsumgütermärkte, Asien)

Gegen den Markttrend konnte ELMOS in 2007 ihre Prognose für das Berichtsjahr bekräftigen und erfüllen und auch für 2008 einen soliden Ausblick kommunizieren. Dies ist unter anderem das Resultat der in den vergangenen Jahren geleisteten Verbesserungen im Rahmen der Qualitätsinitiative und daraus folgendem Vertrauen, welches die Kunden in ELMOS setzen.

Für das Jahr 2008 bestätigen wir unsere Prognose aus November 2007. Dementsprechend rechnen wir mit einem Umsatzanstieg von 7% bis 9%. Für die EBIT-Marge wird eine Steigerung auf 12% bis 14% vom Umsatz erwartet. Die Investitionen sollen gegenüber 2007 sinken; der Free Cash Flow soll demnach positiv ausfallen. Diesem Ausblick liegt die Annahme eines Wechselkurses von 1,40 US-Dollar je Euro zugrunde. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich der Auftragseingang entsprechend der durch unsere Kunden gemachten Prognosen realisiert.

Dortmund, im März 2008

Der Vorstand



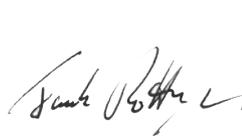
Dr. Anton Mindl



Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf



Dr. Frank Rottmann

GESCHÄFTSJAHR 2007

Umsatz	+ 9,6%
Bruttomarge	41,5% vom Umsatz
EBIT	15,2 Mio. Euro
Ergebnis je Aktie	0,45 Euro
Cash Flow aus der operativen Tätigkeit	30,8 Mio. Euro
Investitionen	13,9% vom Umsatz

KONZERNABSCHLUSS

Jahresabschluss	78
Konzernbilanz	78
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	80
Konzern-Kapitalflussrechnung	81
Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals	82
Entwicklung des Anlagevermögens	84
Konzernanhang	88
Allgemeines	88
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	88
Erläuterungen zur Gewinn- & Verlustrechnung	97
Erläuterungen zur Bilanz	103
Sonstige Angaben	118
Versicherung der gesetzlichen Vertreter	123
Bestätigungsvermerk	124

Jahresabschluss

Konzernbilanz nach IFRS

AKTIVA	Anhang	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Langfristige Vermögenswerte			
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	42.108.968	39.754.707
Sachanlagen	14	86.984.152	96.289.500
At-Equity bewertete Beteiligungen	15	1	2
Wertpapiere und Anteile	15	73.932	126.154
Latente Steueransprüche	16	8.105.939	8.155.999
Summe langfristige Vermögenswerte		137.272.992	144.326.362
Kurzfristige Vermögenswerte			
Vorratsvermögen	17	33.613.927	31.142.235
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	28.406.265	27.774.401
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	19	42.855.617	16.634.086
Sonstige Vermögenswerte und Ertragsteueransprüche	20	6.550.185	12.122.346
		111.425.994	87.673.068
Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird	21	625.877	13.343.658
Summe kurzfristige Vermögenswerte		112.051.871	101.016.726
Bilanzsumme		249.324.863	245.343.088

PASSIVA	Anhang	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Eigenkapital			
Den Gesellschaftern des Mutterunternehmens zurechenbarer Anteil am Eigenkapital			
Grundkapital	22	19.414.205	19.413.805
Kapitalrücklage	22	88.736.563	88.733.815
Gewinnrücklagen		102.224	102.224
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals	22	-6.407.297	-5.587.888
Bilanzgewinn		57.809.788	49.091.408
		159.655.483	151.753.364
Minderheitenanteil		309.704	505.088
Summe Eigenkapital		159.965.187	152.258.452
Schulden			
Langfristige Schulden			
Rückstellungen	24	1.111.214	1.142.637
Finanzverbindlichkeiten	25	51.622.281	28.284.983
Sonstige Verbindlichkeiten	26	2.533.246	354.307
Latente Steueransprüche	16	4.575.409	4.026.769
Summe langfristige Schulden		59.842.150	33.808.696
Kurzfristige Schulden			
Rückstellungen	24	6.110.536	5.122.981
Steuerverbindlichkeiten	26	1.879.590	280.169
Finanzverbindlichkeiten	25	2.343.009	36.712.756
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27	14.589.724	12.731.544
Sonstige Verbindlichkeiten	26	4.594.667	4.428.490
Summe kurzfristige Schulden		29.517.526	59.275.940
Summe Schulden		89.359.676	93.084.636
Bilanzsumme		249.324.863	245.343.088

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

	Anhang	2007 Euro	2006 Euro
Umsatzerlöse	5	176.133.528	160.673.887
Umsatzkosten	6	103.024.409	87.629.925
Bruttoergebnis		73.109.119	73.043.962
Forschungs- und Entwicklungskosten	6	30.892.815	29.583.236
Vertriebskosten	6	11.610.720	9.679.254
Verwaltungsaufwendungen	6	16.136.701	14.216.140
Betriebsergebnis vor sonstigen betrieblichen Aufwendungen/(Erträgen)		14.468.883	19.565.332
Finanzierungserträge	8	– 822.450	– 452.319
Finanzierungsaufwendungen	8	3.793.824	2.954.883
Wechselkursverluste	9	381.093	288.115
Aufwendungen (Erträge) aus assoziierten Unternehmen		– 48.999	48.999
Sonstige betriebliche Erträge	10	– 9.312.235	– 5.834.782
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10	8.240.100	5.239.685
Ergebnis vor Steuern		12.237.550	17.320.751
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ertragsteueraufwand	11	2.994.630	1.185.589
Latente Steuern	11	609.012	5.458.781
		3.603.642	6.644.370
Konzernüberschuss		8.633.908	10.676.381
Davon entfallen auf:			
Minderheitenanteile		– 163.809	– 18.291
Anteilseigner des Mutterunternehmens		8.797.717	10.694.672
Ergebnis je Aktie			
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,45	0,55
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	12	0,45	0,55

Konzern-Kapitalflussrechnung

	Anhang	2007 Euro	2006 Euro
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit			
Konzernüberschuss nach Minderheitenanteilen		8.797.717	10.694.672
Abschreibungen		19.599.904	16.287.270
Nicht liquiditätswirksamer Ertrag/Aufwand		- 4.147.108	5.458.781
Ertragssteueraufwand		2.994.630	1.185.589
Minderheitenanteile		- 163.809	- 18.291
Ertrag/Aufwand aus der Bewertung At-Equity		- 48.999	48.999
Veränderung der Pensionsrückstellungen		- 31.423	20.933
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm		0	453.611
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		- 631.863	1.296.722
Vorräte		- 2.471.692	- 3.437.645
Rechnungabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände		5.700.957	- 1.907.421
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.817.694	2.157.383
Sonstige Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten		840.051	- 834.160
Ertragsteuerzahlungen		- 1.472.368	- 2.886.707
Cash Flow aus der betrieblichen Tätigkeit		30.783.691	28.519.736
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit			
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte		- 7.272.751	- 9.578.886
Investitionen in das Sachanlagevermögen		- 17.214.995	- 16.772.554
Abgang/Investitionen in zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte		12.717.781	- 7.346.464
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		10.309.057	10.198.918
Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0	3.629.862
Abgang/Erwerb von Beteiligungen		68.523	- 45.723
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit		- 1.392.384	- 19.914.847
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit			
Einzahlung aus Kapitalerhöhung		3.148	10.868
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten		42.853.306	325.000
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten		- 14.794.111	- 5.674.655
Tilgung/Aufnahme kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		- 31.954.157	1.266.460
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit		- 3.891.814	- 4.072.327
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel		25.499.493	4.532.562
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel		722.038	682.884
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres		16.634.086	11.418.640
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	19	42.855.617	16.634.086

Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals nach IFRS

	Aktien Stück	Grund- kapital Euro	Kapital- rücklage Euro
Stand 1. Januar 2006	19.412.424	19.412.424	88.270.716
Aufwand aus Aktienoptionen			453.611
Ausübung von Optionen	1.381	1.381	9.487
Nicht realisierte Gewinne aus Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern			
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2006			
Stand 31. Dezember 2006	19.413.805	19.413.805	88.733.815
Ausübung von Optionen	400	400	2.748
Währungsveränderungen			
Änderung des Konsolidierungskreises			
Jahresüberschuss 2007			
Stand 31. Dezember 2007	19.414.205	19.414.205	88.736.563

Gewinn- rücklagen Euro	Kumulierte erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals Euro	Bilanz- gewinn Euro	Gesamt Euro	Minder- heitenanteil Gesamt Euro	Konzern Gesamt Euro
102.224	- 2.943.060	38.912.998	143.755.302	528.190	144.283.492
			453.611		453.611
			10.868		10.868
	- 1.211.241		- 1.211.241		- 1.211.241
	- 1.433.587		- 1.433.587		- 1.433.587
		- 516.262	- 516.262	- 4.811	- 521.073
		10.694.672	10.694.672	- 18.291	10.676.381
102.224	- 5.587.888	49.091.408	151.753.364	505.088	152.258.452
			3.148		3.148
	- 819.409		- 819.409		- 819.409
		- 79.337	- 79.337	- 31.575	- 110.912
		8.797.717	8.797.717	- 163.809	8.633.908
102.224	- 6.407.297	57.809.788	159.655.483	309.704	159.965.187

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2007

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					31.12.2007 Euro
	1.1.2007 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Zugänge Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	
Langfristige Vermögenswerte						
Immaterielle Vermögenswerte						
Geschäfts- oder Firmenwert	7.435.643	- 550.840	0	0	0	6.884.803
Entwicklungsprojekte	12.186.540	0	1.859.737	738.995	0	14.785.272
Software und Lizenzen	34.237.989	- 120.791	946.450 ¹	1.545.746	26.253	36.583.141
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	3.635.053	0	4.484.584	- 936.599	0	7.183.038
	57.495.225	- 671.631	7.290.771	1.348.142	26.253	65.436.254
Sachanlagen						
Grund und Boden	3.837.235	0	0	0	521.482	3.315.753
Gebäude und Einbauten	64.080.468	- 219.606	2.710.435	1.503.189	14.898.492	53.175.994
Technische Anlagen und Maschinen	141.810.186	- 1.058.753	2.029.395 ²	5.048.024	4.876.257	142.952.595
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.252.184	0	12.479.910	- 7.899.355	269.908	8.562.831
	213.980.073	- 1.278.359	17.219.740	- 1.348.142	20.566.139	208.007.173
At-Equity bewertete Beteiligungen	116.637	0	0	0	49.000⁴	67.637
Wertpapiere und Anteile	126.154	0	0	0	52.222	73.932
	271.718.089	- 1.949.990	24.510.511	0	20.693.614	273.584.996

¹ davon Veränderungen im Konsolidierungskreis 18.020 Euro² davon Veränderungen im Konsolidierungskreis 4.745 Euro³ davon Veränderungen im Konsolidierungskreis 876 Euro⁴ Übergang At-Equity zu Vollkonsolidierung

1.1.2007 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Zugänge Euro	Zuschrei- bungen Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN		
						31.12.2007 Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
0	0	0	0	0	0	0	6.884.803	7.435.643
4.447.582	0	2.087.063	0	0	0	6.534.645	8.250.627	7.738.958
13.292.936	- 38.148	3.564.104	0	0	26.251	16.792.641	19.790.500	20.945.053
0	0	0	0	0	0	0	7.183.038	3.635.053
17.740.519	- 38.148	5.651.167	0	0	26.251	23.327.287	42.108.968	39.754.707
612.702	0	0	0	0	0	612.702	2.703.051	3.224.533
30.335.370	0	2.925.105	0	0	6.165.571	27.094.904	26.081.090	33.745.098
86.742.501	- 360.081	11.024.507 ³	0	0	4.091.512	93.315.415	49.637.180	55.067.685
0	0	0	0	0	0	0	8.562.831	4.252.184
117.690.573	- 360.081	13.949.612	0	0	10.257.083	121.023.021	86.984.152	96.289.500
116.635	0	0	0	0	48.999⁴	67.636	1	2
0	0	0	0	0	0	0	73.932	126.154
135.547.727	- 398.229	19.600.779	0	0	10.332.333	144.417.944	129.167.053	136.170.363

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2006

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN						31.12.2006 Euro
	1.1.2006 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Korrektur Eröffnungs- werte Euro	Zugänge Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	
Langfristige Vermögenswerte							
Immaterielle Vermögenswerte							
Geschäfts- oder Firmenwert	8.033.733	- 598.090	0	0	0	0	7.435.643
Entwicklungsprojekte	8.556.162	0	0	1.368.679	2.261.699	0	12.186.540
Software und Lizenzen	27.905.869	- 131.153	0	1.660.340	4.896.524	93.591	34.237.989
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	4.155.055	0	0	6.549.867	- 6.997.868	72.001	3.635.053
	48.650.819	- 729.243	0	9.578.886	160.355	165.592	57.495.225
Sachanlagen							
Grund und Boden	6.027.539	- 187.549	0	0	0	2.002.755	3.837.235
Gebäude und Einbauten	69.140.182	- 759.104	0	2.226.724	162.144	6.689.478	64.080.468
Technische Anlagen und Maschinen	128.405.757	- 824.771	155.275	6.405.443 ¹	8.244.252	575.770	141.810.186
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.472.312	1	0	8.193.032	- 8.566.751	3.846.410	4.252.184
	212.045.790	- 1.771.423	155.275	16.825.199	- 160.355	13.114.413	213.980.073
At-Equity bewertete Beteiligungen	67.637	0	0	49.000	0	0	116.637
Wertpapiere und Anteile	645.795	0	0	0	0	519.641	126.154
	261.410.041	- 2.500.666	155.275	26.453.085	0	13.799.646	271.718.089

¹ davon Veränderungen im Konsolidierungskreis 52.645 Euro² davon Veränderungen im Konsolidierungskreis 47.910 Euro

1.1.2006 Euro	Fremd- währungs- anpassung Euro	Korrektur Eröffnungs- werte Euro	Zugänge Euro	Zuschrei- bungen Euro	Umbu- chungen Euro	Abgänge Euro	KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN		BUCHWERT	
							31.12.2006 Euro	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro	
0	0	0	0	0	0	0	0	7.435.643	8.033.733	
2.709.938	0	0	1.737.644	0	0	0	4.447.582	7.738.958	5.846.224	
10.365.886	- 32.215	0	2.978.827	0	74.023	93.585	13.292.936	20.945.053	16.809.225	
0	0	0	0	0	0	0	0	3.635.053	4.155.055	
13.075.825	- 32.215	0	4.716.471	0	74.023	93.585	17.740.519	39.754.707	34.844.237	
612.702	0	0	0	0	0	0	612.702	3.224.533	5.414.837	
27.637.455	- 51.800	0	3.354.909	0	0	605.194	30.335.370	33.745.098	41.502.727	
81.103.036	- 323.279	155.275	8.263.800 ²	0	- 74.023	2.382.308	86.742.501	55.067.685	46.569.711	
0	0	0	0	0	0	0	0	4.252.184	8.472.312	
109.353.193	- 375.079	155.275	11.618.709	0	- 74.023	2.987.502	117.690.573	96.289.500	101.959.587	
67.636	0	0	48.999	0	0	0	116.635	2	1	
0	0	0	0	0	0	0	0	126.154	645.795	
122.496.654	- 407.294	155.275	16.384.179	0	0	3.081.087	135.547.727	136.170.363	137.449.620	

Konzernanhang

Allgemeines

Die ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft („die Gesellschaft“ oder „ELMOS“) hat ihren Sitz in Dortmund (Deutschland) und ist dort beim Amtsgericht im Handelsregister, Abteilung B, unter Nr. 13698 eingetragen. Es gilt die Satzung in der Fassung vom 26. März 1999, welche zuletzt am 14. Dezember 2007 geändert wurde.

Der Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von mikroelektronischen Bauelementen und Systemteilen (**A**pplication **S**pecific **I**ntegrated **C**ircuits oder kurz: ASICs) sowie von funktionsverwandten technologischen Einheiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu erwerben oder zu pachten und sich an solchen zu beteiligen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die dem Gesellschaftsvertrag dienlich sind. Die Gesellschaft ist befugt, Geschäfte im Inland wie im Ausland zu betreiben.

Die Gesellschaft hat neben den inländischen auch Vertriebsgesellschaften in Frankreich und den USA und kooperiert in der Entwicklung und Herstellung von ASIC-Chips mit anderen deutschen und internationalen Unternehmen.

Die Gesellschaft ist börsennotiert, ihre Aktien werden im Prime Standard in Frankfurt gehandelt.

Die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft lautet:
44227 Dortmund, Heinrich-Hertz-Straße 1.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1 Grundsätze der Rechnungslegung

Allgemeines

Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt. Die in Tsd. Euro angegebenen Werte sind entsprechend kaufmännischer Rundung auf Tsd. Euro auf- oder abgerundet worden.

Der Konzernabschluss der ELMOS wurde nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union (EU) anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB zu beachtenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Alle vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen und zum Zeitpunkt der Aufstellung des vorliegenden Konzernabschlusses geltenden und von der ELMOS angewendeten IFRS wurden von der Europäischen Kommission für die Anwendung in der EU übernommen. Der Konzernabschluss der ELMOS entspricht damit auch den durch das IASB veröffentlichten IFRS. Im Folgenden wird daher einheitlich der Begriff IFRS verwendet.

Die Konzernbilanz und die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind in Anlehnung an IAS 1 „Presentation of financial statements“ aufgestellt. Einzelne Posten sind zur Verbesserung der Klarheit zusammengefasst; die Posten werden im Anhang erläutert.

Der Abschluss wird voraussichtlich im März 2008 durch den Vorstand zur Veröffentlichung freigegeben.

Schätzungen und Annahmen

Die wichtigsten zukunftsbezogenen Annahmen sowie sonstige am Stichtag bestehende wesentliche Quellen von Schätzungsunsicherheiten, aufgrund derer ein beträchtliches Risiko besteht, dass innerhalb des nächsten Geschäftsjahres eine wesentliche Anpassung der Buchwerte von Vermögenswerten und Schulden erforderlich sein wird, werden nachstehend erläutert.

Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts

Der Konzern überprüft mindestens einmal jährlich, ob der Geschäfts- oder Firmenwert wertgemindert ist. Dies erfordert eine Schätzung der Nutzungswerte der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten,

denen der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. Zur Schätzung des Nutzungswerts muss die Unternehmensleitung die voraussichtlichen künftigen Cash Flows der zahlungsmittelgenerierenden Einheit schätzen und darüber hinaus einen angemessenen Abzinsungssatz wählen, um den Barwert dieser Cash Flows zu ermitteln. Der Buchwert der Geschäfts- oder Firmenwerte betrug zum 31. Dezember 2007 Euro 6.884.803 (2006: 7.435.643 Euro). Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Anhangsangabe 13 zu finden.

Aktive latente Steuern

Aktive latente Steuern werden für alle nicht genutzten steuerlichen Verlustvorträge in dem Maße erfasst, in dem es wahrscheinlich ist, dass hierfür zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, so dass die Verlustvorträge tatsächlich genutzt werden können. Für die Ermittlung der Höhe der aktiven latenten Steuern ist eine wesentliche Ermessensausübung der Unternehmensleitung auf der Grundlage des erwarteten Eintrittszeitpunkts und der Höhe des künftig zu versteuernden Einkommens sowie der zukünftigen Steuerplanungsstrategien erforderlich. Weitere Einzelheiten sind in der Anhangsangabe 16 dargestellt.

Pensionen und andere Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Der Aufwand aus leistungsorientierten Plänen und anderen medizinischen Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird anhand von versicherungsmathematischen Berechnungen ermittelt. Die versicherungsmathematische Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Annahmen in Bezug auf die Abzinsungssätze, erwartete Erträge aus Planvermögen, künftige Lohn- und Gehaltssteigerungen, die Sterblichkeit und die künftigen Rentensteigerungen. Entsprechend der langfristigen Ausrichtung dieser Pläne unterliegen solche Schätzungen wesentlichen Unsicherheiten. Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betrug zum 31. Dezember 2007 1.111.214 Euro (2006: 1.142.637 Euro). Weitere Einzelheiten hierzu sind in der Anhangsangabe 24 zu finden.

Entwicklungskosten

Entwicklungskosten werden entsprechend der in der Anhangsangabe 3 dargestellten Bilanzierungs- und Bewertungsmethode aktiviert. Für Zwecke der Ermittlung der zu aktivierenden Beträge hat die Unternehmensleitung Annahmen über die Höhe der erwarteten künftigen Cash Flows aus Vermögenswerten, die anzuwendenden Abzinsungssätze und den Zeitraum des Zuflusses von erwarteten zukünftigen

Cash Flows, die die Vermögenswerte generieren, vorzunehmen. Nach bestmöglicher Schätzung betrug der zu aktivierende Buchwert der Entwicklungskosten zum 31. Dezember 2007 9.118.381 Euro (2006: 7.993.837 Euro).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich den im Vorjahr angewandten Methoden mit folgenden Ausnahmen:

Der Konzern hat im Geschäftsjahr die nachfolgend aufgelisteten neuen und überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen angewandt. Aus der Anwendung dieser neuen oder überarbeiteten IFRS Standards und Interpretationen ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Sie führten jedoch teilweise zu zusätzlichen Angaben.

- ▶ IFRS 7: Finanzinstrumente: Angaben
- ▶ Änderung des IAS 1: Darstellung des Abschlusses
- ▶ IFRIC 8: Anwendungsbereich von IFRS 2
- ▶ IFRIC 9: Neubeurteilung eingebetteter Derivate
- ▶ IFRIC 10: Zwischenberichterstattung und Wertminderung

IFRS 7: Finanzinstrumente: Angaben

Dieser Standard verlangt Angaben, die es dem Abschlussadressaten ermöglichen, die Bedeutung der Finanzinstrumente für die Finanzlage und die Ertragskraft des Konzerns sowie die Art und das Ausmaß der aus diesen Finanzinstrumenten resultierenden Risiken zu beurteilen. Die hieraus resultierenden neuen Angaben (einschließlich der betreffenden Vergleichsinformationen für das Vorjahr) sind im vorliegenden Konzernanhang enthalten. Aus der Anwendung ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

IAS 1: Darstellung des Abschlusses

Aus dieser Änderung resultieren neue Angaben, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, die Ziele, Methoden und Prozesse des Konzerns zum Kapitalmanagement zu beurteilen. Die neuen Angaben werden in der Anhangsangabe 30 dargestellt.

IFRIC 8: Anwendungsbereich von IFRS 2

Diese Interpretation fordert die Anwendung von IFRS 2 für alle Transaktionen, bei denen ein Unternehmen einige oder alle erhaltenen Güter oder Dienstleistungen nicht spezifisch identifizieren kann. Dies gilt insbesondere, wenn die Gegenleistung für durch das Unternehmen gewährte Eigenkapitalinstrumente geringer zu sein scheint als

der beizulegende Zeitwert. Da im Konzern Eigenkapitalinstrumente lediglich an Mitarbeiter im Rahmen des Mitarbeiteraktienoptionsprogramms ausgegeben werden, hatte die Anwendung dieser Interpretation keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

IFRIC 9: Neubeurteilung eingebetteter Derivate

Gemäß IFRIC 9 muss das Unternehmen einen Vertrag über ein strukturiertes Instrument stets zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses daraufhin beurteilen, ob ein eingebettetes Derivat vorliegt. Eine Neubeurteilung ist nur zulässig bei einer erheblichen Änderung von Vertragsbedingungen, wenn es dadurch zu einer signifikanten Änderung der Zahlungsströme kommt. Da der Konzern keine vom Basisvertrag zu trennenden, eingebetteten Derivate aufweist, hatte diese Interpretation keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

IFRIC 10: Zwischenberichterstattung und Wertminderung

Der Konzern hat die IFRIC Interpretation 10 erstmals zum 1. Januar 2007 angewandt. Darin wird geregelt, dass ein im Rahmen eines Zwischenabschlusses erfasster Wertminderungsaufwand für den Geschäfts- oder Firmenwert, für gehaltene Eigenkapitalinstrumente oder finanzielle Vermögenswerte, die zu Anschaffungskosten bilanziert werden, im Folgeabschluss nicht rückgängig gemacht werden darf. Da der Konzern in der Vergangenheit keine derartigen Berichtigungen des erfassten Wertminderungsaufwands vorgenommen hat, hatte diese Interpretation keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

Das IASB und das IFRIC haben nachfolgend aufgelistete Standards und Interpretationen veröffentlicht, die bereits im Rahmen des Komitologieverfahrens in das EU-Recht übernommen, aber im Geschäftsjahr 2007 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. ELMOS wendet diese Standards und Interpretationen nicht vorzeitig an.

IFRS 8: Geschäftssegmente

IFRS 8 wurde im November 2006 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. IFRS 8 verlangt die Angabe von Informationen über die Geschäftssegmente eines Unternehmens und ersetzt die Verpflichtung, primäre (Geschäftssegmente) und sekundäre (geographische Segmente) Segmentberichtsformate für ein Unternehmen zu bestimmen. IFRS 8 folgt dem sog. Management-Ansatz, wonach sich die Segmentberichterstattung allein nach Finanzinformationen richtet, die

von den Entscheidungsträgern des Unternehmens zur internen Steuerung des Unternehmens verwendet werden. Bestimmend dabei sind die interne Berichts- und Organisationsstruktur sowie solche Finanzgrößen, die zur Entscheidungsfindung über die Allokation von Ressourcen und die Bewertung der Ertragskraft herangezogen werden. Der Konzern hat auf eine vorzeitige Anwendung von IFRS 8 verzichtet und wendet weiterhin IAS 14 Segmentberichterstattung an. Der neue Standard wird Einfluss auf die Art und Weise der Veröffentlichung von Finanzinformationen über die Geschäftsbereiche des Konzerns haben, jedoch nicht auf den Ansatz und die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden im Konzernabschluss. Die Abgrenzung der Segmente nach IFRS 8 wird der Abgrenzung nach IAS 14 entsprechen.

IFRIC 11 IFRS 2: Geschäfte mit eigenen Aktien und Aktien von Konzernunternehmen

Die IFRIC Interpretation 11 wurde im November 2006 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. März 2007 beginnen. Gemäß dieser Interpretation sind Vereinbarungen, nach denen Mitarbeitern Rechte an Eigenkapitalinstrumenten eines Unternehmens gewährt werden, auch dann als aktienbasierte Vergütungstransaktionen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente zu bilanzieren, wenn das Unternehmen die Instrumente von einem Dritten erwirbt oder wenn die Anteilseigner die benötigten Eigenkapitalinstrumente bereitstellen. Aufgrund des untergeordneten Umfangs von aktienbasierten Vergütungen im Konzern sind aus der erstmaligen Anwendung dieser Neuregelung in der Zukunft keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu erwarten.

Das IASB und das IFRIC haben nachfolgend aufgelistete Standards und Interpretationen veröffentlicht, die im Geschäftsjahr 2007 noch nicht verpflichtend anzuwenden waren. Diese Standards und Interpretationen wurden von der EU bislang nicht anerkannt und werden von ELMOS nicht angewendet.

Änderung des IFRS 2: Aktienbasierte Vergütungen

Die Änderung des IFRS 2 wurde im Januar 2008 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Die Änderung betrifft zum einen die Klarstellung, dass der Begriff der Ausübungsbedingungen ausschließlich die Dienst- und die Leistungsbedingungen beinhaltet. Zum anderen werden die Regelungen zur Bilanzierung einer vorzeitigen Beendigung von anteilsbasierten Vergütungsplänen auch auf Fälle einer Beendigung durch die Mitarbeiter ausgeweitet. Die Übergangsbestimmungen sehen eine retrospektive Anwendung der Neuregelung vor. Der

Konzern hat lediglich Stock-Option-Programme, die Ausübungsbedingungen gemäß oben genannter Definition beinhalten und dementsprechend werden keine Auswirkungen auf die Bilanzierung der aktienbasierten Vergütungen erwartet.

IFRS 3: Unternehmenszusammenschlüsse

Der geänderte Standard IFRS 3 wurde im Januar 2008 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen. Der Standard wurde im Rahmen des Konvergenzprojekts von IASB und FASB einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Die wesentlichen Änderungen betreffen insbesondere die Einführung eines Wahlrechts bei der Bewertung von Minderheitenanteilen zwischen der Erfassung mit dem anteiligen identifizierbaren Nettovermögen (sog. Purchased-Goodwill-Methode) und der sog. Full-Goodwill-Methode, wonach der gesamte, auch auf die Minderheitengesellschafter entfallende Teil des Geschäfts- oder Firmenwerts des erworbenen Unternehmens zu erfassen ist. Weiterhin sind die erfolgswirksame Neubewertung bereits bestehender Beteiligungsanteile bei erstmaliger Erlangung der Beherrschung (sukzessiver Unternehmenserwerb), die zwingende Berücksichtigung einer Gegenleistung, die an das Eintreten künftiger Ereignisse geknüpft ist, zum Erwerbszeitpunkt sowie die ergebniswirksame Behandlung von Transaktionskosten hervorzuheben. Die Übergangsbestimmungen sehen eine prospektive Anwendung der Neuregelung vor. Für Vermögenswerte und Schulden, die aus Unternehmenszusammenschlüssen vor der erstmaligen Anwendung des neuen Standards resultieren, ergeben sich keine Änderungen. Somit wird der geänderte Standard Einfluss auf zukünftige Unternehmenszusammenschlüsse und Transaktionen mit Minderheiten haben.

IAS 1: Darstellung des Abschlusses

Der überarbeitete Standard IAS 1 wurde im September 2007 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Die Neufassung des Standards beinhaltet wesentliche Änderungen in Darstellung und Ausweis von Finanzinformationen im Abschluss. Die Neuerungen beinhalten insbesondere die Einführung einer Gesamtrechnung, die sowohl das in einer Periode erwirtschaftete Ergebnis als auch die noch nicht realisierten Gewinne und Verluste, die bislang innerhalb des Eigenkapitals ausgewiesen wurden, umfasst und die Gewinn- und Verlustrechnung in ihrer bisherigen Form ersetzt. Darüber hinaus muss nunmehr neben der Bilanz zum Bilanzstichtag und der Bilanz zum vorangegangenen Stichtag zusätzlich eine Bilanz zu Beginn der Vergleichsperiode aufgestellt werden, sofern das Unternehmen rückwirkend Bilanzierungs-

und Bewertungsmethoden anwendet, einen Fehler korrigiert oder einen Abschlussposten umgliedert. Der neue Standard wird Einfluss auf die Art und Weise der Veröffentlichung von Finanzinformationen des Konzerns haben, jedoch nicht auf den Ansatz und die Bewertung von Vermögenswerten und Schulden im Konzernabschluss.

IAS 23: Fremdkapitalkosten

Der überarbeitete Standard IAS 23 wurde im März 2007 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Der Standard fordert eine Aktivierung von Fremdkapitalkosten, die einem qualifizierten Vermögenswert zugerechnet werden können. Als qualifizierter Vermögenswert wird ein Vermögenswert definiert, für den ein beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um ihn in seinen beabsichtigten gebrauch- oder verkaufsfähigen Zustand zu versetzen. Der Standard sieht eine prospektive Anwendung der Neuregelung vor. Für bisher angefallene Fremdkapitalkosten, die sofort aufwandswirksam erfasst wurden, ergeben sich hieraus keine Änderungen. Aufgrund der geringfügigen Inanspruchnahme von Fremdkapitalmitteln, die einem qualifizierten Vermögenswert zugerechnet werden können, sind im Geschäftsjahr aus der erstmaligen Anwendung dieser Neuregelung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu erwarten.

IAS 27: Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS

Der geänderte Standard IAS 27 wurde im Januar 2008 veröffentlicht. Die vorgenommenen Änderungen sind erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2009 beginnen. Die Änderungen resultieren aus dem gemeinsamen Projekt von IASB und FASB zur Überarbeitung von für Unternehmenszusammenschlüsse geltenden Bilanzierungsvorschriften. Die Änderungen betreffen primär die Bilanzierung von Anteilen ohne Beherrschungscharakter (Minderheitenanteile), die künftig in voller Höhe an den Verlusten des Konzerns beteiligt werden, und von Transaktionen, die zum Beherrschungsverlust bei einem Tochterunternehmen führen und deren Auswirkungen erfolgswirksam zu behandeln sind. Auswirkungen von Anteilsveräußerungen, die nicht zum Verlust der Beherrschung führen, sind demgegenüber erfolgsneutral im Eigenkapital zu erfassen. Die Übergangsbestimmungen, die grundsätzlich eine retrospektive Anwendung vorgenommener Änderungen fordern, sehen für oben aufgelistete Sachverhalte eine prospektive Anwendung vor. Für Vermögenswerte und Schulden, die aus solchen Transaktionen vor dem Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung des neuen Standards resultieren, ergeben sich daher keine Änderungen. Somit wird der geänderte Standard Einfluss auf zukünftige Transaktionen mit Minderheiten haben.

Änderung von IAS 32: Finanzinstrumente: Darstellung und IAS 1: Darstellung des Abschlusses

Die Änderung des IAS 32 und des IAS 1 wurde im Februar 2008 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2009 beginnen. Die Änderung betrifft die Klassifizierung von kündbaren Gesellschaftereinlagen als Eigen- oder als Fremdkapital. Nach bisheriger Regelung waren Unternehmen teilweise gezwungen, das gesellschaftsrechtliche Kapital aufgrund gesetzlich verankerter Kündigungsrechte der Gesellschafter als finanzielle Verbindlichkeiten auszuweisen. Künftig sollen diese Gesellschaftereinlagen in der Regel als Eigenkapital klassifiziert werden, sofern eine Abfindung zum beizulegenden Zeitwert vereinbart wird und die geleisteten Einlagen den nachrangigsten Anspruch auf das Nettovermögen des Unternehmens darstellen. Aufgrund der Rechtsform des Mutterunternehmens und den einschlägigen gesetzlichen und gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen werden sich aus der Neuregelung in der Zukunft keine Auswirkungen auf die Klassifizierung, Bewertung und Ausweis von Gesellschaftereinlagen im Konzernabschluss ergeben.

IFRIC 12: Dienstleistungskonzessionsvereinbarungen

Die IFRIC Interpretation 12 wurde im November 2006 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2008 beginnen. Die Interpretation regelt die bilanzielle Behandlung von im Rahmen von Dienstleistungskonzessionen übernommenen Verpflichtungen und erhaltenen Rechten im Abschluss des Konzessionsnehmers.

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind keine Konzessionsnehmer im Sinne von IFRIC 12. Diese Interpretation wird daher keine Auswirkungen auf den Konzern haben.

IFRIC 13: Kundenbonusprogramme

Die IFRIC Interpretation 13 wurde im Juni 2007 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2008 beginnen. Gemäß dieser Interpretation sind den Kunden gewährte Prämien als eigener Umsatz separat von der Transaktion zu bilanzieren, im Rahmen derer sie gewährt wurden. Daher wird ein Teil des beizulegenden Zeitwerts der erhaltenen Gegenleistung den gewährten Kundenprämien zugeordnet und passivisch abgegrenzt. Die Umsatzrealisierung erfolgt in der Periode, in der die gewährten Kundenprämien ausgeübt werden oder verfallen. Da der Konzern derzeit keine Kundenbonusprogramme aufgelegt hat, werden aus dieser Interpretation keine Auswirkungen auf den Konzernabschluss erwartet.

IFRIC 14 IAS 19: Die Begrenzung eines leistungsorientierten Vermögenswerts, Mindestfinanzierungsvorschriften und ihre Wechselwirkung

Die IFRIC Interpretation 14 wurde im Juli 2007 veröffentlicht und ist erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2008 beginnen. Diese Interpretation gibt Leitlinien zur Bestimmung des Höchstbetrags des Überschusses aus einem leistungsorientierten Plan, der nach IAS 19 Leistungen an Arbeitnehmer als Vermögenswert aktiviert werden darf. Da alle leistungsorientierten Pensionspläne des Konzerns derzeit unterdotiert sind, werden aus dieser Interpretation keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns erwartet.

2 Grundsätze der Konsolidierung

Konsolidierungskreis und Konsolidierungsmethoden

In den für das Geschäftsjahr 2007 aufgestellten Konzernabschluss sind neben der ELMOS Semiconductor AG alle Gesellschaften – soweit nicht unwesentlich – einbezogen, bei denen die ELMOS unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte verfügt oder aufgrund sonstiger Rechte ein Beherrschungsverhältnis im Sinne von IAS 27 „Konzern- und separate Einzelabschlüsse nach IFRS“ besteht. Der Kapitalkonsolidierung liegt die Erwerbsmethode zugrunde. Dabei werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit dem anteiligen Saldo der zum beizulegenden Zeitwert erworbenen identifizierten Vermögenswerte und Schulden aufgerechnet. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die identifizierbaren Vermögenswerte und Schulden vollständig mit den beizulegenden Zeitwerten angesetzt. Der Saldo eines verbleibenden aktiven Unterschiedsbetrags ist als Geschäftswert ausgewiesen.

Die Jahresabschlüsse der in den ELMOS-Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sind auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt.

Alle wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Transaktionen zwischen den konsolidierten Gesellschaften wurden im Konzernabschluss eliminiert.

Beteiligungen von mehr als 20%, aber nicht mehr als 50%, wurden, falls wesentlich, unter Anwendung der Equity-Methode erfasst.

SIC 12 „Konsolidierung – Zweckgesellschaften“ stellt die Anwendung des IAS 27 hinsichtlich derjenigen einzubeziehenden Gesellschaften klar, deren Eigenkapitalgeber keine Kontrolle gemäß dem control-Konzept ausüben. Es erfordert die Konsolidierung von Gesellschaften,

deren überwiegender Teil der erwarteten Verluste und Gewinne von dem berichtenden Konzern aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder anderer vertraglicher Vereinbarungen bzw. finanzieller Interessen übernommen werden.

Eine Aufstellung der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen befindet sich in der Anhangsangabe 34.

Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen

Die funktionale Währung der ELMOS Semiconductor AG und der europäischen Tochtergesellschaften ist der Euro. Der Konzernabschluss wurde in Euro aufgestellt.

Auf Fremdwährung lautende Vermögenswerte und Schulden werden grundsätzlich zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Für Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die lokale Währung des jeweiligen Landes ist, in dem diese Gesellschaft ihren Sitz hat, werden Aktiva und Passiva, die in Fremdwährung in den Bilanzen der ausländischen wirtschaftlich selbstständigen Tochtergesellschaften bilanziert werden, zu dem jeweiligen Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen Fremdwährungskursen während des zugrunde liegenden Zeitraums umgerechnet. Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der Bewertung des Eigenkapitals zum historischen Kurs und zum Stichtagskurs ergibt, wird als erfolgsneutrale Veränderung des Eigenkapitals ausgewiesen.

Die Gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kursicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht an Spekulationsgeschäften beteiligt. Die Devisentermingeschäfte stellen kein Risiko für die Ertragslage der Gesellschaft dar, da die Gewinne und Verluste aus diesen Verträgen in der Regel die Gewinne und Verluste aus den gesicherten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten ausgleichen. Sowohl zum 31. Dezember 2007 als auch zum 31. Dezember 2006 bestanden keine Devisentermingeschäfte.

Kapitalflussrechnung

Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Laufe des Geschäftsjahres durch Mittelzuflüsse und -abflüsse verändert haben. Die Auswirkungen von Akquisitionen, Desinvestitionen und sonstigen Veränderungen des Konsolidierungskreises sind dabei eliminiert. In Übereinstimmung mit IAS 7 wird zwischen Zahlungsströmen

aus betrieblicher Tätigkeit, aus dem Investitionsbereich und aus dem Finanzierungsbereich unterschieden. Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finanzierungsaufwendungen und -erträge entsprechen im Wesentlichen den gezahlten Beträgen.

3 Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von ASICs, ASSPs und mikromechanischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung. Die Umsatzerlöse werden ohne Umsatzsteuer und nach Abzug von gewährten Skonti ausgewiesen.

Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den Kunden bzw. bei Gefahrenübergang auf den Kunden. Im Rahmen von Konsignationslagervereinbarungen erfolgt die Umsatzrealisierung entweder bei Entnahme des Kunden oder bereits bei Bestückung des Konsignationslagers, in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Umsatzerlöse aus Entwicklungstätigkeit werden nach Erreichen bestimmter sog. Milestones in Abhängigkeit vom Fertigstellungsgrad realisiert.

Geschäfts- oder Firmenwert

Durch die Anwendung von IFRS 3, IAS 36 (überarbeitet 2004) und IAS 38 (überarbeitet 2004) ab dem Geschäftsjahr 2004 werden Geschäftswerte aus Unternehmensakquisitionen nicht länger planmäßig abgeschrieben, sondern mindestens einmal jährlich auf Werthaltigkeit überprüft. Zum Erwerbszeitpunkt wird der erworbene Geschäfts- oder Firmenwert jener zahlungsmittelgenerierenden Einheit zugeordnet, die erwartungsgemäß von den erzielten Synergien aus dem Unternehmenszusammenschluss profitieren wird. Die Wertminderung wird durch die Ermittlung des erzielbaren Betrags der zahlungsmittelgenerierenden Einheit bzw. „Cash Generating Units“ (CGU), auf die sich der Geschäftswert bezieht, bestimmt. Liegt der erzielbare Betrag der CGU unter ihrem Buchwert, ist ein Wertminderungsaufwand auf den Geschäfts- oder Firmenwert zu erfassen.

Darüber hinaus ist ein Werthaltigkeitstest durchzuführen, sofern besondere Ereignisse oder Marktentwicklungen anzeigen, dass der Marktwert einer Berichtseinheit unter ihren Buchwert gefallen sein könnte.

Grundsätzlich wird die Werthaltigkeitsprüfung wie folgt durchgeführt:

Alle Geschäfts- oder Firmenwerte werden den entsprechenden CGUs zugeordnet. Dabei stellen die Tochtergesellschaften im Regelfall jeweils eine CGU dar.

Für jede CGU werden auf Basis einer Mehrjahresplanung die zukünftigen Cash Flows ermittelt. Die Mehrjahresplanung erfolgt über einen Zeitraum von 5 Jahren. Danach wird eine 1,5%-ige Wachstumsrate zugrunde gelegt. Anschließend wird der Barwert (im Folgenden auch „Value in Use“ genannt) dieser zukünftigen Cash Flows errechnet. Der verwendete Vorsteuer-Zinssatz wurde mit Hilfe des Capital Asset Pricing Model (CAPM) ermittelt und beträgt für die SMI 6,32% und für ELMOS France 7,58% (vor Abzug Wachstumsrate). Der Zinssatz entspricht den gewichteten, durchschnittlichen Kapitalkosten. Diese beruhen auf einem risikofreien Zinssatz (5,1%) zuzüglich der durchschnittlichen Marktrisikoprämie (4,5%) multipliziert mit einem unternehmensbezogenen Eigenkapitalbeta basierend auf einem sog. Raw- β von 0,7. Alle genannten Werte sind aus Marktdaten abgeleitet.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Aus der Entwicklung entstehende immaterielle Vermögenswerte werden entsprechend IAS 38 nur aktiviert, wenn es u.a. (a) hinreichend wahrscheinlich ist, dass dem Unternehmen der künftige wirtschaftliche Nutzen aus dem Vermögenswert zufließen wird und (b) die Kosten des Vermögenswerts zuverlässig bemessen werden können. Diese Kriterien treffen für die aktivierten Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit der Entwicklung von ASICs zu. Mit der Abschreibung wird nach Abschluss der Entwicklungsphase bzw. bei Beginn der Vorserienfertigung begonnen.

Die Aktivierung der Entwicklungskosten erfolgt, nachdem die technologische Durchführbarkeit bzw. Realisierbarkeit hergestellt ist und die sog. Engineering-Phase (sog. QB II-Status) erreicht wird.

Die Aktivierung findet nur für Projekte statt, die im Zusammenhang mit einem Kundenauftrag stehen.

Die Kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen Grundlage über die geschätzte Nutzungsdauer von 7 Jahren amortisiert.

Aufwendungen für die Anmeldung von Patenten und den Erwerb von Design- und Prozesstechnologie werden aktiviert. Aufwendungen werden unter Verwendung der linearen Methode über die jeweils

kürzere geschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Technologien, die Schutzfrist bei Patenten oder die Vertragsdauer, aber maximal über 18 Jahre abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Vermögenswerte werden mit ihren Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer von 3 bis 8 Jahren abgeschrieben.

Die Abschreibungen werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Sachanlagen

Sachanlagen werden grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten aktiviert.

Die Sachanlagen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer wie folgt linear abgeschrieben:

Gebäude	25 bis 50 Jahre
Einbauten	10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 12 Jahre

Im Falle, dass der Buchwert den voraussichtlich erzielbaren Betrag übersteigt, wird entsprechend IAS 36 (überarbeitet 2004) eine Wertminderung auf diesen Wert vorgenommen.

Bei Verkauf oder Abgang von Sachanlagevermögen werden die entsprechenden Anschaffungskosten sowie die dazugehörige kumulierte Abschreibung aus den entsprechenden Konten entfernt. Gewinne oder Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen werden als sonstige betriebliche Erträge oder Aufwendungen gezeigt. Wartung oder Instandhaltungsaufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.

Unter Anwendung von IAS 17 werden geleaste Gegenstände, die der Gesellschaft als wirtschaftlichem Eigentümer zuzuordnen sind, aktiviert und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben (sog. Finance-Lease). Entsprechend wird die Verbindlichkeit, die aus dem Leasingverhältnis entsteht, passiviert und um den Tilgungsanteil der geleisteten Leasingraten gemindert.

Andere Leasingverhältnisse, die die Gesellschaft eingegangen ist, werden als Operating-Leasingverhältnisse eingestuft. Die geleisteten Leasingzahlungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung linear über die Laufzeit erfasst.

Finanzinstrumente

Die bilanzierten Finanzinstrumente enthalten liquide Mittel, zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, übrige Fremdfinanzierungen und Finanzierungsleasing.

Finanzinstrumente werden gemäß IAS 39.14 erfasst, sobald die Gesellschaft Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Bei regulären Erwerben und Verkäufen erfolgt die Einbuchung zum Erfüllungstag.

Finanzielle Vermögenswerte werden folgendermaßen klassifiziert: bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen, zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte. Finanzielle Vermögenswerte mit festgelegten oder bestimmbareren Zahlungen und festen Laufzeiten, die die Gesellschaft bis zur Endfälligkeit halten möchte und kann, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und Forderungen, werden als bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen klassifiziert. Finanzielle Vermögenswerte, die hauptsächlich erworben wurden, um einen Gewinn aus kurzfristigen Preis- bzw. Kursschwankungen zu erzielen, werden als zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Alle sonstigen finanziellen Vermögenswerte, ausgenommen von der Gesellschaft ausgereichte Kredite und Forderungen, werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte eingestuft.

Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen werden unter den langfristigen Vermögenswerten bilanziert, es sei denn, sie werden innerhalb von 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag fällig. Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden unter den kurzfristigen Vermögenswerten bilanziert. Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte werden als kurzfristig eingestuft, wenn sie innerhalb von 12 Monaten ab dem Bilanzstichtag realisiert werden sollen.

Bei der erstmaligen Erfassung eines finanziellen Vermögenswertes wird dieser mit dem fair value angesetzt, der dem beizulegenden Zeitwert der gegebenen Gegenleistung entspricht; Transaktionskosten werden mit einbezogen. Zur Veräußerung verfügbare und zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte werden in der Folge mit ihrem beizulegenden Zeitwert ohne Abzug von gegebenenfalls anfallenden Transaktionskosten und unter Angabe ihres notierten Marktpreises zum Bilanzstichtag bewertet.

Gewinne und Verluste aus der Bewertung eines zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerts zum beizulegenden Zeitwert werden direkt im übrigen Eigenkapital erfasst, bis der finanzielle Vermögenswert verkauft, eingezogen oder anderweitig abgegangen ist oder bis eine Wertminderung für den finanziellen Vermögenswert festgestellt wurde, so dass zu diesem Zeitpunkt der zuvor im Eigenkapital erfasste, kumulative Gewinn oder Verlust in das Periodenergebnis einbezogen wird.

Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten werden im Finanzergebnis erfasst. Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen werden mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten unter Verwendung der Effektivzinsmethode bewertet.

Finanzinstrumente werden bei der erstmaligen Erfassung entsprechend dem wirtschaftlichen Gehalt der vertraglichen Vereinbarung entweder als Vermögenswerte, als Schulden oder als Eigenkapital eingestuft.

Zinsen, Dividenden, Gewinne und Verluste im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, die als finanzielle Schulden klassifiziert werden, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen bzw. Erträge in der Periode erfasst, in der sie angefallen sind. Ausschüttungen an Inhaber von Finanzinstrumenten, die als Eigenkapital klassifiziert werden, werden direkt vom Eigenkapital abgesetzt. Sind Rechte und Pflichten bezüglich der Art der Erfüllung eines Finanzinstrumentes abhängig vom Eintreten oder Nichteintreten ungewisser zukünftiger Ereignisse oder dem Ausgang ungewisser Umstände, die außerhalb der Kontrolle sowohl des Emittenten als auch des Inhabers liegen, so wird das Finanzinstrument als Schuld klassifiziert, soweit es nicht zum Zeitpunkt der Emission sehr unwahrscheinlich ist, dass der Emittent zur Erfüllung von Zahlungsmitteln oder anderen finanziellen Vermögenswerten verpflichtet ist. In diesem Fall würde das Instrument als Eigenkapital klassifiziert werden.

Von der Möglichkeit, finanzielle Vermögenswerte bei ihrem erstmaligen Ansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte (*Financial assets at fair value through profit or loss*) zu designieren, hat die Gesellschaft bisher keinen Gebrauch gemacht.

Bei den finanziellen Verbindlichkeiten hat der Konzern von der Anwendung des Wahlrechts, diese bei ihrer erstmaligen bilanziellen Erfassung als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Verbindlichkeiten (*Financial liabilities at fair value through profit or loss*) zu designieren, bislang keinen Gebrauch gemacht.

Vorratsvermögen

Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zum niedrigeren realisierbaren Nettoverkaufswert am Bilanzstichtag bewertet. In den Herstellungskosten werden, neben den direkt zurechenbaren Kosten, auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen einbezogen. Dabei werden fixe Gemeinkosten auf Grundlage der Normalauslastung der Produktionsanlagen berücksichtigt. Kosten der nicht genutzten Produktionskapazitäten (Leerkosten) werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in den Kosten der umgesetzten Leistung ausgewiesen. Wertberichtigungen auf Vorräte werden vorgenommen, soweit die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über den erwarteten Nettoveräußerungserlösen liegen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennbetrag unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Gemäß IFRS 7.21/IAS 1.108 umfasst die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen in erheblichem Maße Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf die Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, aktuellen Konjunktorentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis abgeleitet wird, führt ein Rückgang des Forderungsbestandes zu einer entsprechenden Verminderung solcher Vorsorgen und umgekehrt.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (Liquide Mittel)

Liquide Mittel umfassen für Zwecke der Finanzierungsrechnung Kassenbestände, Schecks, Bankguthaben sowie jederzeit veräußerbare Wertpapiere.

Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsbereiche

Nach IFRS 5 wird ein Unternehmensbestandteil zu dem Zeitpunkt als aufgegeben eingestuft, ab dem dieser Unternehmensbestandteil die Kriterien für eine Klassifizierung als zur Veräußerung gehalten erfüllt. Ein solcher Unternehmensbestandteil stellt einen gesonderten, wesentlichen Geschäftszweig oder geografischen Geschäftsbereich dar, ist Teil eines einzelnen, abgestimmten Plans zur Veräußerung eines gesonderten, wesentlichen Geschäftszweigs oder geografischen Geschäftsbereichs oder ist ein Tochterunternehmen, das ausschließlich mit der Absicht einer Weiterveräußerung erworben wurde.

Ein Vermögenswert ist als zur Veräußerung gehalten zu klassifizieren, wenn der zugehörige Buchwert überwiegend durch ein Veräußerungsgeschäft und nicht durch fortgesetzte Nutzung realisiert wird.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für rechtliche oder faktische Verpflichtungen, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben, dann gebildet, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Erfüllung der Verpflichtung zu einem Abfluss von Konzernressourcen führt und eine zuverlässige Schätzung der Verpflichtungshöhe vorgenommen werden kann.

Die periodischen Netto-Pensionsaufwendungen unter IAS 19 setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, die verschiedene Aspekte der finanziellen Vereinbarungen des Unternehmens sowie die Kosten der von den Arbeitnehmern bezogenen Leistungen widerspiegeln. Diese Komponenten werden unter Anwendung der versicherungsmathematischen Kostenmethode bestimmt und basieren auf versicherungsmathematischen Annahmen, die in der Anhangsangabe 24 angegeben sind.

Die Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sehen vor:

- ▶ in der geplanten Leistungsverpflichtung alle Leistungsverbesserungen widerzuspiegeln, zu denen das Unternehmen ab dem aktuellen Bewertungsdatum verpflichtet ist,
- ▶ kumulative versicherungsmathematische Gewinne und Verluste von mehr als 10% der geplanten Leistungsverpflichtung über die erwarteten zukünftigen Leistungen aktiver im Plan erfasster Arbeitnehmer zu amortisieren (sog. Korridormethode).

Rückstellungen für Gewährleistung werden ab dem Verkaufszeitpunkt auf Grundlage des Verhältnisses der Garantiekosten zu den Umsatzerlösen in der Vergangenheit gebildet. Weiter werden für Einzelfälle nach erfolgter Risikoeinschätzung sowohl der vertrieblichen als auch der juristischen Konsequenzen in angemessener Höhe gebildet.

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern bemisst sich die Steuerlast nach der Höhe des jährlichen Einkommens und berücksichtigt Steuerlatenzen. Latente Steuern werden mit Hilfe der Verbindlichkeits-Methode (*liability-method*) ermittelt. Latente Ertragsteuern spiegeln den Nettosteueraufwand/-ertrag temporärer Unterschiede zwischen dem Buchwert eines Vermögenswertes oder einer Schuld in der Bilanz und deren Steuerwert wider. Die Bemessung latenter Steueransprüche und -schulden erfolgt anhand der Steuersätze, die erwartungsgemäß für die Periode gelten, in der ein Vermögenswert realisiert oder eine Schuld beglichen wird. Die Bewertung latenter Steuerschulden und -ansprüche berück-

sichtigt die steuerlichen Konsequenzen, die daraus resultieren, in welcher Art und Weise ein Unternehmen zum Bilanzstichtag erwartet, den Buchwert seiner Vermögenswerte zu realisieren oder seine Schulden zu begleichen.

Latente Steueransprüche und -schulden werden unabhängig von dem Zeitpunkt erfasst, an dem sich die temporären Buchungsunterschiede voraussichtlich umkehren. Latente Steueransprüche und -schulden werden nicht abgezinst und werden in der Bilanz als langfristige Vermögenswerte bzw. Schulden ausgewiesen.

Ein latenter Steueranspruch wird für alle abzugsfähigen temporären Unterschiede in dem Maße bilanziert, wie es wahrscheinlich ist, dass zu versteuerndes Einkommen verfügbar sein wird, gegen das der temporäre Unterschied verwendet werden kann. Zu jedem Bilanzstichtag beurteilt das Unternehmen nicht bilanzierte latente Steueransprüche neu. Das Unternehmen setzt einen bislang nicht bilanzierten latenten Steueranspruch in dem Umfang an, in dem es wahrscheinlich geworden ist, dass ein künftig zu versteuerndes Ergebnis die Realisierung des latenten Steueranspruches gestatten wird.

Umgekehrt vermindert es den Buchungswert eines latenten Steueranspruches in dem Umfang, in dem es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass ausreichendes zu versteuerndes Ergebnis zur Verfügung stehen wird, um vom Nutzen des latenten Steueranspruches – entweder zum Teil oder insgesamt – Gebrauch zu machen.

Tatsächliche Steuern und latente Steuern werden unmittelbar dem Eigenkapital belastet oder gutgeschrieben, wenn sich die Steuer auf Posten bezieht, die in der gleichen oder einer anderen Periode unmittelbar dem Eigenkapital gutgeschrieben oder belastet wird.

In dem Umfang wie nicht ausgeschüttete Gewinne ausländischer Beteiligungen auf unabsehbare Zeit in diesem Unternehmen investiert bleiben sollen, fallen keine latenten Steuerschulden an. Eine latente Steuerschuld wird für alle zu versteuernden temporären Differenzen ausgewiesen, soweit die latente Steuerschuld nicht aus dem Geschäftswert resultiert, für den eine Abschreibung zu Steuerzwecken nicht möglich ist.

Die aktiven latenten Steuern umfassen auch Steuererminderungsansprüche, die sich aus der erwarteten Nutzung bestehender Verlustvorträge in Folgejahren ergeben und deren Realisierung mit hinreichender Sicherheit gewährleistet ist.

Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden.

Gemäß IAS 1.70 werden latente Steuern als langfristig ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4 Segmentberichterstattung

Das primäre Berichtsformat der Gesellschaft basiert auf Geschäftssegmenten, das sekundäre Berichtsformat auf geografischen Segmenten. Die operativen Geschäfte werden hinsichtlich der Art der Produkte getrennt voneinander organisiert und geleitet, wobei jedes Segment eine strategische Geschäftseinheit darstellt, die unterschiedliche Produkte bereitstellt und unterschiedliche Märkte bedient. Die Umsatzerlöse zwischen den Segmenten erfolgen zu Verrechnungspreisen – abzgl. gezahlter Provisionen –, die denen bei Transaktionen mit fremden Dritten entsprechen.

Primäres Berichtsformat

Die Gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in zwei Bereiche ein:

Das Halbleitergeschäft wird über die verschiedenen Ländergesellschaften und -niederlassungen in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Südafrika und in den USA abgewickelt.

Umsatzerlöse im Mikromechanik-Bereich erwirtschaftet die Tochtergesellschaft SMI in den USA.

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu Erträgen und Ergebnissen sowie bestimmte Informationen zu Vermögenswerten und Schulden der Geschäftssegmente des Konzerns für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2007 und zum 31. Dezember 2006.

Geschäftsjahr zum 31.12.2007	Halbleiter Tsd. Euro	Mikromechanik Tsd. Euro	Konsolidierung Tsd. Euro	Gesamt Tsd. Euro
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	163.611	12.523	0	176.134
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	261	1.303	-1.564	0
Summe Umsatzerlöse	163.872	13.826	-1.564	176.134
Ergebnis				
Segmentergebnis	20.711	-5.551	0	15.160
Finanzergebnis				-2.971
Ergebnisanteil von Beteiligungsunternehmen	49	0	0	49
Ergebnis vor Steuern				12.238
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				-3.604
Jahresüberschuss inklusive Minderheitenanteile				8.634
Vermögenswerte und Schulden				
Segmentvermögen	181.424	16.788	0	198.212
Beteiligungsinvestitionen	74	0	0	74
Nicht zuzuordnendes Vermögen	-	-	-	51.039
Gesamtvermögen				249.325
Segmentschulden	24.821	2.131	0	26.952
Nicht zuzuordnende Schulden	-	-	-	62.408
Gesamtsumme Schulden				89.360
Sonstige Segmentinformationen				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	23.781	707		24.488
Abschreibungen	17.903	1.697		19.600
Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen	2.176	0		2.176

Geschäftsjahr zum 31.12.2006	Halbleiter Tsd. Euro	Mikromechanik Tsd. Euro	Konsolidierung Tsd. Euro	Gesamt Tsd. Euro
Umsatzerlöse				
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	150.009	10.665	0	160.674
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	352	1.690	- 2.042	0
Summe Umsatzerlöse	150.361	12.355	- 2.042	160.674
Ergebnis				
Segmentergebnis	19.519	353		19.872
Finanzergebnis				- 2.503
Ergebnisanteil von Beteiligungsunternehmen	- 49	0	0	- 49
Ergebnis vor Steuern				17.321
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				- 6.644
Jahresüberschuss inklusive Minderheitenanteile				10.676
Vermögenswerte und Schulden				
Segmentvermögen	199.826	19.866	0	219.691
Beteiligungsinvestitionen	126	0	0	126
Nicht zuzuordnendes Vermögen	-	-	-	25.526
Gesamtvermögen				245.343
Segmentenschulden	22.403	1.377	0	23.780
Nicht zuzuordnende Schulden	-	-	-	69.305
Gesamtsumme Schulden				93.085
Sonstige Segmentinformationen				
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	23.730	2.621		26.351
Abschreibungen	15.496	791		16.287
Sonstige wesentliche zahlungsunwirksame Aufwendungen	6.202	0		6.202

Sekundäres Berichtsformat

Die folgenden Tabellen enthalten Informationen zu Umsatzerlösen, Aufwendungen und zu bestimmten Vermögenswerten der geografischen Segmente des Konzerns für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2007 und zum 31. Dezember 2006.

Bei der regionalen Umsatzverteilung hat sich im Vergleich zu 2006 im Wesentlichen eine Verschiebung von den USA zu den Sonstigen Ländern ergeben. Hier sind vor allem Kanada, China, Mexiko, Schweiz und Taiwan als Länder mit Umsatzzuwachs zu nennen. Die Veränderungen sind hauptsächlich auf den Wechsel einzelner Lieferadressen der Kunden bzw. dem gesteigerten Umsatz mit bisherigen Kunden in den o.g. Ländern zurückzuführen und nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung der Kundenstruktur.

Geschäftsjahr zum 31.12.2007	Deutschland Tsd. Euro	Sonstige EU-Länder Tsd. Euro	USA Tsd. Euro	Sonstige Tsd. Euro	Konsolidierung Tsd. Euro	Gesamt Tsd. Euro
Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	63.695	64.619	19.176	28.644		176.134
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	1.303		261		- 1.564	0
Summe Umsatzerlöse	64.998	64.619	19.437	28.644	- 1.564	176.134
Vermögenswerte						
Segmentvermögen	168.538	12.170	17.489	15		198.212
Beteiligungsinvestitionen	55	0	19	0		74
Nicht zuzuordnendes Vermögen						51.039
Gesamtvermögen						249.325
Sonstige Segmentinformationen						
Investitionen in das Anlagevermögen	23.362	372	754	0		24.488
Geschäftsjahr zum 31.12.2006						
Umsatzerlöse						
Umsatzerlöse mit fremden Dritten	60.019	59.933	21.545	19.177	0	160.674
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	1.688	2	352	0	- 2.042	0
Summe Umsatzerlöse	61.707	59.935	21.897	19.177	- 2.042	160.674
Vermögenswerte und Schulden						
Segmentvermögen	180.839	17.982	20.854	17		219.692
Beteiligungsinvestitionen	107	0	19	0		126
Nicht zuzuordnendes Vermögen						25.525
Gesamtvermögen						245.343
Sonstige Segmentinformationen						
Investitionen in das Anlagevermögen	22.698	956	2.697	0		26.351

5 Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielt Umsatzerlöse aus dem Verkauf von ASICs, ASSPs und mikromechanischen Sensorelementen sowie aus deren Entwicklung.

Die Umsatzerlöse setzen sich für den Konzern und seine Segmente wie folgt zusammen:

	2007 Euro	2006 Euro
Halbleiter	163.610.067	150.009.437
Mikromechanik	12.523.461	10.664.450
Konzern	176.133.528	160.673.887

Die Umsatzerlöse wuchsen um 9,6% auf 176.134 Tsd. Euro. Der Mikro-mechanik-Bereich trug überproportional zum Umsatzwachstum bei und stieg um 17,4% auf 12,5 Mio. Euro in 2007 an.

6 Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten enthalten die Kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen. Neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten enthalten sie auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten sowie Abschreibungen. Die Umsatzkosten enthalten dazu die Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben sich wie folgt entwickelt:

	2007 Euro	2006 Euro
Materialaufwand	39.664.957	31.474.574
Personalaufwand	30.215.962	29.595.550
Sonstige Gemeinkosten	38.607.182	31.137.729
Bestandserhöhung	- 5.463.691	- 4.577.928
	103.024.409	87.629.925

Die Umsatzkosten stiegen von 87,6 Mio. Euro in 2006 überproportional zum Umsatz um 17,6% auf 103,0 Mio. Euro im Berichtsjahr. Diese Entwicklung ist vor allem auf erhöhte Aufwendungen beim Aufbau des neuen Fertigungsstandortes in Duisburg zurückzuführen. Darüber hinaus führte die Restrukturierung zweier Tochtergesellschaften zu einer Erhöhung der Umsatzkosten um 3.761 Tsd. Euro, insbesondere betraf dies den Materialaufwand und die Sonstigen Gemeinkosten.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Bedeutsame Aufwendungen fallen regelmäßig im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungsprojekten an, die in Erwartung auf zukünftige Erlöse durchgeführt werden. Forschungsaufwendungen werden entsprechend dem Anfall der Arbeiten ergebnismindernd berücksichtigt. Entwicklungsaufwendungen werden je nach Projekt aktiviert und dann planmäßig abgeschrieben bzw. – sofern die Aktivierungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind – ergebnismindernd verbucht. Im Geschäftsjahr 2007 wurden Ausgaben in Höhe von 30.892.815 Euro (2006: 29.583.236 Euro) als Aufwand erfasst, davon als Restrukturierungskosten 153 Tsd. Euro.

Vertriebskosten

Zu den Vertriebskosten gehören im Wesentlichen Aufwendungen für Personal und Abschreibungen.

Verwaltungsaufwendungen

Zu den Verwaltungsaufwendungen zählen neben den Kosten des im Verwaltungsbereich tätigen Personals auch anteilige Personalkosten des Vorstands. Wesentliche Posten sind weiter die Aufwendungen aus Abschreibungen. Darüber hinaus fallen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten im Verwaltungsbereich sowie Restrukturierungskosten in Höhe von 926 Tsd. Euro an.

7 Zusätzliche Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren

Im Rahmen der Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung in Form des Umsatzkostenverfahrens erfolgt die Zuordnung der Aufwendungen nach Funktionsbereichen. In den Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten und den Kosten für Forschung und Entwicklung waren die nachstehend aufgeführten Kostenarten wie folgt enthalten:

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2007 43.262.055 Euro und sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen (2006: 37.954.353 Euro). Sie setzen sich zusammen aus Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen.

Personalaufwand

Der Personalaufwand stieg um 5,8% von 59.456.302 Euro im Geschäftsjahr 2006 auf 62.898.042 Euro im Geschäftsjahr 2007. Im gleichen Berichtszeitraum ist die Anzahl der Mitarbeiter – gemessen als durchschnittlicher Beschäftigungsquotient – von 1.131 im Geschäftsjahr 2006 auf 1.177 im Geschäftsjahr 2007 gestiegen. Der Anstieg des Per-

sonalaufwands ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Anzahl von Beschäftigten zurückzuführen. Weiter gehende Angaben zu den Beschäftigten finden sich unter der Anhangsangabe 41.

Abschreibungen

Die Aufgliederung der Abschreibungen ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen im Geschäftsjahr 19.214.438 Euro (2006: 16.336.279 Euro).

Bedingt durch das Umsatzkostenverfahren sind die Abschreibungen für Sachanlagegüter und übrige immaterielle Vermögenswerte in der Gewinn- und Verlustrechnung auf die Positionen Umsatzkosten, Forschungs- und Entwicklungskosten, Vertriebskosten und Verwaltungskosten verteilt worden.

8 Finanzierungsaufwendungen und -erträge

Die Finanzierungsaufwendungen betragen 3.793.824 Euro in 2007 gegenüber 2.954.883 Euro in 2006. Sie beinhalten im Wesentlichen Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Banken sowie für langfristige Verbindlichkeiten.

Unter der Position Finanzierungserträge wurden im Geschäftsjahr im Wesentlichen Zinserträge ausgewiesen. Die Finanzierungserträge beliefen sich in Summe auf 822.450 Euro (2006: 452.319 Euro).

Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung erfassten Finanzierungsaufwendungen und -erträge entsprechen im Wesentlichen den gezahlten Beträgen.

Die Gesamtbeträge der Zinserträge und Zinsaufwendungen für finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, stellen sich wie folgt dar:

	2007 Euro	2006 Euro
Zinsertrag	- 822.450	- 451.418
Zinsaufwand	3.790.291	2.914.957
Zinsergebnis	2.967.841	2.463.539

9 Wechselkursverluste und -gewinne

Die erfolgswirksam erfassten Verluste aus Umrechnungsdifferenzen betragen im Geschäftsjahr 2007 381.093 Euro (2006: 288.115 Euro Umrechnungsverluste).

Die erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferenzen belaufen sich im Geschäftsjahr 2007 auf 6.407.297 Euro (2006: 5.587.888 Euro) unter Berücksichtigung der darauf entfallenden latenten Steuern.

Weitergehende Angaben zu den erfolgsneutral erfassten Umrechnungsdifferenzen stehen unter der Anhangsangabe 22.

10 Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 9.312.235 Euro (2006: 5.834.782 Euro) umfassen neben Investitionszuschüssen in Höhe von 298 Tsd. Euro einen Ertrag aus dem Abgang eines Leasinggegenstandes. Im Zusammenhang mit dem Sale-and-Lease-back-Leasingvertrag „Exedra“ aus 1997, der bislang als Finance-Lease dargestellt wurde, erfolgte durch die Umstellung des Leasingvertrags auf ein Operate-Leasingverhältnis, eine Ausbuchung des bisher aktivierten Leasingvermögens in Höhe von 8.994 Tsd. Euro und der entsprechenden Leasingverbindlichkeit in Höhe von 16.175 Tsd. Euro. In Höhe der Differenz zwischen Verkehrswert 13.750 Tsd. Euro und dem Restbuchwert der Immobilie wurde der daraus resultierende Betrag in voller Höhe erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst (4.756 Tsd. Euro).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 8.240.100 Euro (2006: 5.239.685 Euro) enthalten unter anderem Aufwendungen für Garantieleistungen (einschließlich Zuführungen zu den Rückstellungen) und Wertberichtigungen auf Forderungen.

Aus der Restrukturierung zweier ausländischer Tochtergesellschaften ergab sich ein sonstiger betrieblicher Aufwand in Höhe von 821 Tsd. Euro.

11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Als Ertragsteuern sind sowohl die gezahlten oder geschuldeten Steuern auf Einkommen und Ertrag als auch die latenten Steuerabgrenzungen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ausgewiesen.

	2007 Euro	2006 Euro
Laufender Ertragsteueraufwand		
Deutschland	309.395	627.597
Ausland	2.685.235	557.992
	2.994.630	1.185.589
davon Anpassungen von im Vorjahr angefallenen tatsächlichen Ertragssteuern	226.000	23.140
Latente Steuern		
Deutschland	826.722	2.257.994
Ausland	- 217.710	3.200.787
	609.012	5.458.781
	3.603.642	6.644.370

Latente Steuern sind nach der so genannten Verbindlichkeits-Methode gemäß IAS 12 berechnet worden. Für Deutschland wurde der kombinierte Ertragsteuersatz von 31,58% (2006: 39,9%) angewandt. Dieser kombinierte Steuersatz der Gesellschaft berücksichtigt den Gewerbesteuerhebesatz von 450% (2006: 450%), den Körperschaftsteuersatz von 15,0% (2006: 25,0%) sowie den Solidaritätszuschlag von 5,5% (2006: 5,5%).

Latente Steuern spiegeln die steuerlichen Auswirkungen aus zeitlichen Unterschieden zwischen den Buchwerten der Aktiva und Passiva in den handelsrechtlichen Abschlüssen einerseits und den in den steuerlichen Abschlüssen verwendeten Werten andererseits wider. Wesentliche Bestandteile der aktiven und passiven latenten Steuern der Gesellschaft sind unter der Anhangsangabe 16 dargestellt.

Die Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Nominalsteuersatz und den von der Gesellschaft tatsächlich zu zahlenden Steuern vom Einkommen und Ertrag stellen sich wie folgt dar:

	2007 %	2006 %
Gesetzlicher Nominalsteuersatz	39,90	39,90
Nicht abzugsfähige Aufwendungen	1,31	0,58
Steuern Vorjahre	1,85	0,00
Unterschiedsbetrag aus ausländischen Steuersätzen	- 11,67	- 7,70
Steuersatzänderungen Inland (Vorjahr Ausland)	- 9,97	6,34
Nichtaktivierung aktiver latenter Steueransprüche	7,28	0,00
Sonstige	0,75	- 0,80
Effektiver Steuersatz	29,45	38,32

Der positive Effekt aus der Absenkung der Steuersätze ab 2008 in Deutschland beträgt 1.190 Tsd. Euro.

12 Ergebnis je Aktie

Das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Stammaktien berechnet. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien zuzüglich aller Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter nach der sogenannten *Treasury Stock Method* berechnet.

Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde wie folgt ermittelt:

Abstimmung der Aktien

	2007	2006
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien	19.406.855	19.413.310
Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter	1.633	14.056
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien einschließlich Verwässerungseffekt	19.408.488	19.427.366

Berechnung des Ergebnisses pro Aktie

	2007	2006
Jahresüberschuss nach Minderheitenanteilen	8.797.717	10.694.672
Unverwässertes Ergebnis je Aktie	0,45	0,55
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,45	0,55

Erläuterungen zur Bilanz

13 Immaterielle Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
SMI		
Anschaffungskosten	7.567.365	7.567.365
Fremdwährungsanpassung	- 3.044.227	- 2.513.636
Buchwert	4.523.138	5.053.729
ELMOS NA		
Anschaffungskosten	554.617	554.617
Fremdwährungsanpassung	- 13.700	6.549
Buchwert	540.917	561.166
ELMOS France	1.614.578	1.614.578
ELMOS Services B.V.	206.170	206.170
	6.884.803	7.435.643

Gemäß IFRS 3 wird der Geschäfts- oder Firmenwert nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern auf Werthaltigkeit getestet. Die Bewertung erfolgt auf Basis von zahlungsmittelgenerierenden Einheiten, die in den vorliegenden Fällen den rechtlichen Einheiten entsprechen, denen der jeweilige Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist. In 2007 wurden Werthaltigkeitstests durchgeführt, aus denen sich kein Wertminderungsbedarf ergab.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Entwicklungsprojekte	8.250.627	7.738.958
Software und Lizenzen	19.790.500	20.945.053
Geleistete Anzahlungen und in der Entwicklung befindliche Projekte	7.183.038	3.635.053
	35.224.165	32.319.064

Entwicklungsprojekte

In 2007 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Produkt-Entwicklungen in Höhe von 3.211.607 Euro (2006: 2.692.363 Euro) aktiviert. Die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungen betragen in 2007 2.087.063 Euro (2006: 1.737.644 Euro). Der Buchwert der aktivierten Entwicklungsleistungen (einschließlich der in der Entwicklung befindlichen Projekte) beträgt zum 31. Dezember 2007 9.118.381 Euro (2006: 7.993.837 Euro).

Software und Lizenzen

In 2007 wurden Aufwendungen für Prozesstechnologie in Höhe von 2.581.761 Euro (2006: 2.119.337 Euro) aktiviert. Die Abschreibungen betragen in 2007 420.713 Euro (2006: 420.713 Euro). Bis zum 31. Dezember 2007 beliefen sich die aktivierten Buchwerte für als Gegenstände des Anlagevermögens aktivierte Prozesstechnologie auf 11.480.850 Euro, zum 31. Dezember 2006 beliefen sich diese auf 9.319.802 Euro.

Die Zugänge bei den Abschreibungen für Software und Lizenzen enthalten in Höhe von 158.761 Euro außerplanmäßigen Wertminderungsaufwand. Der Wertminderungsaufwand wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Vermögenswerte sind dem Segment Halbleiter zuzuordnen.

Sonstiges

Die Kosten, die mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte verbunden sind, sowie bedeutende Produktverbesserungen werden entsprechend ihres Anfalls in den Aufwand gebucht und sind in den Kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 3.532.515 Euro wurden von Kunden in 2007 erstattet (3.189.853 Euro in 2006).

Die Gesellschaft hat aus den Sonstigen Vermögenswerten 730 Tsd. Euro in die Immateriellen Vermögenswerte umgegliedert, um das Vermögen aus einer Zweckgesellschaft den Konzernbilanzierungsrichtlinien entsprechend darzustellen. Das Vorjahr wurde analog in

gleicher Höhe angepasst. Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie ergaben sich nicht.

14 Sachanlagen

Die Entwicklung der Sachanlagen ist im Konzern-Anlagenspiegel dargestellt.

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Grund und Boden	2.703.051	3.224.533
Gebäude und Einbauten	26.081.090	33.745.098
Technische Anlagen und Maschinen	49.637.180	55.067.685
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.562.831	4.252.184
	86.984.152	96.289.500

Der Abschreibungsaufwand belief sich im Geschäftsjahr 2007 auf 13.949.612 Euro (2006: 11.618.709 Euro).

Die Zugänge bei den Abschreibungen für technische Anlagen und Maschinen enthalten in Höhe von 226.705 Euro außerplanmäßigen Wertminderungsaufwand. Der Wertminderungsaufwand wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Vermögenswerte sind dem Segment Halbleiter zuzuordnen.

Im Geschäftsjahr 2007 und im Vorjahr wurden keine Fremdkapitalkosten aktiviert.

Die Gesellschaft hat aus den Sonstigen Vermögenswerten 733 Tsd. Euro in das Sachanlagevermögen umgegliedert, um das Vermögen aus einer Zweckgesellschaft den Konzernbilanzierungsrichtlinien entsprechend darzustellen. Das Vorjahr wurde analog in gleicher Höhe angepasst. Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie ergaben sich nicht.

Leasingverhältnisse

Am 11. Dezember 2007 hat die Gesellschaft diverse Betriebsvorrichtungen für einen Gesamtkaufpreis von 5.124.648 Euro an Exedra veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft diese Einbauten für einen Zeitraum von 5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrages mit Exedra ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von 1.064.946 Euro bis 2012 verpflichtet.

Zudem hat die Gesellschaft am 11. Dezember 2007 eine Zusatzvereinbarung zu einem bestehenden Finance-Lease-Vertrag mit Exedra geschlossen, in der die ursprüngliche Vereinbarung unter Berücksichtigung der Bilanzierungsgrundsätze nach IAS/IFRS in einen Operate-Lease-Vertrag umstrukturiert und um ein auf dem Grundstück des

Leasinggebers errichtetes Gebäude um 4.816.107 Euro ergänzt wurde. Die unter den bestehenden Vertrag zu subsumierenden Leasinggegenstände waren zuvor als Finanzierungsleasing klassifiziert und wurden dementsprechend im Anlagevermögen ausgewiesen. Durch Adaption der Vertragsmodalitäten wurde der Vertrag im Berichtsjahr auf Operating-Leasing umgestellt, damit werden die korrespondierenden Leasingverbindlichkeiten (22. Dezember 1997: 23.008.135 Euro, 28. Dezember 2007: 16.175.178 Euro) sowie die Leasinggegenstände nicht weiter bilanziell erfasst. Der aus dieser Transaktion resultierende Gewinn wurde in Höhe von 4.756 Tsd. Euro sofort vereinnahmt (Ausweis unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen) und in Höhe von 2.530 Tsd. Euro unter den Sonstigen Verbindlichkeiten als sog. deferred income ausgewiesen. Dessen Auflösung erfolgt über die Restlaufzeit von 13 Jahren bis 2020. Im Rahmen des neu verhandelten Mietvertrages ist die Gesellschaft zu Gesamtmietzahlungen in Höhe von 30.871.320 Euro bis 2020 verpflichtet.

Am 8. November 2001 hat die Gesellschaft ein weiteres Geschäftsgebäude und das dazugehörige Parkhaus (einschließlich Grundstück und Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von 11.643.000 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten sowie das Grundstück, die Gebäude und das Parkhaus für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen, degressiv fallenden Gesamtmietzahlungen, beginnend mit einer Höhe von 1.016.125 Euro bis 2021 verpflichtet. In 2003 erfolgte die Fertigstellung der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 3.351.519 Euro. Die zu zahlenden Leasingraten betragen 303.000 Euro p.a. bis 2011. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Anpassung der noch ausstehenden Leasingraten bis 2021 an die in 2011 gegebenen Kapitalmarktverhältnisse. Die Transaktion wurde als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen bilanziert werden.

Der Buchwert der geleaste Anlagegüter setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Geleaste Anlagegüter	27.677.758	48.013.030
Kumulierte Abschreibung	- 17.401.032	- 25.991.428
	10.276.726	22.021.602

Die Abschreibung erfolgt über die Vertragslaufzeit bzw. über die längere Nutzungsdauer gemäß IAS 17.28, ist im Abschreibungsaufwand enthalten und beträgt für das Jahr 2007 2.856.171 Euro (2006: 2.041.809 Euro). Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen werden von der Gesellschaft als kurz- bzw. langfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Kurzfristiger Anteil (Fälligkeit innerhalb 1 Jahr)	1.035.478	3.432.057
Langfristiger Anteil (Fälligkeit > 1 Jahr)	10.861.624	27.528.059
	11.897.102	30.960.116

Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Summe der künftigen Mindestleasingzahlungen zum Bilanzstichtag zu deren Barwert:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Innerhalb eines Jahres	1.548.857	4.756.033
Zwischen einem Jahr und fünf Jahren	5.328.878	13.417.288
Später als fünf Jahre	8.229.533	21.068.127
	15.107.268	39.241.448
Zukünftige Zinsanteile der Finanzierungsleasingverträge	3.210.165	8.281.332
Barwert der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasingverträgen	11.897.102	30.960.116

15 At-Equity bewertete Beteiligungen sowie Wertpapiere und Anteile

Die Gesellschaft ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
attoSensor	1	1
ELMOS Industries	0	1
Exedra	0	26.434
Epigone	20.824	20.824
IndustrieAlpine	0	25.788
Advanced Appliances Chips	34.000	34.000
ELMOS USA Inc.	19.107	19.107
	73.933	126.156

attoSensor GmbH, Penzberg

ELMOS hält zum 31. Dezember 2007 45% der Anteile. Die Gesellschaft ist mit einem Stammkapital von 40.000 Euro ausgestattet.

ELMOS Industries GmbH, Hanau

Zum 31. Dezember 2007 hielt die Gesellschaft 49% der Anteile an ELMOS Industries. Das Unternehmen wurde in 2007 erstmalig in den Kon-

zernabschluss einbezogen. Die Einbeziehung erfolgte trotz fehlender Mehrheit der Stimmrechte aufgrund der Tatsache, dass ELMOS wirtschaftliche Kontrolle über die operative Geschäftstätigkeit der Beteiligungsgesellschaft und deren übrigen Gesellschafter innehat. Der Kaufpreis für die Anteile im August 2006 betrug 49 Tsd. Euro. Dessen Aufbringung erfolgte im Rahmen einer Bargründung der Gesellschaft.

Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz und Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz

Die Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz wurde nicht mit in den Konsolidierungskreis aufgenommen, weil ELMOS nicht die Mehrheit der Stimmrechte gehört.

Es handelt sich bei diesem Unternehmen um eine Einheit, die lediglich für Zwecke der Abwicklung der Sale-and-Lease-back Konstruktionen gegründet worden ist und die Vermietung der von der ELMOS veräußerten Verwaltungsgebäude und dazugehörigen Grundstücke (inkl. Parkhaus) an ELMOS übernimmt. Die entsprechenden Vermögenswerte und Finanzierungsverbindlichkeiten sind in der Konzernbilanz bilanziert.

Die Anteile an der Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz wurden im Geschäftsjahr im Rahmen der Umstellung des Finance-Lease-Vertrages auf Operate-Leasing veräußert.

ELMOS USA Inc., Farmington Hills, USA

Bei dieser Gesellschaft handelt es sich um die Holdinggesellschaft für die US-amerikanischen Tochtergesellschaften. Sie übt keine eigene selbstständige Geschäftstätigkeit aus.

Zusammengefasste Finanzinformationen

Assoziierte Unternehmen	Bilanzsumme Tsd. Euro	Gesamt- betrag der Schulden Tsd. Euro	Erträge Tsd. Euro	Perioden- ergebnis Tsd. Euro
attoSensor ¹	423	363	816	7
Epigone ¹	12.632	12.601	503	6
Advanced Appliances Chips ¹	503	232	801	185
ELMOS USA Inc. ²	–	–	–	–

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31.12.2007.

² Es liegen derzeit keine Abschlüsse der Gesellschaften vor.

16 Latente Steueransprüche

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Aktive latente Steuern		
Sachanlagevermögen	– 108.316	– 128.914
Geschäfts- oder Firmenwert	5.455.379	6.234.495
Verlustvortrag	2.736.621	1.785.878
Sonstige/Währungsdifferenzen	22.255	264.540
	8.105.939	8.155.999
Passive latente Steuern		
Immaterielle Vermögenswerte	– 5.246.286	– 5.313.373
Sachanlagevermögen	– 5.933.848	– 1.878.105
Finanzierungsleasing	3.690.076	3.051.795
Pensionsrückstellungen	295.066	303.602
Verlustvortrag	1.879.010	0
Sonstige/Währungsdifferenzen	740.573	– 190.688
	– 4.575.409	– 4.026.769
Aktive latente Steuern, netto	3.530.530	4.129.230

In 2007 erfolgte erstmals eine Bruttodarstellung der aktiven und passiven latenten Steueransprüche in der Bilanz. Dementsprechend wurde eine Korrektur der Darstellung für das Vorjahr vorgenommen. Innerhalb der Positionen wurden Saldierungen gemäß IAS 12.74 a) und b) vorgenommen, d.h. aktive und passive latente Steuern wurden miteinander saldiert, wenn sie zur selben steuerlichen Einheit gehören und diese steuerliche Einheit das Recht hat, tatsächliche Steueransprüche mit Steuerschulden aufzurechnen. Die Bruttodarstellung führte im Vorjahr zu einer Verlängerung der Bilanzsumme um 3.430 Tsd. Euro. Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie ergaben sich nicht. Die Gesellschaft hat sich darüber hinaus in 2007 entschlossen, latente Steuern auf Differenzen aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse in die Konzern-Berichtswährung nicht mehr zu bilden. Die Auswirkung auf die Bilanz des Vorjahres betrug 596 Tsd. Euro und führte zu einer Verminderung der aktiven latenten Steuern und einer Verminderung der im Eigenkapital gezeigten erfolgsneutralen Veränderungen. Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie ergaben sich nicht.

Die Summe der temporären Differenzen im Zusammenhang mit Anteilen an Tochterunternehmen und assoziierten Unternehmen, für die keine latenten Steuerschulden bilanziert wurden, beträgt 909 Tsd. Euro.

Die Aktivierung latenter Steueransprüche auf Verlustvorträge erfolgte auf Basis der mittelfristigen Unternehmensplanungen der betroffenen Gesellschaften. Aktiviert wurden Verlustvorträge auf die Organisation in den USA (sog. Tax consolidation) in Höhe von 2.737 Tsd. Euro, die im Rahmen von Umstrukturierungen 2008 nutzbar gemacht werden. Die Verlustvorträge unterliegen keiner Verfallbarkeit. Für weitere Verlustvorträge und aktive temporäre Differenzen in Höhe von 3.754 Tsd. Euro wurden auf Basis der vorliegenden Planungen der amerikanischen Gesellschaften keine aktiven latenten Steuern gebildet. Die innerhalb der passiven latenten Steuern enthaltenen latenten Steuern auf Verlustvorträge beziehen sich auf die Muttergesellschaft.

17 Vorratsvermögen

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2007	31.12.2006
	Euro	Euro
Rohstoffe	8.126.138	9.477.183
Unfertige Erzeugnisse	18.762.550	17.735.397
Fertige Erzeugnisse und Waren	6.725.239	3.929.655
	33.613.927	31.142.235

Die Wertminderung von Vorräten, die als Aufwand erfasst worden ist, beläuft sich auf 1.408 Tsd. Euro (2006: 0 Tsd. Euro). Dieser Aufwand wird unter den Positionen Umsatzkosten (554 Tsd. Euro), Entwicklungskosten (800 Tsd. Euro) und sonstige betriebliche Aufwendungen (54 Tsd. Euro) ausgewiesen.

18 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2007	31.12.2006
	Euro	Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.944.222	28.006.064
Wertberichtigungen	– 537.957	– 231.663
	28.406.265	27.774.401

Die Gesellschaft bewertet laufend die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden und verlangt in der Regel keine Sicherheiten. Die Gesellschaft hat Wertberichtigungen auf mögliche Forderungsausfälle vorgenommen. Derartige Forderungsausfälle entsprachen den Schätzungen und Annahmen des Vorstandes und bewegen sich im geschäftlichen Umfang.

Nachfolgend sind die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand an kurz- und langfristigen Forderungen dargestellt:

	2007	2006
	Euro	Euro
Wertberichtigungen am 1. Januar	231.663	337.861
Zuführungen im Berichtszeitraum (Aufwand für Wertberichtigungen)	395.396	79.400
Verbrauch	– 55.368	0
Auflösungen (Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen)	– 28.527	– 210.361
Währungsumrechnungseffekte	– 5.208	24.763
Wertberichtigungen am 31. Dezember	537.957	231.663

Die Wertminderungen von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden größtenteils auf Wertberichtigungskonten erfasst. Die Entscheidung, ob ein Ausfallrisiko mittels eines Wertberichtigungskontos oder über eine direkte Minderung der Forderung berücksichtigt wird, hängt davon ab, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Forderungsausfalls geschätzt wird. Wenn Forderungen als uneinbringlich eingestuft werden, wird der entsprechende wertgeminderte Vermögenswert ausgebucht.

Die folgende Tabelle gibt Informationen für das in den finanziellen Vermögenswerten und Leistungen enthaltene Kreditrisiko.

Euro	Buchwert	Davon: Zum Abschlussstichtag weder wertgemindert noch überfällig	Davon: Zum Abschlussstichtag nicht wertgemindert und in den folgenden Zeitbändern überfällig					
			Weniger als 30 Tage	Zwischen 30 und 60 Tagen	Zwischen 61 und 90 Tagen	Zwischen 91 und 180 Tagen	Zwischen 181 und 360 Tagen	Mehr als 360 Tage
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2007	21.374.473	6.403.248	86.691	287.855	109.884	296.987	8.998
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	31.12.2007	1.392.280	888	884	881	2.571	5.146	31.347
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2006	20.411.858	5.583.076	599.594	1.037.438	202.135	131.501	4.500
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	31.12.2006	4.657.234	845	842	838	2.487	4.903	19.138

19 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Gesellschaft behandelt alle Kapitalanlagen mit hoher Fungibilität mit einer Fälligkeit von bis zu drei Monaten zum Zeitpunkt des Erwerbs als Barvermögen.

Für den Zweck des Konzernabschlusses umfassen die Zahlungsmittel Kassenbestände und Bankguthaben.

20 Sonstige Vermögenswerte und Ertragsteueransprüche

Die sonstigen Vermögenswerte zum Bilanzstichtag belaufen sich auf 6.550.185 Euro (2006: 12.122.346 Euro) und umfassen im Wesentlichen Steuererstattungsansprüche, kurzfristige Ausleihungen und verschiedene kurzfristige Forderungen.

21 Vermögenswerte einer Veräußerungsgruppe, die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert wird

Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte setzen sich aus IT-Zubehör sowie diversen technischen Anlagen und Maschinen zusammen. Mit einer Veräußerung dieser Vermögenswerte wird in 2008 gerechnet.

Ein wesentlicher Abgang bei den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten resultierte aus den Sale-and-Lease-back-Transaktionen mit der Exedra (siehe Anhangsangabe 14). Im Geschäftsjahr 2007 veräußerte die Gesellschaft diverse Betriebsvorrichtungen zu einem Verkaufspreis in Höhe von 5.124.648 Euro sowie ein errichtetes Gebäude zu einem Verkaufspreis in Höhe von 4.816.107 Euro. Die Verkaufspreise entsprachen den Restbuchwerten.

Weiterhin sind das im Vorjahr noch unter dieser Position ausgewiesene parzellierte Grundstück in München sowie die darauf errichteten Gebäude abgegangen.

Zudem gab es im laufenden Geschäftsjahr eine Umbuchung diverser technischer Anlagen und Maschinen aus den zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten in das Anlagevermögen. Die Gesellschaft beabsichtigte zunächst, die zum Gesamtbuchwert in Höhe von 534.312 Euro ausgewiesenen Vermögenswerte weiter zu veräußern. Im Geschäftsjahr 2007 änderte die Gesellschaft diese Absicht, da eine eigene Nutzung der Vermögenswerte vorteilhafter erschien. Die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Ertragslage beschränken sich auf die ab diesem Zeitpunkt zu berücksichtigenden Abschreibungen, wobei die wertmäßig größte Anlage in die Anlagen im Bau umgebucht wurde und demnach noch nicht abgeschrieben wird.

Die zuvor benannten Vermögenswerte sind jeweils dem Segment Halbleiter zuzuordnen.

22 Eigenkapital Grundkapital

Das in der Bilanz zum 31. Dezember 2007 aus 19.414.205 (2006: 19.413.805) auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien bestehende Grundkapital in Höhe von 19.414.205 Euro (2006: 19.413.805 Euro) ist voll eingezahlt.

Die Entwicklung der im Umlauf befindlichen Anteile stellt sich wie folgt dar:

Anteile zum 1. Januar 2007	19.413.805
Ausgabe von Aktien aus ausgeübtem Optionsrecht	400
Anteile zum 31. Dezember 2007	19.414.205

Ein Mitarbeiter hat im Jahr 2007 vom Optionsrecht zum Aktienwerb Gebrauch gemacht, was zur Ausgabe von 400 nennwertlosen Stückaktien mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, die auf den Inhaber lauten, geführt hat.

Die Beteiligungsverhältnisse stellen sich zum 31. Dezember 2007 wie folgt dar:

	Euro	%
EFH ELMOS Finanzholding GmbH	1.485.789	7,6
Markos GmbH	3.236.584	16,7
Dr. Weyer GmbH	3.236.584	16,7
ZOE-BTG GmbH	2.306.833	11,9
Streubesitz	9.148.415	47,1
	19.414.205	100,0

Genehmigtes und bedingtes Kapital

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18. Mai 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu 9.650.000 Euro durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 9.650.000 Stück neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).

Das Grundkapital ist um 885.795 Euro eingeteilt in 885.795 nennwertlose Stückaktien, die auf den Inhaber lauten, mit einem auf die einzelne Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 Euro, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Führungsorgane und an Mitarbeiter verbundener Unternehmen.

Das Grundkapital ist um maximal bis zu 5.000.000 Euro eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital II).

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu nominal 930.000 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durch Ausgabe von bis zu 930.000 neuen Stückaktien ohne Nennwert mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe der Aktien und nur zur Einlösung von Bezugsrechten durchgeführt, die im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 der ELMOS Semiconductor AG in dem Zeitraum vom 1. Oktober 2004 bis zum 26. April 2009 gewährt werden.

Kapitalrücklage

Die Zusammensetzung der Kapitalrücklage ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Aufgelder	84.784.588	84.781.840
Aktienoptionen	3.951.975	3.951.975
	88.736.563	88.733.815

Die Kapitalrücklage enthält Aufgelder aus Kapitalerhöhungen und der Ausgabe von Aktien der ELMOS Semiconductor AG. Darüber hinaus wird hier der Aufwand aus der Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiter gegen gebucht.

Übriges Eigenkapital

Direkt im Eigenkapital werden Effekte aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften erfasst.

Die kumulierten erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Fremdwährungsanpassungen	- 6.882.829	- 6.063.420
Latente Steuern (auf Fremdwährungsanpassungen gesondert)	475.532	475.532
Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals	- 6.407.297	- 5.587.888

23 Aktienbasierte Vergütungsprogramme

Aktienoptionsprogramm

Die Gesellschaft hat ein Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ziel dieses Programms ist es, den Erfolg des Unternehmens dadurch zu sichern, dass die Mitarbeiter Aktien der Gesellschaft erwerben können. Im Rahmen des Programms ist die Gesellschaft zur Gewährung von 1.000.000 neuen Stückaktien (bedingtes Kapital I), wovon bereits 114.205 Aktienoptionen ausgeübt worden sind, bzw. 930.000 (bedingtes Kapital III) neuen Stückaktien berechtigt.

Der Ausübungspreis entspricht für die erste bis vierte Tranche 120% und für die fünfte Tranche 110% des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an den zehn Handelstagen vor dem Vorstandsbeschluss über die Ausgabe und die Festlegung der Einzelheiten der jeweiligen Tranche. Die Optionen können nur ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. Die Bezugsrechte können gegen Zahlung des Ausgabepreises ausgeübt werden.

Die Optionen können bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit drei Jahre bzw. zwei Jahre nach ihrer Gewährung ausgeübt werden und erlöschen nach sechs bzw. fünf Jahren.

Die erste Tranche an Aktienoptionen ist in 2006, die zweite Tranche in 2007 ausgelaufen. In 2007 wurden aus der dritten Tranche 400 Optionen ausgeübt (2006: 1.381). Der durchschnittliche Aktienkurs am Tag der Ausübung betrug 8,84 Euro. Zum 31. Dezember 2007 stehen

insgesamt 582.380 Optionen aus. Diese teilen sich wie folgt auf die Tranchen auf:

Nr.	Beschluss-jahr	Ausgabe-jahr	Ausübungs-kurs in Euro	Sperrfrist ab Ausgabe (Jahre)	Ausübungs-zeitraum nach Sperrfrist (Jahre)	Ausstehende Optionen per 31.12.2006 (Anzahl)	2007 ausgeübt (Anzahl)	2007 verfallen (Anzahl)	Ausstehende Optionen per 31.12.2007 (Anzahl)
2	2000	2001	35,14	3	3	124.100	0	124.100	0
3	2002	2003	7,87	2	3	164.836	400	2.150	162.286
4	2003	2004	11,59	2	3	274.622	0	3.800	270.822
5	2004	2005	13,98	2	3	151.643	0	2.371	149.272
						715.201	400	132.421	582.380

Die Bewertung der Aktienoptionen erfolgte entsprechend den Bestimmungen des IFRS 2 für „equity-settled share-based payment transactions“ zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2007 unter Zuhilfenahme der Black-Scholes-Methode.

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug 14,23 Euro für die erste und zweite Tranche, 4,40 Euro für die dritte Tranche, 5,07 Euro für die vierte Tranche und 6,06 Euro für die fünfte Tranche. Der beizulegende Wert am Tag der Gewährung wurde unter Anwendung der Black-Scholes-Methode zur Optionspreisberechnung auf Grundlage der folgenden Annahmen ermittelt:

Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Werts

	Tranche 2	Tranche 3	Tranche 4	Tranche 5
Dividendenertrag	1,4%	2,0%	2,0%	1,5%
Erwartete Volatilität	61,7	59,1	59,1	85,0
Risikoloser Zinssatz zum Gewährungszeitpunkt	6,0%	5,5%	5,5%	2,76%
Erwartete Laufzeit in Jahren	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Im Geschäftsjahr 2007 sind der Gesellschaft Aufwendungen in Höhe von 0 Euro (2006: 453.611 Euro) für das Aktienoptionsprogramm entstanden.

Gratisaktienprogramm (Stock Awards)

Im Jahr 2007 wurde erstmalig ein Gratisaktien-Programm (Stock Awards) aufgelegt. Die Stock Awards wurden an besonders verdiente Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstandes in Anerkennung für die im Vorjahr erbrachte Leistung vergeben. Die Gewährung dieser Awards soll zum einen die Verbundenheit von ELMOS mit ihren Leistungsträgern zeigen und zum anderen als Motivation für das Engagement und die Leistungsbereitschaft verstanden werden.

Das Stock Award Programm 2007 umfasste 29.000 Aktien, die zuvor an der Börse im Rahmen der Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien zurückerworben wurden. Die Aktien wurden zwischen dem 16. und 23.

August 2007 zum durchschnittlichen Preis von 7,23 Euro je Aktie zuzüglich Provision erworben und bis zum 31. Dezember 2007 vollständig an die Mitarbeiter, Führungskräfte und Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Entsprechender Personalaufwand in Höhe von 212.332 Euro wurde auf die Funktionsbereiche Produktion (70.507 Euro), Entwicklung (32.020 Euro), Vertrieb (43.959 Euro) sowie Verwaltung (65.846 Euro) verteilt. Für die Stock Awards gilt eine Haltefrist von zwei Jahren; davon ausgenommen ist ein Verkauf von Aktien in der erforderlichen Anzahl, so dass die Steuern, die auf den geldwerten Vorteil entstehen, beglichen werden können. ELMOS plant auch für die kommenden Jahren ein ähnliches Stock Award Programm.

24 Rückstellungen

Kurzfristige Rückstellungen

	1.1.2007 Euro	Verbrauch Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	31.12.2007 Euro
Urlaubsrückstellung	1.157.339	1.157.339	0	1.122.293	1.122.293
Tantiemerückstellung	772.512	765.960	0	667.939	674.491
Berufsgenossenschaft	267.200	265.442	1.758	313.800	313.800
Garantieleistung	1.559.974	1.410.141	0	1.612.867	1.762.700
Lizenzen	462.567	414.166	0	505.292	553.693
Sonstige Rückstellungen	903.389	609.638	0	1.389.808	1.683.559
	5.122.981	4.622.686	1.758	5.611.999	6.110.536

Die Garantierückstellung wurde sowohl allgemein auf Basis der Umsatzerlöse als auch für spezielle Tatbestände im abgelaufenen Geschäftsjahr gebildet.

Die Rückstellung für Lizenzen beinhaltet die Zahlungsverpflichtung an die internen und externen Erfinder. Die Grundlage für die Berechnung der Rückstellung bilden die bestehenden Vergütungsverträge.

Langfristige Rückstellungen / Pensionsrückstellungen

Die Entwicklung der bilanzierten Nettoschuld stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Barwert der Verpflichtung	2.916.788	3.229.159
Zeitwert Rückdeckungsversicherung	- 2.036.152	- 1.923.742
Nicht erfasste versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	230.578	- 162.780
In der Bilanz erfasste Schuld	1.111.214	1.142.637

Die Gesellschaft unterhält eine betriebliche Altersversorgung für Mitglieder des Vorstandes der ELMOS Semiconductor AG und für Mitglieder der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften. Die Vergütung richtet sich gemäß den Pensionsplänen nach dem Arbeitsentgelt während der aktiven Tätigkeit.

Von der Gesellschaft wurden Rückdeckungsversicherungen für die Pensionszusagen abgeschlossen, deren Ansprüche an die Anspruchsberechtigten abgetreten wurden.

Während der Laufzeit der Renten werden diese mit 1,5% p.a. angepasst. Die erwarteten Gehaltssteigerungen werden mit 0,0% angesetzt.

Die Ermittlung der Teilwerte erfolgt nach IAS 19. Der Rechnungszinsfuß beträgt im Geschäftsjahr 5,6% p.a. Als versicherungsmathematische Annahmen für das Sterbe- und Berufsunfähigkeitsrisiko wurden die Heubeck-Richttafeln 2005 G verwendet.

Die Pensionsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Dienstzeitaufwand	49.666	84.068
Zinsen	160.597	126.526
Pensionsaufwand (netto)	210.263	210.594

Die Änderungen des Barwerts der leistungsorientierten Verpflichtungen stellen sich wie folgt dar:

	2007 Euro	2006 Euro
Pensionsverpflichtung zum 1.1.	3.229.159	3.006.721
Pensionsaufwand	210.263	210.594
Leistungen an Rentner	- 79.261	- 79.262
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	- 443.373	27.168
Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand	0	63.938
Pensionsverpflichtung zum 31.12.	2.916.788	3.229.159

	2007 Euro	2006 Euro
Zeitwert Rückdeckungsversicherung	2.036.152	1.923.742

Die in der laufenden Periode erfassten versicherungsmathematischen Gewinne betragen in 2007 50 Tsd. Euro (in 2006 Verluste in Höhe von 3 Tsd. Euro).

Die Erträge aus der Rückdeckungsversicherung betragen 110.137 Euro (2006: 174.337 Euro) inklusive der Leistungen aus der Auszahlung im Todesfall. Beiträge werden in Höhe 318.042 Euro (2006: 290.681 Euro) gezahlt.

Des Weiteren bestehen für Mitglieder des Vorstandes der EL MOS Semiconductor AG mittelbare Pensionszusagen, für die aufgrund des Umfangs der Zusage und der vollständig kongruenten Rückdeckung durch eine Rückdeckungsversicherung nach IAS 19.104D keine Pensionsrückstellung zu bilden ist. In 2007 betragen die Beiträge für diese Pensionspläne 431.743 Euro (2006: 341.048 Euro).

Die für Arbeitnehmer erfolgten Rentenbeiträge des Arbeitgebers zur Sozialversicherung in 2007 betragen 3.868.617 Euro (2006: 3.339.327 Euro). Die Beiträge zu Direktversicherungen für Arbeitnehmer betragen in 2007 12.000 Euro.

Beträge der laufenden und der vorangegangenen drei Berichtsperioden stellen sich wie folgt dar:

	2007 Euro	2006 Euro	2005 Euro	2004 Euro
Pensionsverpflichtung	2.916.788	3.229.159	3.006.721	2.649.311
Zeitwert Rückdeckungsversicherung	- 2.036.152	- 1.923.742	- 1.749.405	- 1.110.719
Unterdeckung (-)	- 880.636	- 1.305.417	- 1.257.316	- 1.538.592
Erfahrungsbedingte Anpassungen der Planschulden	- 12.878	124.078	173.540	41.738
Erfahrungsbedingte Anpassungen des Planvermögens	0	0	0	0

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der IFRS im Jahr 2004 wurde auf die gemäß IAS 19.120A (p) vorgesehene Angabe für die Berichtsperiode 2003 verzichtet.

25 Finanzverbindlichkeiten

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich zum 31. Dezember 2007 wie folgt zusammen:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Sparkasse Frankfurt/Oder, Darlehen		
Jahreszinssatz	4,99%	
Effektiver Zinssatz	5,63%	
Zahlung	Monatlich	
Zinsen	8.779 Euro	
Fälligkeit	Januar 2011	173.560
Sparkasse Frankfurt/Oder, Darlehen		
Jahreszinssatz	5,399%	
Effektiver Zinssatz	5,98%	
Zahlung	Monatlich	
Zinsen	28.175 Euro	
Fälligkeit	März 2012	189.546
BMW Bank GmbH, Darlehen		
Jahreszinssatz	5,12%	
Effektiver Zinssatz	6,49%	
Zahlung	Monatlich	
Zinsen	1.370 Euro	
Fälligkeit	Oktober 2007	0
Sparkasse Frankfurt/Oder, Darlehen		
Jahreszinssatz	5,65%	
Effektiver Zinssatz	5,80%	
Zahlung	Monatlich	
Zinsen	37.171 Euro	
Fälligkeit	September 2016	590.249
Dortmunder Volksbank, Darlehen		
Jahreszinssatz	5,50%	
Effektiver Zinssatz	5,69%	
Zahlung	Monatlich	
Zinsen	46.250 Euro	
Fälligkeit	Juni 2013	10.000.000
Sparkasse Dortmund, Darlehen		
Jahreszinssatz	5,38%	
Effektiver Zinssatz	5,49%	
Zahlung	Vierteljährlich	
Zinsen	269.000 Euro	
Fälligkeit	Juli 2013	20.000.000
Deutsche Bank AG, Schuldscheindarlehen		
Jahreszinssatz	5,63%	
Effektiver Zinssatz	5,96%	
Zahlung	Vierteljährlich	
Zinsen	269.000 Euro	
Fälligkeit	Juli 2013	10.000.000
Finanzierungsleasing	11.897.102	30.960.116
Gesamt	52.850.456	31.928.749
Abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	1.228.175	3.643.766
	51.622.281	28.284.983

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

Zum 31. Dezember 2007 standen der Gesellschaft verschiedene kurzfristige Kreditrahmen in Höhe von 50.369.065 Euro zur Verfügung. Per 31. Dezember 2007 hat die Gesellschaft diese Kreditfazilitäten in Höhe von 36.084 Euro mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 6,5% in Anspruch genommen. Bei den kurzfristigen Bankverbindlichkeiten handelt es sich des Weiteren im Wesentlichen um unterwegs befindliche Schecks in Höhe von 1.078.750 Euro, die zum Stichtag noch nicht eingelöst waren.

Des Weiteren wird unter den kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten der Anteil der langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr ausgewiesen.

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	1.307.531	33.280.699
Kurzfristiger Anteil der Leasingverbindlichkeiten	1.035.478	3.432.057
	2.343.009	36.712.756

Die folgende Tabelle zeigt alle bis zum 31. Dezember 2007 bzw. 31. Dezember 2006 vertraglich fixierten Zahlungen für Tilgungen, Rückzahlungen und Zinsen aus bilanzierten finanziellen Verbindlichkeiten. Diese werden mit den undiskontierten Zahlungsströmen inkl. Zinszahlungen für die nächsten Geschäftsjahre angegeben. Einbezogen sind auch alle Zahlungsströme aus derivativen Finanzinstrumenten mit positivem und negativem beizulegenden Zeitwert.

31. Dezember 2007	2008 Tsd. Euro	2009 Tsd. Euro	2010-2012 Tsd. Euro	ab 2013 Tsd. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.987.834	1.819.000	5.286.000	31.232.617
Übrige Finanzschulden	563.000	563.000	11.626.444	0
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	1.548.857	1.332.219	3.996.658	8.229.534
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.589.724	0	0	0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	2.680.791	0	0	0

31. Dezember 2006	2007 Tsd. Euro	2008 Tsd. Euro	2009-2011 Tsd. Euro	ab 2012 Tsd. Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.087.297	141.000	390.000	413.000
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	4.756.033	3.486.384	9.930.904	21.068.127
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.731.543	0	0	0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	1.030.433	146.084	0	0

Der Darstellung der Liquiditätsanalyse liegen folgende Annahmen zugrunde: bei variabel verzinslichen Finanzinstrumenten erfolgt die Aufstellung der zukünftigen Zinszahlungen auf Basis des aktuellen Fixings. Fremdwährungsbeträge wurden zum aktuellen Stichtagskurs umgerechnet, der resultierende Betrag wurde für die Ermittlung der zukünftigen Zahlungen verwendet.

26 Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

Die übrigen Verbindlichkeiten enthalten zum Stichtag:

	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
Steuerverbindlichkeiten	1.879.590	280.169
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	4.594.667	4.428.490
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	2.533.246	354.307
	9.007.503	5.062.966

Die Steuerverbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Ertragsteuerverbindlichkeiten ausländischer Tochtergesellschaften. Bei den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten handelt es sich u.a. um Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer und aus noch abzuführenden Sozialversicherungsbeiträgen.

Weiter wurde in Zusammenhang mit dem neu abgeschlossenen Leasingvertrag mit Exedra die Differenz zwischen der aufgelösten Finanzierungsleasingverbindlichkeit und dem ermittelten Verkehrswert der Leasinggegenstände unter den sonstigen langfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Betrag wird rätierlich über die Laufzeit des zugrunde liegenden Vertrages abgegrenzt.

27 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen hauptsächlich den Bezug von Sachmitteln zum Unterhalt der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in voller Höhe innerhalb eines Jahres fällig.

28 Marktwert von Finanzinstrumenten

Der Buchwert von Finanzinstrumenten, wie Forderungen und Verbindlichkeiten, entspricht aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Finanzinstrumente im Wesentlichen dem Marktwert.

Der Buchwert von Verbindlichkeiten gegenüber Banken entspricht im Wesentlichen dem Marktwert, basierend auf den für dieselben oder vergleichbare Belegungen angesetzten Marktpreisen, sowie auf den der Gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen.

Die Gesellschaft beobachtet die Wertentwicklung der Verbindlichkeiten mit festen und variablen Zinssätzen sowie der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Überprüfung der Geschäfts- und sonstigen Finanzrisiken.

Zur Absicherung gegen Zinssatzschwankungen aus kurzfristig revolvingierenden Verbindlichkeiten mit variablen Zinssätzen, hat die Gesellschaft eine Zinsswapvereinbarung über einen Basisbetrag von 20.000.000 Euro abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 5 Jahren und endet in 2008.

Der Zinsswap wurde im Konzernabschluss nicht als Hedging Instrument gemäß IAS 39 behandelt. Die Marktwertveränderungen des Zinsswapgeschäftes, die in 2006 und 2007 nicht signifikant waren, werden sofort erfolgswirksam erfasst und unter Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Marktwert des Zinsswaps, der auf Basis von offiziellen Preisangeboten ermittelt wurde, beträgt zum 31. Dezember 2007 0 Euro (31. Dezember 2006: 76 Euro).

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

Die Bewertung von Derivatgeschäften zur Absicherung erfolgt grundsätzlich auf Basis von aktuellen Preisangeboten. Falls eine Preisermittlung nicht möglich ist, erfolgt die Bewertung anhand entsprechender Bewertungsverfahren. Für derivative Finanzinstrumente entspricht der beizulegende Zeitwert dem Betrag, den ELMOS bei Beendigung des Finanzinstruments zum Abschlussstichtag entweder erhalten würde oder zahlen müsste. Dieser wird unter Anwendung der zum Abschlussstichtag relevanten Wechselkurse, Zinssätze und Bonitäten der Vertragspartner berechnet.

29 Zusätzliche Angaben zu den Finanzinstrumenten Buchwerte, Wertansätze und beizulegende Zeitwerte nach Bewertungskategorien

Die Gesellschaft hat sich bezüglich der Klassenbildung von Finanzinstrumenten an die Bewertungskategorien nach IAS 39 angelehnt, da die Risikoverteilung innerhalb dieser Bewertungskategorien ähnlich ist.

Die folgende Tabelle weist die Buchwerte jeder Kategorie von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus.

Euro	Kat.	Buchwert 31.12.2007	Wertansatz nach IAS 39			Wert- ansatz nach IAS 17	Fair Value 31.12.2007	Buchwert 31.12.2006	Wertansatz nach IAS 39			Wert- ansatz nach IAS 17	Fair Value 31.12.2006
			Fortge- führte An- schaffungs- kosten	An- schaffungs- kosten	Erfolgs- neutral/ -wirksam zum Markt- wert				Fortge- führte An- schaffungs- kosten	An- schaffungs- kosten	Erfolgs- neutral/ -wirksam zum Markt- wert		
Finanzielle Vermögenswerte													
Sonstige Beteiligungen	AfS	73.932		73.932		73.932	126.154		126.154				126.154
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	LaR	28.406.265	28.406.265			28.406.265	27.774.401	27.774.401					27.774.401
Zahlungsmittel und -äquivalente	LaR	42.855.617	42.855.617			42.855.617	16.634.086	16.634.086					16.634.086
Übrige finanzielle Vermögenswerte													
Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	LaR	905.511	905.511			905.511	937.750	937.750					937.750
Sonstige Ausleihungen	LaR	528.489	528.489			528.489	3.748.536	3.748.536					3.748.536
Summe finanzielle Vermögenswerte		72.769.814	72.695.882	73.932		72.769.814	49.220.927	49.094.773	126.154				49.220.927
Finanzielle Verbindlichkeiten													
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	OL	14.589.724	14.589.724			14.589.724	12.731.544	12.731.544					12.731.544
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	OL	32.068.188	32.068.188			32.044.501	34.037.623	34.037.623					34.009.222
Übrige Finanzschulden	OL	10.000.000	10.000.000			9.917.510	0						
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	N/A	11.897.102	11.897.102			11.897.102	10.327.958	30.960.116	30.960.116			30.960.116	29.278.840
Übrige finanzielle Verbindlichkeiten													
Derivate ohne Hedging-Beziehung	HfT	0		0		0	0	0		0			0
Sonstige übrige finanzielle Verbindlichkeiten	OL	2.680.791	2.680.791			2.680.791	1.176.517	1.176.517					1.176.517
Summe finanzielle Verbindlichkeiten		71.235.805	71.235.805			11.897.102	69.560.484	78.905.800	78.905.800			30.960.116	77.196.122
Aggregiert nach Bewertungskategorien													
Finanzierungsleasing (N/A)		11.897.102				11.897.102	10.327.958	30.960.116				30.960.116	29.278.840
Loans and receivables (LaR)		72.695.882	72.695.882			72.695.882	49.094.773	49.094.773					49.094.773
Available for Sale (AFS)		73.932		73.932		73.932	126.154		126.154				126.154
Held for Trading (HfT)													
Held to Maturity (HtM)													
Other Liabilities (OL)		59.338.703	59.338.703			59.232.526	47.945.684	47.945.684					47.917.283

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die folgende Tabelle stellt die in der Gewinn- und Verlustrechnung berücksichtigten Nettogewinne oder -verluste von Finanzinstrumenten dar.

	2007 Euro	2006 Euro
Loans and Receivables	871.373	234.550
Held for Trading	18.449	- 39.739
Other Liabilities	- 141.860	- 77.396

ELMOS erfasst Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die der Kategorie „Loans and Receivables“ zuzurechnen sind, unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Die Verluste aus der Währungsumrechnung von den der Bewertungskategorie „Loans and Receivables“ zugeordneten finanziellen Vermögenswerten resultieren überwiegend aus Lieferungen und Leistungen. Die Nettogewinne und -verluste enthalten Wertberichtigungen, Forderungsausfälle, Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen. Bei Held for Trading-Wertpapieren sind in den Nettogewinnen und -verlusten ebenfalls Kursgewinne und -verluste mit enthalten.

In das Ergebnis aus der Folgebewertung der Finanzinstrumente, die der Bewertungsklasse „Held for Trading“ zugeordnet sind, gehen sowohl Zins- als auch Währungseffekte ein.

Die der Kategorie „Other liabilities“ zuzuordnenden Aufwendungen resultieren aus den Währungsdifferenzen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Die Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Zinsergebnis ausgewiesen (siehe Anhangsangabe 8).

30 Finanzrisikomanagement und Finanzderivate

Grundlagen des Risikomanagements

Die ELMOS Semiconductor AG fasst die innerhalb des Unternehmens vorhandenen Maßnahmen zur Risikosteuerung in einem einheitlichen und durchgängigen Risikomanagementsystem zusammen. Das System sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Darüber hinaus berichten die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung bzw. -vermeidung oder -abwehr beschließen.

Das Risikomanagementsystem erfüllt die Anforderungen des §91 (2) AktG und wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches

und Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden, Entwicklungen, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, frühzeitig zu erkennen.

Im Berichtsjahr wurde das System weiterentwickelt, so dass der Fokus auf Risiken mit höchster Prioritätseinschätzung verstärkt ist. Auch zukünftig wird das Risikomanagementsystem kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

ELMOS unterliegt hinsichtlich ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, geplanten Transaktionen und bestehenden Verpflichtungen (firm commitments) insbesondere Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus der Veränderung der Wechselkurse und der Zinssätze. Ziel des finanziellen Risikomanagements ist es, diese Marktrisiken durch die laufenden operativen und finanzorientierten Aktivitäten zu begrenzen. Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei zeitweise Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kursicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkurschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS nutzt diese Sicherungsinstrumente nicht für spekulative Zwecke.

Die Grundzüge der Finanzpolitik werden jährlich vom Vorstand festgelegt und vom Aufsichtsrat überwacht. Die Umsetzung der Finanzpolitik sowie das laufende Risikomanagement obliegen dem Vorstand.

Kreditrisiko

Die liquiden Mittel umfassen im Wesentlichen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Im Zusammenhang mit der Anlage von liquiden Mitteln ist der Konzern Verlusten aus Kreditrisiken ausgesetzt, sofern Finanzinstitute ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. ELMOS steuert die daraus entstehende Risikoposition durch Diversifizierung der Kontrahenten. Die liquiden Mittel werden ausschließlich bei namhaften Adressen mit guter Bonität angelegt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entstehen hauptsächlich durch Verkaufsaktivitäten von mikroelektronischen Bauelementen und Systemteilen sowie von funktionsverwandten technologischen Einheiten. Die Kunden sind überwiegend Automobilzulieferer, zu einem kleineren Teil Unternehmen der Industrie- und Konsumgüterbranche. Die Außenstände werden zum Großteil zentral und fortlaufend überwacht. Ausfallrisiken werden mittels Einzelwertberichtigungen und pauschalisierten Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Die Vereinbarung der jeweiligen Zahlungsbedingungen spiegeln ebenso die historische Entwicklung mit den jeweiligen Kun-

den wider. Zusätzlich werden bei Neukunden Informationen zu deren Bonität eingeholt. Das Geschäft mit Großkunden unterliegt gesonderter Ausfallrisikoüberwachung. Das maximale Ausfallrisiko wird durch die Buchwerte der in der Bilanz angesetzten finanziellen Vermögenswerte wiedergegeben.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko von ELMOS besteht darin, dass die Gesellschaft möglicherweise ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, z.B. der Tilgung von Finanzschulden, der Bezahlung von Einkaufsverpflichtungen und den Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Damit sich dieses Risiko nicht realisiert und die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sowie die finanzielle Flexibilität der ELMOS sichergestellt ist, wird eine Liquiditätsreserve in Form von Barmitteln und Kreditlinien vorgehalten. Darüber hinaus wird die Liquidität des Konzerns laufend überwacht. Nähere Informationen über die bestehenden freien Kreditlinien befinden sich unter der Anhangsangabe 25.

Finanzmarktrisiken

ELMOS ist aufgrund ihrer internationalen Geschäftsaktivitäten Marktpreisrisiken aus Änderungen von Wechselkursen und Zinssätzen ausgesetzt. Diese Marktpreisrisiken können einen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns haben.

a) Wechselkursrisiko

Aufgrund der internationalen Ausrichtung sind das operative Geschäft sowie die berichteten Finanzergebnisse und die Zahlungsströme Risiken aus Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Diese bestehen vor allem zwischen dem US-Dollar und dem Euro.

Die Währungskursrisiken von ELMOS resultieren aus operativen Tätigkeiten, Investitionen und Finanzierungsmaßnahmen. Die einzelnen Konzernunternehmen wickeln ihre Aktivitäten überwiegend in ihrer jeweiligen funktionalen Währung ab. Deshalb wird das Währungskursrisiko von ELMOS aus der laufenden operativen Tätigkeit als gering eingeschätzt. Sofern operatives Geschäft in den einzelnen Konzerngesellschaften in Fremdwährungen durchgeführt wird, gleicht sich dies i.d.R. im Konzern aus. Des Weiteren werden Leistungen in US-Dollar bezogen, wie Assembly-Dienstleistungen aus Südostasien oder der Erwerb von Investitionsgütern, welche auf dem weltweiten Halbleitermarkt typischerweise in US-Dollar angeboten werden. Zudem bestehen konzerninterne Verbindungen, wie beispielsweise Darlehen in Fremdwährung, die zur Finanzierung an Konzerngesellschaften ausgereicht werden.

Neben dem sogenannten Natural Hedging, d.h. dass bestimmte US-Dollar Zahlungseingänge zeitnah entsprechenden -ausgängen

gegenüberstehen, werden in bestimmten Fällen auch Sicherungsgeschäfte durchgeführt. Fremdwährungsrisiken, die die Cash Flows des Konzerns nicht beeinflussen (d.h. Risiken, die aus der Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ausländischer Unternehmenseinheiten in die Konzern-Berichterstattungswährung resultieren), bleiben hingegen grundsätzlich ungesichert. ELMOS war am Abschlussstichtag aufgrund des geringen Ausmaßes keinen wesentlichen Währungsrisiken ausgesetzt.

Wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar zum 31. Dezember 2007 um 10% aufgewertet (abgewertet) gewesen wäre, wäre das operative Ergebnis um 579.778 Euro höher (708.548 Euro niedriger) (31. Dezember 2006: 330.357 Euro höher (403.782 Euro niedriger)) gewesen. Der Konzern-Eigenkapitaleffekt ergäbe sich in gleicher Höhe über die Ergebnisauswirkung.

b) Zinsänderungsrisiko

Das Zinsänderungsrisiko von ELMOS resultiert hauptsächlich aus Finanzschulden wie variabel verzinslichen Darlehen. ELMOS unterliegt Zinsrisiken hauptsächlich im Euroraum. Der Vorstand legt in regelmäßigen Abständen den Zielmix aus fest und variabel verzinslichen Verbindlichkeiten fest, darauf folgend wird die Finanzierungsstruktur umgesetzt. Gegebenenfalls werden zur Umsetzung auch Zinsderivate eingesetzt.

Wenn das Marktzinnsniveau zum 31. Dezember 2007 um 10 Basispunkte höher (niedriger) gewesen wäre, wäre das Ergebnis um 16.634 Euro (31. Dezember 2006: 73.356 Euro) geringer (höher) gewesen. Die hypothetische Ergebnisauswirkung ergibt sich aus den potenziellen Effekten aus originären, variabel verzinslichen Verbindlichkeiten. Der Konzern-Eigenkapitaleffekt ergäbe sich in gleicher Höhe über die Ergebnisauswirkung.

c) Sonstige Preisrisiken

Zum 31. Dezember 2007 (2006) besteht nach Ansicht der Gesellschaft kein wesentliches sonstiges Preisrisiko.

Kapitalsteuerung

Vorrangiges Ziel der Kapitalsteuerung des Konzerns ist es sicherzustellen, dass es zur Unterstützung seiner Geschäftstätigkeit und zur Maximierung des Shareholder Value ein hohes Bonitätsrating und eine gute Eigenkapitalquote aufrechterhält.

Der Konzern steuert seine Kapitalstruktur und nimmt Anpassungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern beispielsweise Dividenden an die Anteilseigner zahlen oder neue Anteile ausgeben. Zum 31. Dezember

2007 bzw. 31. Dezember 2006 wurden keine Änderungen der Ziele, Richtlinien und Verfahren vorgenommen.

Der Konzern überwacht sein Kapital mithilfe des Verschuldungsgrades, der dem Verhältnis von Netto-Verschuldung zu Eigenkapital entspricht (Gearing) sowie der absoluten Höhe der Nettoverschuldung und der Eigenkapitalquote. Die Netto-Verschuldung umfasst kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie Wertpapiere, ohne Berücksichtigung der aufgegebenen Geschäftsbereiche. Das Eigenkapital umfasst auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital abzüglich der nicht realisierten Gewinne. Die Eigenkapitalquote setzt das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme.

	2007	2006
Netto-Verschuldung	11,1 Mio. Euro	48,4 Mio. Euro
Verschuldungsgrad	6,9%	31,8%
Eigenkapitalquote	64,2%	62,1%

Sonstige Angaben

31 Fördermittel

Die Gesellschaft erhält Fördermittel der öffentlichen Hand, die zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie für den Erwerb von Grundbesitz und Anlagegegenständen verwendet werden. Fördermittel werden bis zum Investitionszeitpunkt als sonstige Verbindlichkeiten erfasst (643.942 Euro zum 31. Dezember 2007 und 0 Euro zum 31. Dezember 2006). Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendete Fördermittel wurden unter den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen aufwandsmindernd erfasst (298.157 Euro in 2007 und 362.586 Euro in 2006). Fördermittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 1.110.734 Euro wurden im aktuellen Jahr als Minderung der Anschaffungskosten erfasst.

32 Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Die Gesellschaft hat unkündbare Miet- und Leasingverträge für ein Betriebs- und Verwaltungsgebäude, ein Mitarbeiterzentrum, ein Parkhaus sowie für ein weiteres Bürogebäude abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2014, 2020, 2021, 2022 und 2030 erstrecken. Außerdem hat die Gesellschaft Leasingverträge für technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung abgeschlossen, deren Laufzeiten sich bis 2008 und vereinzelt bis 2011 erstrecken. Daneben bestehen Leasingverträge für den Fuhrpark, Büromaschinen und technische Anlagen und Maschinen in betriebsüblichem Umfang.

Die Gesellschaft hat in 2005 einen Vertrag über die Erbringung von Forschungs- und Entwicklungsleistungen sowie zur Nutzung einer Produktionslinie mit einer Laufzeit bis 2015 abgeschlossen.

Am 16. Dezember 2005 hat ELMOS ebenfalls einen Immobilienvertrag über ein Servicegebäude mit Kantine und Sozialflächen mit der LABRUM Grundstücks- und Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Eins KG, Düsseldorf für die Dauer von 9 Jahren abgeschlossen. Die jährliche Miete beträgt 518 Tsd. Euro. Die Miete erhöht sich kalenderjährlich um 1,0% p.a., erstmals zum 16. Dezember 2006. Für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann ELMOS die Verlängerung des Mietvertrages um weitere 5 Jahre verlangen.

Im Rahmen des neu verhandelten Mietvertrages mit Exedra ist ELMOS zu Gesamtmietzahlungen in Höhe von 30.871.320 Euro bis 2020 verpflichtet (siehe Anhangsangabe 14).

SMI hat am 26. Januar 2006 einen Immobilien-Leasingvertrag über ein Grundstück und dem darauf stehenden Betriebsgebäude mit McCarthy Manager LLC, Washington/USA abgeschlossen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Die monatliche Miete beträgt USD 60.000, wobei eine jährliche Anpassung an den U.S. Consumer Price Index vorgesehen ist. Für die Dauer des Mietverhältnisses ist der Vertrag unkündbar. Nach Ablauf der Mietzeit kann SMI die Verlängerung des Mietvertrages um weitere 10 Jahre verlangen.

Die Gesamtaufwendungen für die Miet- und Leasingverträge betragen 18.559.477 Euro in 2007 und 14.200.331 Euro in 2006. Zukünftige Mindestzahlungen aus unkündbaren Verträgen mit ursprünglichen Laufzeiten oder Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sind zum 31. Dezember 2007 wie folgt:

	Miet- und Leasingzahlungen ohne Finanzierungsleasing Euro
2008	22.164.937
2009	18.559.890
2010	17.347.505
2011	12.494.415
2012	10.775.351
Folgejahre	45.212.369
	126.554.467

Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte, die eine Tochtergesellschaft als Sicherheit für ein Bankdarlehen gestellt hat, beträgt 410 Tsd. Euro. Es handelt sich um erstrangige Grundschulden an einem Gebäudeobjekt. Zum Bilanzstichtag hat ELMOS keine Sicherheiten gemäß IFRS 7.14 hereingenommen.

33 Akquisitionen

ELMOS hat am 10. Mai 2007 20% der Anteile an der DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden, erworben. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Fertigung und der Vertrieb von integrierten Schaltkreisen und elektronischen Systemen. Die Anschaffungskosten der Anteile betragen 49.000 Euro. Trotz fehlender formaler Beherrschung erfolgt eine Einbeziehung der Zweckgesellschaft gemäß SIC-12, da bei wirtschaftlicher Betrachtung ELMOS die Mehrheit des Nutzens aus der DMOS zieht und eine jederzeit ausübbar Option auf den Erwerb weiterer 54,8% der Anteile besitzt. Die Einbeziehung in den Konzernabschluss erfolgte bereits in früheren Jahren.

34 Konzernunternehmen

Gemäß IAS 27 sind in den Konzernabschluss das Mutterunternehmen und die unter der rechtlichen und tatsächlichen Kontrolle des Mutterunternehmens stehenden Tochterunternehmen einzubeziehen.

In dem vorliegenden Konzernabschluss sind somit folgende Unternehmen einbezogen worden:

	Kapitalanteil (mittel- und unmittelbar) in %
Mutterunternehmen	
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund	
Tochterunternehmen	
ELMOS Advanced Packaging B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS California Inc., Milpitas/USA	100,0
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	100,0
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	100,0
ELMOS France S.A.S., Nanterre/Frankreich	100,0
ELMOS Industries GmbH, Hanau	49,0
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills/USA	100,0
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, München	100,0
ELMOS Services B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., Nijmegen/Niederlande	100,0
DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden	20,0
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	73,9
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	51,0
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	51,0
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria/Südafrika	67,6
Silicon Microstructures Inc., Milpitas/USA	100,0

In den Konzernabschluss nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmen

Die attoSENSOR GmbH, Penzberg, (45% Beteiligungsquote zum 31. Dezember 2007) wird nach der Equity-Methode bilanziert. Der Beteiligungsansatz entspricht einem Erinnerungswert von 1 Euro nach einem im Vorjahr vorgenommenen impairment.

Angaben zum Anteilsbesitz

	Währung	Beteiligungen %	Eigenkapital in Tsd. Euro/LW	Ergebnis in Tsd.
Inland				
Advanced Appliances Chips GmbH, Riedstadt	Euro	33,33	271	184 ¹
attoSENSOR GmbH, Penzberg	Euro	45,00	60	7 ¹
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG, Dortmund	Euro	100,00	173	168 ²
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG, Dortmund	Euro	100,00	92	338 ²
ELMOS Semiconductor Süd GmbH, München	Euro	100,00	175	- 2 ²
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG, Mainz	Euro	100,00	30	6 ¹
GED Gärtner Electronic Design GmbH, Frankfurt/Oder	Euro	73,90	1.000	282
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH, Dortmund	Euro	100,00	-	- ³
IndustrieAlpine Bauträger GmbH, München	Euro	51,00	- 865	- 114
Mechaless Systems GmbH, Karlsruhe	Euro	51,00	741	8
ELMOS Industries GmbH, Hanau	Euro	49,00	- 755	- 693
DMOS Dresden MOS Design GmbH, Dresden	Euro	20,00	625	216
Ausland				
ELMOS Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	91.643	11.804
ELMOS Advanced Packaging B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	- 1.175	- 2.133 ²
ELMOS Design Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	- 2.425	- 735 ²
ELMOS Quality Services B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	12.298	318 ²
European Semiconductor Assembly (Eurasem) B.V., Nijmegen (NL)	Euro	100,00	31.547	0 ²
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria (Südafrika)	ZAR	67,60	- 592	- 559 ²
EL-MOS France S.A., Nanterre (F)	Euro	100,00	2.238	1.166
ELMOS USA Inc., Michigan (USA)	USD	100,00	-	- ³
ELMOS California Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	- 296	24 ²
ELMOS N.A. Inc., Farmington Hills (USA)	USD	100,00	- 3.005	912 ²
Silicon Microstructures Inc., Milpitas (USA)	USD	100,00	- 3.889	- 8.392 ²

¹ Die vorgelegten Zahlen beruhen auf vorläufigen, ungeprüften Abschlüssen zum 31. Dezember 2007.

² Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund.

³ Es liegt bislang kein Jahresabschluss der Gesellschaft vor.

35 Angaben zu Vorstand und Aufsichtsrat

Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats für 2007

	Fixe Bezüge Tsd. Euro	Variable Bezüge Tsd. Euro	Gratisaktien (Stock Awards) Tsd. Euro
Vorstand	1.655	185	65
Aufsichtsrat	92	0	0

Die Bezüge für frühere Vorstandsmitglieder bzw. ihrer Hinterbliebenen betragen im Geschäftsjahr 2007 79 Tsd. Euro (2006: 132 Tsd. Euro). Ferner wurden Versicherungsprämien in Höhe von 200 Tsd. Euro (2006: 53 Tsd. Euro) entrichtet. Die Höhe der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2007 beträgt 2.536 Tsd. Euro (2006: 1.494 Tsd. Euro). Für sonstige Dienstleistungen, insbesondere Beratungen, vergütete die Gesellschaft an Mitglieder des Aufsichtsrats 377 Tsd. Euro (2006: 281 Tsd. Euro).

In der Hauptversammlung vom 19. Mai 2006 wurde mit der erforderlichen ¾-Mehrheit beschlossen, die Angaben gem. §285 I Nr. 9a Satz 5-9 HGB für die folgenden fünf Jahre zu unterlassen.

36 Aktien und Aktienoptionen des Vorstands und Aufsichtsrats

Am 31. Dezember 2007 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien und Aktienoptionen von ELMOS:

Vorstand

Dr. Anton Mindl	12.225 Aktien	0 Optionen
Reinhard Senf	3.923 Aktien	40.000 Optionen
Dr. Frank Rottmann	1.975 Aktien	6.200 Optionen
Nicolaus Graf von Luckner	2.975 Aktien	0 Optionen

Aufsichtsrat

Prof. Dr. Günter Zimmer	0 Aktien	0 Optionen
Dr. Burkhard Dreher	1.900 Aktien	0 Optionen
Jörns Haberstroh	3.956 Aktien	0 Optionen
Dr. Klaus Weyer	10.000 Aktien	25.000 Optionen
Dr. Peter Thoma	9.200 Aktien	40.000 Optionen
Jutta Weber	200 Aktien	0 Optionen

37 Angaben zu Honoraren für Konzernabschlussprüfer

Die Gesellschaften des ELMOS-Konzerns haben im Geschäftsjahr 2007 folgende Dienstleistungen von der als Konzernabschlussprüfer bestellten Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft in Anspruch genommen:

	2007 Tsd. Euro
Abschlussprüfung	134
Sonstige Bestätigungs- und Bewertungsleistungen	208
Steuerberatungsleistungen	144
Sonstige Leistungen	2
	488

38 Gewinnverwendung

Der Vorstand schlägt (in Übereinstimmung mit dem Aufsichtsrat) vor, den Bilanzgewinn der ELMOS Semiconductor AG von 39.621.311,85 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

39 Angaben nach §160 AktG

Aufgeführt sind meldepflichtige Wertpapiergeschäfte im Jahr 2007 bezogen auf Aktien der ELMOS Semiconductor AG (ISIN DE0005677108). Emittent ist die ELMOS Semiconductor AG, Heinrich-Hertz-Str. 1, 44227 Dortmund.

Datum/Ort	Name	Funktion	Transaktion	Stückzahl	Kurs/Basispreis (Euro)	Gesamtvolumen (Euro)
28.9.2007 Frankfurt/Main	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,55	7.550
7.11.2007 Xetra	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Kauf von ELMOS-Aktien	1.000	7,52	7.520
8.11.2007 außerbörslich	Dr. Anton Mindl	Vorstandsvorsitzender der ELMOS Semiconductor AG	Übertragung von ELMOS-Aktien	2.975	7,25	21.569
8.11.2007 außerbörslich	Nicolaus Graf von Luckner	Vorstand der ELMOS Semiconductor AG	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319
8.11.2007 außerbörslich	Dr. Frank Rottmann	Vorstand der ELMOS Semiconductor AG	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319
8.11.2007 außerbörslich	Reinhard Senf	Vorstand der ELMOS Semiconductor AG	Übertragung von ELMOS-Aktien	1.975	7,25	14.319

40 Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen

Nach IAS 24 „Related Party Disclosures“ müssen Personen bzw. Unternehmen, die den ELMOS-Konzern beherrschen oder von ihr beherrscht werden, angegeben werden, soweit sie nicht bereits als konsolidiertes Unternehmen in den Konzernabschluss des ELMOS-Konzerns einbezogen werden. Beherrschung liegt hierbei vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte an der ELMOS Semiconductor AG hält oder kraft Satzungsbestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik des Managements des ELMOS-Konzerns zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit assoziierten Unternehmen sowie Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des ELMOS-Konzerns ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des ELMOS-Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der ELMOS Semiconductor AG von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Der ELMOS-Konzern ist im Geschäftsjahr 2007 von den Angabepflichten des IAS 24 ausschließlich in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen zu assoziierten Unternehmen, zu den Mitgliedern des Vorstandes und des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor AG sowie zu den übrigen Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen betroffen.

Der ELMOS-Konzern unterhält im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Perso-

nen. Diese Liefer- und Leistungsbeziehungen werden zu Marktpreisen abgewickelt. In 2007 hat der ELMOS-Konzern für nicht konsolidierte assoziierte Unternehmen (AAC) Lieferungen in Höhe von 430 Tsd. Euro (2006: 739 Tsd. Euro) erbracht. Von attoSensor hat der ELMOS-Konzern in 2007 Leistungen in Höhe von 356 Tsd. Euro (2006: 200 Tsd. Euro) erhalten. Neben den unter der Anhangsangabe 35 genannten Bezügen des Vorstandes und Aufsichtsrates existieren keine wesentlichen Beziehungen zu nahe stehenden Personen.

Darüber hinaus haben Unternehmen des ELMOS-Konzerns mit Mitgliedern des Vorstands oder des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor AG sowie mit anderen Mitgliedern des Managements in Schlüsselpositionen bzw. mit Gesellschaften, in deren Geschäftsführungs- oder Aufsichtsgremien diese Personen vertreten sind, keinerlei wesentliche berichtspflichtigen Geschäfte vorgenommen. Dies gilt auch für nahe Familienangehörige dieses Personenkreises.

41 Mitarbeiterzahlen

Im Geschäftsjahr 2007 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Konzern 1.177 (2006: 1.131).

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter verteilt sich wie folgt:

Gruppe	2007 Anzahl	2006 Anzahl
Angestellte	709	655
Gewerbliche Arbeitnehmer	468	476
Gesamt	1.177	1.131

42 Wesentliche Ereignisse nach Ende des Geschäftsjahres

Die Hauptversammlung der ELMOS Semiconductor AG hat mit Beschluss vom 10. Mai 2007 den Vorstand ermächtigt, bis zum 9. November 2008 eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zu erwerben. Der Vorstand hat beschlossen, mit einem Aktienrückkauf zum 30. Januar 2008 zu beginnen. Insgesamt sollten maximal bis zu 50.000 eigene Aktien (ISIN DE0005677108) oder 0,26% des Grundkapitals zurück erworben werden. Bis zum 25. Februar 2008 wurden diese 50.000 Stück eigene Aktien zurück erworben. Der Gesamtkaufpreis dafür betrug 297.547 Euro, bei einem Durchschnittskurs von 5,95 Euro je Aktie.

Darüber hinaus sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

43 Entsprechenserklärung nach §161 AktG

Die ELMOS Semiconductor AG hat für 2007 die nach §161 AktG vorgeschriebene Erklärung im Dezember 2007 abgegeben und den Aktionären auf ihrer Internet-Seite zugänglich gemacht. Sie kann auch bei der Gesellschaft angefordert werden. Zudem ist sie im vorliegenden Geschäftsbericht im Kapitel „Corporate Governance“ abgedruckt.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

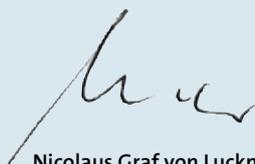
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses

und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Dortmund, im März 2008



Dr. Anton Mindl



Nicolaus Graf von Luckner



Reinhard Senf



Dr. Frank Rottmann

Bestätigungsvermerk

Zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den von der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel und Anhang – sowie den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend

auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind und den ergänzend nach §315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Dortmund, 3. März 2008

Ernst & Young AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Muzzu
Wirtschaftsprüfer

Krebs
Wirtschaftsprüfer

APPENDIX

2007 im Rückblick	126
Glossar	130
Impressum	133
Finanzkalender 2008	133

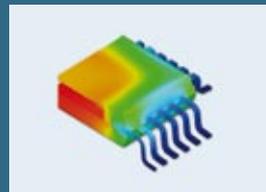
2007 im Rückblick

23.01.2007
Auszeichnung als umweltfreundliches und sozial engagiertes Unternehmen



Nachhaltigkeit und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sind für uns selbstverständlich. Kempen Capital Management und SNS Asset Management hat dies honoriert und die ELMOS als Kandidat für den Kempen/SNS Smaller Europe SRI vorgeschlagen. SRI steht für Social Responsibility Index. Dieser Index ist der erste, der sich auf europäische Small Caps fokussiert hat, die großen Wert auf Umweltschutz und soziale Belange legen. Zudem wurde ELMOS als Unternehmen prämiert, welches speziellen Wert auf Umweltfreundlichkeit und soziale Belange legt.

27.03.2007
Standard-IC-Gehäuse für Hochtemperatur-Einsatz



Auf einem Workshop präsentierte ELMOS neue Möglichkeiten und Lösungen für den Hochtemperatur-Einsatz von Halbleitern. Im Mittelpunkt standen Standardgehäuse-Technologien, die Temperaturen bis 200°C standhalten. Dabei wurde die gesamte Fertigungskette von der Chipherstellung über den Häusungsprozess, der Qualifikation bis hin zum Hochtemperaturtest betrachtet. Die vorgestellten Ergebnisse sind im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes entstanden.

JANUAR

FEBRUAR

MAERZ

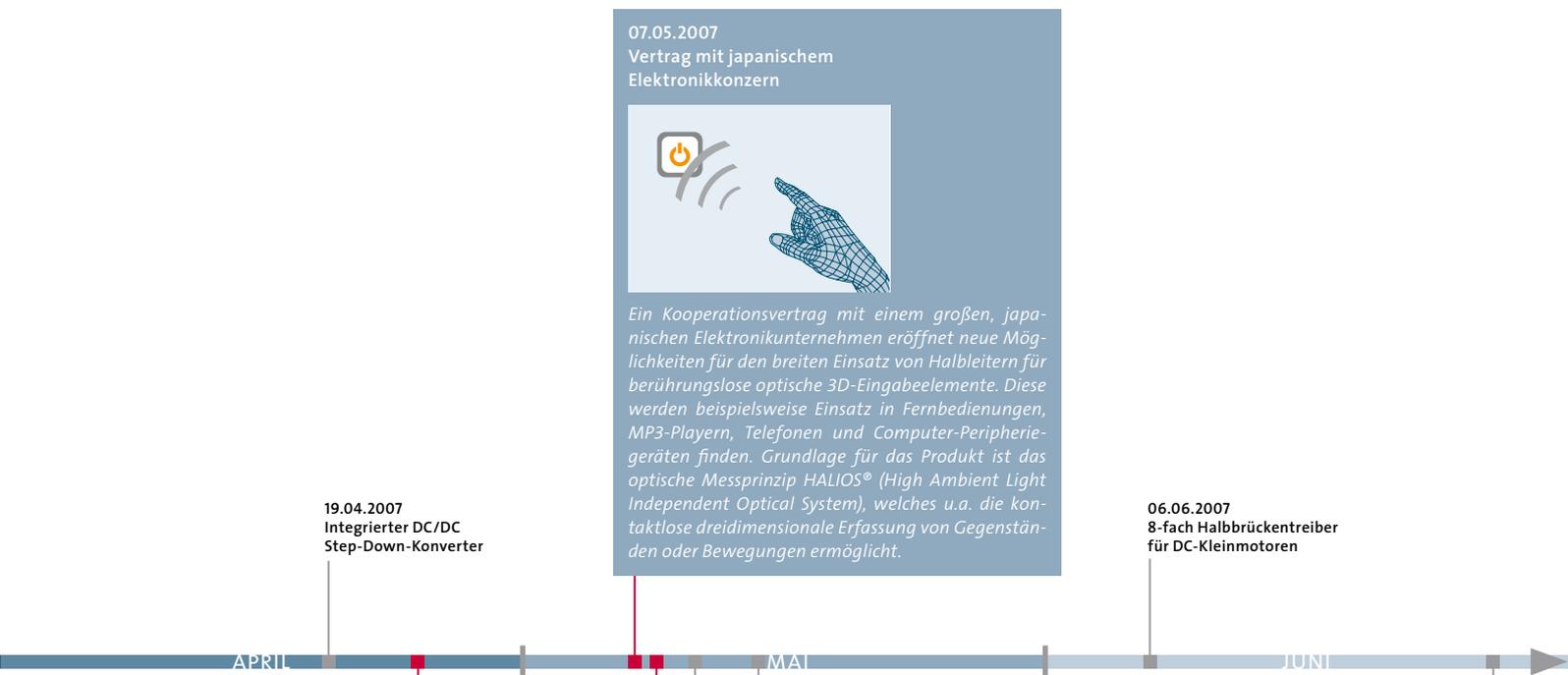
11.01.2007
Erfolgreicher Hochlauf für ESP-Mikrosystem

14.02.2007
Stabiler Aufwärtstrend

14.03.2007
ELMOS steigert Umsatz und Jahresüberschuss



Der Vorstand hat im März den Jahresabschluss 2006 präsentiert. Auf der Bilanzpressekonferenz und der Analystenkonferenz konnte ein Umsatzanstieg um 9,3% sowie eine signifikante Verbesserung des Free Cash Flows bekannt gegeben werden. Zudem standen strategische Entscheidungen zur Erweiterung von Geschäftsfeldern und Kooperationen im Vordergrund. Beispielsweise erläuterte Dr. Mindl die Verlagerung des Assembly-Geschäftes nach Asien.



07.05.2007
 Vertrag mit japanischem
 Elektronikkonzern



Ein Kooperationsvertrag mit einem großen, japanischen Elektronikunternehmen eröffnet neue Möglichkeiten für den breiten Einsatz von Halbleitern für berührungslose optische 3D-Eingabelemente. Diese werden beispielsweise Einsatz in Fernbedienungen, MP3-Playern, Telefonen und Computer-Peripheriegeräten finden. Grundlage für das Produkt ist das optische Messprinzip HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System), welches u.a. die kontaktlose dreidimensionale Erfassung von Gegenständen oder Bewegungen ermöglicht.

19.04.2007
 Integrierter DC/DC
 Step-Down-Konverter

06.06.2007
 8-fach Halbbrückentreiber
 für DC-Kleinmotoren

14.05.2007
 Neuer Umweltbericht
 veröffentlicht

10.05.2007
 Hauptversammlung nahm alle
 Tagesordnungspunkte an

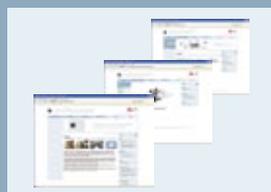
26.06.2007
 Zwölf Produkte
 auf einen Blick

24.04.2007
 Einmalige Sonderbelastung durch
 die amerikanische Tochterfirma SMI



Um künftig die Marktchancen für Mikrosysteme besser und zuverlässiger zu nutzen, hat ELMOS bei der amerikanischen Tochterfirma Silicon Microstructures Inc. (SMI) eine neue Geschäftsführung eingesetzt. Zudem wurde ein Restrukturierungs- und Ergebnis-korrekturbedarf für 2007 festgestellt. Dies hatte auch Auswirkungen auf den Standort in den Niederlanden. Aufgrund von verspäteten SMI-Produktanläufen mussten in den Niederlanden Mitarbeiter abgebaut werden. Beide Standorte wurden durch die eingeleiteten Maßnahmen wettbewerbsfähiger und effizienter in die ELMOS Strategie integriert.

08.05.2007
 ELMOS mit neuem
 Internetauftritt



Mehr Übersicht, mehr Inhalt, mehr Offenheit – das war der rote Faden für die komplette Neu-Gestaltung der ELMOS Homepage. Die Navigation bietet für alle Zielgruppen eine spezifische Gliederung. Beispielsweise ist bei den Produkten durch eine völlig überarbeitete Struktur jetzt eine Suche nach Applikationen, ASICs und ASSPs möglich. Des Weiteren wird die Homepage laufend durch neue Inhalte erweitert, etwa mit einer 360°-Panorama Ansicht des Hauptsitzes in Dortmund. Dieser gibt u.a. Einblick in die Wafer-Fertigung und den Test-Bereich.

02.08.2007
Distributoren für Standardprodukte



2007 haben wir unsere Vermarktung mit der Auswahl von zusätzlichen Distributoren auf neue Beine gestellt. ELMOS und SMI arbeiten nun mit insgesamt fünf Partnern in Europa zusammen. Auch in Asien haben wir die Vertriebsaktivitäten mit ebenfalls fünf Distributoren gestärkt. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Akquisition und die logistische Abwicklung von neuen Aufträgen aus der Automobil-, Industrie- und Konsumgüterelektronik sowie der Medizintechnik. Die Distributoren sind die idealen Partner, da sie sich durch ein breites Kundenspektrum, großes Applikationsverständnis und hohe Zuverlässigkeit auszeichnen.

15.08.2007
ELMOS startet Aktienrückkauf

08.08.2007
Optische Detektion von Annäherung und Berührung

13.09.2007
Silicon Microstructures erweitert Vertriebskanäle

01.08.2007
Mikrotechnologen haben Ausbildung abgeschlossen

21.09.2007
Sensorlose Geschwindigkeitsregelung von DC-Motoren

11.07.2007
Wichtige Folgeaufträge gewonnen



ELMOS hat im ersten Halbjahr 2007 wichtige Folgeaufträge für kundenspezifische Halbleiter im Automobil, sog. ASICs, gewonnen. Die Kernkompetenzen im Bereich der effizienten Motoransteuerung für Klimaanlage sowie verschiedene Airbag-ICs standen dabei im Mittelpunkt. Auftraggeber sind u.a. langjährige Kunden aus der Automobilindustrie. Diese Folgeaufträge bestätigen sowohl die Notwendigkeit als auch das Vertrauen der Kunden in eigens entwickelte Halbleiterlösungen. Das Volumen der Aufträge stellt das mittelfristige Wachstum der Gesellschaft auf eine solide Basis.

06.08.2007
Verpackungs-Verlagerung abgeschlossen



Mitte des Jahres haben wir die Verlagerung der standardisierten Chip-Verpackungen nach Asien abgeschlossen. Die Dienstleister im asiatischen Raum haben die hohen Anforderungen erfolgreich erfüllt. ELMOS steigert damit auch den Zukauf von Leistungen aus dem Dollarraum. Die ELMOS-Tochter, ELMOS Advanced Packaging in den Niederlanden, richtet seitdem ihre Entwicklung und Fertigung ganz auf Spezialgehäuse aus, wie sie beispielsweise für Mikrosysteme zur Messung von Druck oder bei optischen Sensoren benötigt werden.

11.09.2007
DC-Motor-Controller mit Ripple Detection-Funktion

09.10.2007
 BMW setzt auf ELMOS-FlexRay™-Chips



Als weltweit erstes Unternehmen bietet ELMOS einen Vierfach-Sternkoppler für das FlexRay™-Netzwerk an. Auch BMW ist von der Leistung überzeugt und wählt ELMOS als Lieferant aus. Start der Serienproduktion wird Mitte 2008 sein. Der neu entwickelte Baustein ersetzt vier konventionelle Einfach-Transceiver und ermöglicht so die Realisierung von platz- und kostenoptimierten Steuergeräten. In den kommenden Jahren wird BMW das Hochgeschwindigkeits-Netzwerk FlexRay™ als neuen Standard für zeitkritische Applikationen einsetzen.

23.11.2007
 Erfolgreicher Kunden-Workshop



Im November konnten wir zahlreiche Vertreter der Automobilindustrie bei unserem Kunden-Workshop begrüßen. Unter dem Motto „Mega-Trends und Nischen: Standardisierung, Modularisierung und Differenzierung durch Elektronik“ haben renommierte Referenten von Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai-Kia, Opel, VW und Tyco Electronics AMP aktuelle Themen präsentiert. Die Präsentationen deckten ein breites Spektrum von Themengebieten ab, beispielsweise die Schnittstelle zwischen Entwicklung und Produktion, Elektronik im Motorrad, Fahrwerkselektronik und Bordnetzarchitekturen.

OKTOBER

NOVEMBER

DEZEMBER

17.10.2007
 ELMOS Industries
 auf der SPS/IPC/Drives

31.10.2007
 ELMOS mit
 stabilem Wachstum

05.12.2007
 PIR Light-Controller
 für Komfort-Licht-Applikationen

12.12.2007
 Deutsche Automobilindustrie
 startet Innovationsallianz
 Automobilelektronik

07.12.2007
 Spende für die
 Dortmunder Tafel e.V.

28.11.2007
 ELMOS verstärkt sein
 Distributionsnetzwerk
 in Europa

12.10.2007
 ELMOS stellt neuen Produkt-Katalog vor



Der neue Standardprodukt-Katalog ist noch umfangreicher und beweist die Stärkung des Geschäftes mit applikationsspezifischen Halbleiter- und Sensorbausteinen (ASSPs): Auf über 130 Seiten werden 64 Produkte vorgestellt. Die Produkte umfassen Chips für den Einsatz in den Bereichen Bus-Systeme, DC/DC-Konverter, Motor-Treiber, Ripple Detection, Sensoren, Sensor-Auswerteschaltungen und Eingangs-/Ausgangsbausteine. Die vorgestellten Produkte sind für einen Einsatz sowohl in Automobil- wie auch in Industrie- und Konsumgüterapplikationen geeignet.

Glossar

ASSEMBLY

Bezeichnet die Weiterverarbeitung der Wafer zu einem verpackten Chip.

ASIC

Ein **Application Specific Integrated Circuit** (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ist ein individuell für eine spezifische Anwendung entwickelter Schaltkreis. Im Gegensatz zu Standardbauelementen, die nicht kundenspezifisch konfiguriert sind, zum Beispiel Spannungsregler, Speicher, Prozessoren.

ASSP

Ein **Application Specific Standard Product** (applikationsspezifisches Standardprodukt) ist ein integrierter Schaltkreis, der individuell für eine spezifische Anwendung/Applikation entwickelt wurde. Dieser kann an mehrere Kunden als Applikations-Standard vermarktet werden.

BACKEND-FERTIGUNG

Die Backend-Fertigung ist der Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der durchgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat. Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, Burn-in, Verpackung (Tape) und der funktionale Test der assemblierten Bausteine.

BELICHTUNG

Belichten ist das selektive Bearbeiten der Fotoschicht durch eine Belichtungsmaske mit dem Ziel, die Löslichkeit dieser Schicht durch eine photochemische Reaktion lokal zu verändern. Die Belichtungsmaske bestehen aus einer UV-durchlässigen Trägerschicht.

BIT

Eine Informationseinheit, welche entweder den Wert „0“ oder „1“ annehmen kann.

BURN-IN

Eine Methode zur künstlichen Alterung von elektronischen Schaltungen und Bauelementen, um Frühausfälle zu entdecken. Dabei werden die Chips über einen längeren Zeitraum hohen Temperaturen ausgesetzt.

BÜRSTENLOSER DC-MOTOR (EC/BLDC-MOTOR)

Beim EC/BLDC-Motor wird mit einer Steuerschaltung (IC) ein künstliches Drehstromnetz erzeugt. Durch Spulen im Stator wird damit ein rotierendes Magnetfeld erzeugt.

BUS

Ein Kommunikationssystem, welches den Austausch von elektronischen oder optischen Informationen ermöglicht. Im Auto werden u.a. folgende Standards eingesetzt: LIN, CAN, MOST und FlexRay™.

BYTE

Das Byte ist ein Maß für Informationseinheiten. Ein Byte entspricht acht Bit.

CAN

Der CAN-BUS (**C**ontroller **A**rea **N**etwork) ist ein ereignisgesteuertes Kommunikationssystem mit einer Übertragungsrate bis zu 1Mbit/s. Es ist das derzeit am meisten eingesetzte Fahrzeugnetzwerk.

CHIP

Ein elektronischer Schaltkreis, der in Halbleitermaterial realisierte elektrische Funktionen beinhaltet.

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter) ist die Basistechnologie zur Herstellung von Mikrochips mit hohem Integrationsgrad und geringem Energieverbrauch.

CONNECT

Unter der Produktgruppe Connect werden die Chips zusammengefasst, welche zur elektrischen Verbindung von Applikationen bzw. zum Aufbau von Netzwerken benötigt werden. Im Produktbereich des Autos sind dies u.a. Bausteine für den Einsatz in LIN, CAN und FlexRay™ Netzwerken.

DC/DC (GLEICHSTROM ZU GLEICHSTROM)

Eine Baugruppe, ein Gerät oder eine Einrichtung zur Umwandlung elektrischer Ströme und Spannungen von einem Eingangsniveau in ein Ausgangsniveau.

DC-MOTOR (GLEICHSTROM-MOTOR)

Der DC-Motor (**d**ual **c**urrent/Gleichstrom) ist ein mit Gleichstrom gespeister Elektromotor. Er kann z.B. aus einem feststehenden Ständer (auch Stator) und einem sich drehenden Läufer (auch Rotor) bestehen.

DISTRIBUTOREN

Distributoren sind Vertriebspartner, die die Vermarktung und den Vertrieb von vornehmlich Standardprodukten vorantreiben.

DOTIERUNG

Eine Dotierung ist in der Mikroelektronik bei der Herstellung eines Chips das Einbringen (Implantation) von Fremdatomen in eine Schicht oder in das Grundmaterial eines ICs und zwar in sehr geringer Konzentration. Dies verändert gezielt die Eigenschaften dieser Schicht, meistens die Leitfähigkeit oder die Kristallstruktur.

DRIVE

Die Produktgruppe Drive beinhaltet applikationsspezifische Produkte (ASSPs), welche zur Ansteuerung von elektrischen Motoren benötigt werden. Einzigartige Lösungen dazu hat ELMO mit dem Ripple Count- und dem VirtuHall®-Verfahren entwickelt.

DRUCKSENSOR

Der Drucksensor kann je nach Applikation die Bereiche Niedrig- oder Hochdruck ermitteln und die Daten an die Auswerteelektronik weitergeben. Drucksensoren werden beispielsweise in medizinischen Applikationen (u.a. Beatmungs-, Blutdruckgeräte) oder automobilen Anwendungen (u.a. Reifendruck) eingesetzt.

EC-MOTOR

Beim EC/BLDC-Motor wird mit einer Steuerschaltung (IC) ein künstliches Drehstromnetz erzeugt. Durch Spulen im Stator wird damit ein rotierendes Magnetfeld erzeugt.

ELEKTRONISCHER SCHALTKREIS

Ein Zusammenschluss verschiedener elektrischer Komponenten, die eine bestimmte Funktion in einem elektrischen System übernehmen.

FLASH

Flash-Speicher lassen sich frei adressierbar beschreiben. Der Flash-Speicher verliert bei Stromabschaltung nicht die Informationen.

FLEXRAY™

FlexRay™ ist ein neuer Vernetzungsstandard für Applikationen mit hohen Anforderungen. Es unterstützt aktive und passive Sicherheitssysteme sowie synchrone und asynchrone Datenübertragung mit Geschwindigkeiten bis zu 10Mbit/s.

FOUNDRY

Eine Halbleiterfertigung, deren primäres Geschäftsziel die Herstellung und der Verkauf von prozessierten Silizium-Wafern ist.

FRONTEND-FERTIGUNG

Herstellen der elektronischen Schaltungen auf Silizium-Wafern mittels physikalischer und chemischer Bearbeitungsverfahren unter Reinraumbedingungen.

GELBRAUM

Der Gelbraum ist eine spezielle Bezeichnung für Reinräume zur Fotolithografie in der Halbleiterfertigung, die wegen der Lichtempfindlichkeit des Fotolackes mit Gelblicht ausgestattet sind.

HALBLEITER

Ein Festkörpermateriale (z.B. aus Silizium oder Germanium), das physikalisch modifiziert seine elektrischen Eigenschaften ändern kann. Durch gezieltes Dotieren des Materials, in der Regel mit Bor oder Phosphor, kann man die elektronischen Eigenschaften verändern.

HALIOS®

HALIOS® (**H**igh **A**mbient **L**ight **I**ndependent **O**ptical **S**ystem) kennzeichnet sich aus durch die Erfassung von dreidimensionalen Bewegungen. Optische Fremdeinflüsse, wie z.B. starker Lichteinfall, beeinflussen die Leistung nicht. Die elektronische Kompensierung von Fremdlichteinstrahlung ist die technisch ausschlaggebende Funktion.

INTEGRIERTE SCHALTUNG, IC

Eine elektronische Schaltung, die aus verschiedenen, miniaturisierten elektronischen Bauelementen besteht (z.B. Widerstände, Kondensatoren, Transistoren etc.), welche in einem Halbleitermaterial integriert wurden.

IONISATION

Bei der Ionisation werden Ionen erzeugt (positiver und/oder negativer Polarität), um z.B. geladene Oberflächen zu neutralisieren. Die für die Anwendungen in Reinräumen konzipierten Ionisationssysteme werden in den Luftstrom eingesetzt. Durch das Freisetzen von positiven und negativen Ionen werden diese mit der Luft in die Arbeitsbereiche transportiert, wobei die Ionen die Aufladungen sowohl von Oberflächen als auch von Partikeln neutralisieren oder zumindest reduzieren.

JEDEC

Joint Electron Devices Engineering Council ist das Standardisierungsgremium für elektronische Gehäusebauformen.

LAYOUT

Beschreibt mit einfachen geometrischen Formen die zur Herstellung von integrierten Schaltungen benötigten Informationen aus der Schaltungsentwicklung.

LED

Eine **L**ight **E**mitting **D**iode (Leuchtdiode) ist eine Halbleiter-Diode, die aufgrund eines elektrischen Stroms Licht aussendet.

LIN

Der LIN-BUS (**L**ocal **I**nterconnect **N**etwork) ist ein Kommunikationsnetzwerk in Fahrzeugen. Es verbindet insbesondere Komfortapplikationen mit einer Bandbreite bis zu 20Kbit/s.

MEMS

Mikro-**E**lektronische-**M**echanische **S**ysteme sind insbesondere Sensoren, welche auf Halbleitertechnologien basieren. Diese können beispielsweise Druck oder Neigungen erfassen.

MIKROMETER

Ein Mikrometer (μm) ist der einmillionste Teil eines Meters.

MIKROPROZESSOR/MIKROKONTROLLER

Eine integrierte, komplexe elektronische Einheit, die ein elektronisches System kontrolliert und betreibt. Mikroprozessoren sind die zentralen Gehirne eines elektronischen Systems, wie z.B. dem Computer.

MIKROSYSTEM

Ein Mikrosystem ist die Kombination von Sensorik und Auswerteelektronik in einem Spezialgehäuse. Durch den hohen Integrationsgrad wird u.a. sehr wenig Bauraum benötigt.

MIXED-SIGNAL

Eine Kombination von analogen und digitalen Signalen, die gleichzeitig auf ein und demselben Chip generiert, kontrolliert oder modifiziert werden.

MOS

Metal-Oxide-Semiconductor (Metall-Oxid-Halbleiter) beschreibt den Aufbau des zentralen Kontrollelements für den Feldeffekt in einer speziellen Klasse von Halbleitertransistoren.

MOST-PROTOKOLL

Das MOST-Protokoll ist ein Vernetzungsstandard für Produkte, die eine hohe Daten-Bandbreite benötigen. Insbesondere verbindet MOST Infotainment- und Telematik-Applikationen.

OEM

Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster oder Zulieferer) ist ein Hersteller, der (Teil-) Systeme an einen Wiederverkäufer vertreibt. In der Automobilindustrie bezeichnet OEM die Fahrzeughersteller.

PPM

Die Abkürzung steht für **parts per million** (eins aus einer Million).

RECEIVER (EMPFÄNGER)

Der Receiver ist ein Empfänger mit dem (meist elektromagnetische) Signale empfangen werden können. Der Empfänger wird meist im Zusammenhang mit dem Empfang von hochfrequenten Signalen verwendet.

REINRAUM

Ein abgeschlossener Gebäudebereich, in dem die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Verunreinigungen durch Staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrolliert werden.

SCHRITTMOTOR (STEPPERMOTOR)

Ein Schrittmotor ist ein Elektromotor, bei dem der Rotor (drehbarer Motorteil) bei geschickter Wahl der angesteuerten Statorspulen (nicht-drehbarer Motorteil) gezielt um einen Winkel gedreht werden kann.

SENSE

Die Produktgruppe Sense umfasst insbesondere die applikationsspezifischen Produkte (ASSPs), welche physikalische Messgrößen messen, auswerten oder regeln können. Dazu zählen beispielsweise Drucksensoren.

SENSOR

Eine elektrische Baugruppe, die eine reale physikalische Größe, z.B. Bewegung, Hitze oder Licht misst oder erkennt und anschließend in ein analoges oder digitales elektrisches Signal umwandelt.

SILIZIUM, SI

Das am häufigsten benutzte Halbleitermaterial, welches für etwa 95% aller hergestellten Chips eingesetzt wird.

SOI

Silicon-on-Insulator (Silizium auf Isolator) ist ein spezielles Ausgangsmaterial für die Halbleiterherstellung, welches eine perfekte vertikale Isolierung mittels nichtleitender Zwischenschichten aufweist.

STERNKOPPLER

Der Sternkoppler ist eine Netzwerkkomponente, die mehrere Leitungen zusammenführt, vergleichbar mit einem Hub. Sternkoppler werden zum Beispiel als zentrale Bauelemente für sternförmige Netze verwendet, um ein Signal in mehrere Leitungen gleichzeitig einzukoppeln.

SYSTEM ON CHIP

Fortschritte in der Halbleiterfertigungstechnologie und Entwicklungsmethodik machen es heute möglich, ASICs mit mehreren Millionen Transistoren zu fertigen. Die Idee von System on Chip ist, möglichst viele komplexe Funktionen in einen Chip zu integrieren.

TRANSCIEVER

Transceiver ist ein englisches Kunstwort aus transmitter und receiver. Es bezeichnet eine für in konstruktiver Baueinheit ausgeführte Kombination aus Sender und Empfänger.

TRANSISTOR

Ein Transistor, auch Transfer Resistor (gesteuerter Übergangswiderstand), ist das Grundbauelement der Halbleiterschaltungstechnik für die Verstärkung beziehungsweise zum Schalten von elektronischen Signalen.

VIRTUHALL®

Das VirtuHall® Prinzip ermöglicht die sensorlose Erkennung der Rotorlage von bürstenlosen Gleichstrommotoren. Das besondere an diesem Verfahren ist, dass es vom Stillstand bis zu hohen Motordrehzahlen immer nach dem gleichen Prinzip arbeitet und daher keine störenden Übergangsbereiche kennt.

WAFER

Das Ausgangsmaterial in der Chipherstellung. Es handelt sich dabei um eine etwa 0,3 bis 1mm dicke Scheibe, die aus einem Siliziumeinkristall gesägt und anschließend poliert worden ist. Typische Durchmesser betragen 150 (6-Zoll), 200 (8-Zoll) und 300 (12-Zoll) mm.

Impressum

INFORMATIONSMATERIAL

Wenn Sie mehr über ELMOS erfahren möchten, senden wir Ihnen gerne folgende Dokumente zu:

- ▶ Geschäftsbericht
- ▶ Zwischenberichte/Quartalsberichte
- ▶ Kodex des verantwortungsvollen Handelns
- ▶ Umweltbericht
- ▶ Unsere Technologie-Broschüre
- ▶ Unsere Herstellungsprozess-Broschüre
- ▶ Unsere Kompetenzen-Broschüre
- ▶ Unser Unternehmen
(Imagebroschüre/Unternehmensdarstellung)
- ▶ Newsletter (quartalsweise)
- ▶ Standardproduktkatalog
- ▶ Flyer zu den Produktgruppen Sense, Drive, Connect, Supply

Alle aufgeführten Dokumente befinden sich auch auf unserer Internetseite unter www.elmos.de. Wenn Sie regelmäßig unsere Ad hoc-Meldungen sowie Pressemitteilungen erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an invest@elmos.de.

Dieser Geschäftsbericht liegt auch in englischer Sprache vor.

KONTAKT | IMPRESSUM

Herausgeber

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund | Deutschland
www.elmos.de

Kontakt

Janina Rosenbaum | Investor Relations
Telefon +49 (0) 231 - 75 49 - 287
Telefax +49 (0) 231 - 75 49 - 548
invest@elmos.de

Design

DianaDesign | Diana Kasperek, Hamburg
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Fotografie und Illustration

d-quadrat | Stefan Dintelmann, Groß-Gerau
Fotoagentur Netzhaut | Dirk Hoppe, Dortmund
ELMOS Semiconductor AG, Dortmund

Druck

Lonnemann GmbH, Selm

Finanzkalender

FINANZKALENDER 2008

Ergebnis 2007	13. März 2008
Bilanzpressekonferenz	13. März 2008
Analystenkonferenz	13. März 2008
Quartalsergebnis Q1/2008	30. April 2008
Hauptversammlung in Dortmund	08. Mai 2008
Quartalsergebnis Q2/2008	13. August 2008
Quartalsergebnis Q3/2008	05. November 2008

ELMOS Semiconductor AG
Heinrich-Hertz-Straße 1
44227 Dortmund | Deutschland
Telefon +49(0)231-75 49-0
Fax +49(0)231-75 49-149
info@elmos.de | www.elmos.de